

证券简称：满坤科技

证券代码：301132



吉安满坤科技股份有限公司
Ji'an Mankun Technology Co., Ltd.

Ji'an Mankun Technology Co., Ltd.

（吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号）

向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要

保荐机构（主承销商）



（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

二〇二六年九月

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

二、关于公司本次发行的可转换债券信用评级

公司聘请中证鹏元对本次可转债进行了评级，根据评级机构出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AA-”，本次可转债信用等级为“AA-”，评级展望稳定。

在本次发行的可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、公司本次发行可转换债券不提供担保

本次发行的可转债不设担保。提请投资者注意本次可转债可能因未设定担保而存在兑付风险。

四、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况

（一）公司的利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：

“第一百六十八条 公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配原则：公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在决策和论证过程中应当充分听取和考虑中小股东的意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

（二）利润分配的形式：公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。公司在选择利润分

配方式时，现金分红应优先于股票股利。公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（三）现金分红的具体条件和比例：在符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大资金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司连续 3 年以现金方式累计分配的利润不少于该 3 年实现的年均可分配利润的 30%，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（3）中国证监会或者深交所规定的其他情形。

（四）公司发放股票股利的具体条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

（五）利润分配方案决策程序：公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东会批准。

（六）利润分配政策的变更：如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策应广泛征求独立董事、公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。

第一百六十九条 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，并按照本章程规定的程序，提出现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

若公司经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。”

（二）最近三年利润分配情况

公司最近三年的现金分红情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	11,947.81	10,649.80	10,978.15
现金分红（含税）	6,219.62	6,204.81	5,987.28
当年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	52.06%	58.26%	54.54%

2024 年 5 月 13 日，公司 2023 年年度股东大会会议审议通过《2023 年度利润分配预案》，以总股本 147,470,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.06 元（含税），共计派发现金 59,872,820 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红金额占 2023 年度合并报表归属上市公司普通股股东的净利润的 54.54%，符合《公司章程》规定。

2025 年 5 月 12 日，公司 2024 年年度股东大会会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，以总股本 148,086,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.19 元（含税），共计派发现金 62,048,138.33 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红金额占 2024 年度合并报表归属上市公司普通股股东的净利润的 58.26%，符合《公司章程》规定。

2026 年 5 月 19 日，公司 2025 年度股东会会议审议通过《2025 年度利润分

配预案》，以总股本 148,086,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），共计派发现金 62,196,224.58 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红金额占 2025 年度合并报表归属上市公司普通股股东的净利润的 52.06%，符合《公司章程》规定。

公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营和项目投资，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。

五、特别风险提示

公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）募投项目海外投资及政策变动的相关风险

本次募集资金部分将用于公司泰国高端印制电路板生产基地的建设，泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司泰国子公司泰国泰坤现已正式获得泰国投资促进委员会（BOI）核发的投资促进证书，可享受最长 8 年的企业所得税豁免，若未来泰国 BOI 政策发生调整，或公司在投资进度、产能建设等方面未能持续满足 BOI 优惠维持条件，存在被暂停、取消税收优惠资格的风险，将直接增加公司境外运营成本与税负水平，对公司经营业绩产生不利影响。同时，若泰国当地的土地管理、环保、税务等相关法律法规和政策发生变化，或境外市场环境发生重大变化，发行人将面临募投项目无法在计划时间内建设完成，以及项目建成后效益不达预期的风险。

（二）募投项目效益未达预期的风险

公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证。根据募投项目的可行性研究报告，泰国高端印制电路板生产基地项目在运营期可实现年均营业收入 86,480.00 万元，年均净利润 3,868.50 万元，项目税后内部收益率达 16.17%。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术、市场发展趋势的判断等因素作出的，但在项目实施过程中，仍存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替、产能消

化不及预期等原因造成募投项目延期或者无法产生预期收益的风险。

目前由于全球经济复苏仍存在不确定性、地缘政治格局复杂多变，若未来下游领域需求增速不及预期，可能出现行业竞争加剧的情形，导致募投项目新增产能无法及时消化；同行业上市公司可能出现降价以获取订单，从而使行业利润空间缩小；本次募投项目将新增较多固定资产，预计达产后新增折旧摊销金额将会影响公司利润水平。因此，若未来募投项目产能消化不足、产品价格下降，将会影响本次募投项目效益情况。同时，在募投项目实施过程中，可能存在经营风险、意外事故或其他不可抗力因素而导致募投项目投资周期延长、投资超支、投产延迟等情况，从而产生募投项目未能实现预期效益的风险。

（三）项目投产后的产能消化风险

报告期内，公司产能利用率分别为 84.05%、90.95%、87.18%和 76.77%，考虑到产线排期及订单准备切换、设备例行检修等因素以及报告期内公司新建三厂的产能爬坡因素，公司整体的产能利用率处于较高水平。报告期内，公司产品产销率分别为 100.48%、98.57%、96.15%和 104.40%，公司产品销售状况良好。鉴于前次募投项目已于 2025 年末建成达产，目前处于产能爬坡阶段，本次募集资金投资项目建成投产后将新增年产 110 万平方米印制电路板的产能，公司未来期间生产能力提高较快，若 PCB 市场增速或公司客户开拓力度不及预期，以及本次募投项目客户与目前客户重合度较高的话，则公司现有或拟建产能将存在一定的产能消化风险。尤其是本次募投项目涉及泰国生产基地的建设，未来基地建设进度、境外客户拓展、订单获取以及技术能力的验证存在一定的不确定性，公司未来境外生产基地将存在一定的产能消化风险。

（四）业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 121,699.39 万元、126,773.20 万元、164,715.46 万元和 94,238.36 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 10,978.15 万元、10,649.80 万元、11,947.81 万元和 4,398.12 万元。2026 年上半年，公司归属于母公司所有者的净利润同比下滑 30.46%。2024 年，受下游消费电子领域需求疲软、原材料成本上升等多重因素影响，公司四层板、六层及以上 PCB 板毛利率下降，叠加处置子公司深圳满坤电子的影响，公司呈现增收不

增利的情况；2025 年，受下游汽车电子领域需求变化以及公司吉安三厂处于产能爬坡期的影响，公司六层及以上 PCB 产品毛利率略有下降、HDI 产品毛利率处于相对低位，进而导致公司主营业务毛利率略有下降。2026 年上半年，公司经营业绩的同比下降主要受上游原材料价格上涨、固定成本增加、公司加大研发投入以及理财规模下降、美元汇率波动等因素综合影响所致。下游市场需求对公司的经营业绩存在较大的影响，倘若未来宏观经济表现不佳，相关行业政策、技术发生重大不利变化或公司高多层产品无法实现毛利率的提升、吉安三厂无法实现良好的经济效益，抑或国际贸易摩擦、地缘政治冲突等方面出现持续不利的变化，将对公司盈利情况产生较大不利影响。在个别极端情况下或者多个风险叠加的情况下，发行人可能存在发行可转债当年业绩下滑 50%以上、甚至亏损的风险。

（五）毛利率下滑风险

报告期内，公司销售毛利率分别为 19.65%、18.64%、18.02%和 16.66%，受产品种类、销售价格、原材料采购成本、产能利用率等因素的影响，公司销售毛利率会产生一定程度的波动。如果未来行业竞争进一步加剧导致公司产品销售价格下降，而公司未能及时通过提高技术水平、产品质量以应对市场竞争，或者原材料价格上升，而公司未能有效控制产品成本或传导至下游客户等情况发生，则存在毛利率下滑、盈利能力下降的风险。

（六）原材料价格波动风险

公司原材料成本占比较高，报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例约为 69%，直接材料的采购价格对主营业务成本存在显著影响。公司生产所需的主要原材料包括覆铜板、铜箔、铜球、半固化片和金盐等，上述原材料价格受铜、黄金、石油等大宗商品的市场价格影响较大。近年来受全球经济以及国际政治局势的影响，国际铜价、金价和石油价格出现了大幅波动，公司主要原材料采购价格同样出现明显波动。若未来公司主要原材料采购价格大幅上涨，而公司未能通过向下游转移、技术工艺创新、产品结构优化等方式应对价格上涨的压力，将会对公司盈利水平产生不利影响。

（七）实际控制人不当控制风险

本次发行前，公司实际控制人洪氏家族合计控制公司 67.62%的表决权，股权比例较高。本次发行后，预计公司实际控制人通过控股股东持股比例依然较高，处于绝对控股地位。若控股股东、实际控制人利用其控制地位通过股东会、董事会等行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施不当影响，将可能对公司或其他股东利益造成不利影响。

（八）募投项目折旧摊销增加导致利润下滑的风险

由于本次募投项目涉及大额设备采购和建设工程等资本性支出，项目建成后，公司每年将产生较高金额的折旧摊销费用。根据测算，本次募投项目预计每年新增折旧摊销费用最高为 7,018.61 万元，对公司利润总额将产生一定影响。尽管公司已对募投项目开展充分论证与可行性分析，且根据项目效益预测，新增效益足以抵消上述新增折旧摊销费用，但上述募投项目收益受宏观经济、产业政策、市场环境、竞争格局、技术迭代等多方面因素影响，若未来项目效益实现不达预期，上述募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明	2
二、关于公司本次发行的可转换债券信用评级	2
三、公司本次发行可转换债券不提供担保	2
四、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况	2
五、特别风险提示	5
目 录	9
第一节 释义	12
一、一般术语	12
二、专业术语	13
第二节 本次发行概况	17
一、公司基本情况	17
二、本次发行的背景和目的	17
三、本次发行基本情况	20
四、本次发行的相关机构	37
五、发行人与本次发行有关机构及人员之间的关系	39
第三节 风险因素	40
一、与发行人相关的风险	40
二、与行业相关的风险	46
三、其他风险	48
第四节 发行人基本情况	51
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况	51
二、组织结构及对其他企业的重要权益投资情况	51
三、控股股东和实际控制人基本情况	53
四、重要承诺及履行情况	57
五、董事、高级管理人员及其他核心人员	61
六、公司所处行业的基本情况	71
七、发行人主营业务情况	108
八、与产品有关的技术情况	119
九、公司的主要固定资产和无形资产	123
十、公司特许经营权情况	128

十一、公司重大资产重组情况.....	128
十二、公司境外经营的情况.....	128
十三、公司报告期内的分红情况.....	129
十四、公司最近三年发行的债券情况.....	130
第五节 财务会计信息与管理层分析.....	131
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平.....	131
二、最近三年合并财务报表.....	131
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	136
四、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正.....	137
五、最近三年的主要财务指标.....	138
六、财务状况分析.....	139
七、经营成果分析.....	169
八、现金流量分析.....	186
九、资本性支出分析.....	189
十、技术创新分析.....	190
十一、重大对外担保、诉讼或仲裁、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响.....	192
十二、本次发行的影响.....	192
第六节 合规经营与独立性.....	194
一、合规经营.....	194
二、关联方资金占用情况.....	195
三、同业竞争情况.....	195
四、关联方和关联交易情况.....	196
第七节 本次募集资金运用.....	202
一、本次募集资金使用计划.....	202
二、本次募集资金投资项目的具体情况.....	202
三、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式.....	224
四、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系、与前次募投项目的区别和联系.....	226
五、关于主营业务与募集资金投向的合规性.....	229
六、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响.....	231
第八节 历次募集资金运用.....	232
一、最近五年内募集资金情况.....	232
二、前次募集资金的实际使用情况.....	233
三、会计师事务所对前次募集资金使用情况出具的鉴证报告.....	237
第九节 备查文件	238

附表一：商标	240
附表二：专利	241
附表三：软件著作权	247

第一节 释义

本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般术语

发行人、公司、本公司、满坤科技	指	吉安满坤科技股份有限公司
满坤有限	指	吉安市满坤科技有限公司，发行人前身
深圳满坤科技	指	深圳市满坤科技有限公司，公司的全资子公司
伟仁达	指	伟仁达科技有限公司，发行人在中国香港设立的全资子公司
新加坡泰坤	指	THAI KUN PTE. LTD.，发行人在新加坡设立的全资子公司
泰国泰坤、泰坤电路	指	泰坤电路科技有限公司（THAI KUN CIRCUIT CO.,LTD.），发行人在泰国设立的子公司
深圳满坤电子	指	深圳市满坤电子有限公司，发行人前全资子公司。公司已于2024年将其持有的深圳满坤电子100%股权对外转让
洪氏夫妇	指	洪俊城、洪娜珊
洪氏家族	指	洪俊城、洪娜珊、洪耿奇、洪耿宇、洪丽旋、洪丽冰、洪记英，系公司的控股股东、实际控制人
本次发行	指	本公司按照募集说明书向中国境内投资者发售的，将在深圳证券交易所上市的可转换公司债券之事宜
普联技术	指	普联技术有限公司及其下属子公司，公司客户
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司，上市公司，公司客户
格力电器	指	珠海格力电器股份有限公司，上市公司，公司客户
德赛西威	指	惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司，上市公司，公司客户
洲明科技	指	深圳市洲明科技股份有限公司，上市公司，公司客户
台达电子	指	台达电子工业股份有限公司，中国台湾上市公司，公司客户
江苏天宝	指	江苏天宝汽车电子有限公司，公司客户
强力巨彩	指	厦门强力巨彩显示技术有限公司，公司客户
华域汽车	指	华域汽车系统股份有限公司，公司客户
爱士惟	指	AISWEI，爱士惟科技股份有限公司及其下属公司，公司客户
马瑞利	指	Marelli 及其下属公司，国际汽车零部件企业集团，公司客户
萨基姆	指	Sagemcom 及其下属公司，通信与能源解决方案提供商，公司客户
生益科技	指	广东生益科技股份有限公司，上市公司，公司供应商

南亚新材	指	南亚新材料科技股份有限公司，上市公司，公司供应商
江南新材	指	江西江南新材料科技股份有限公司，上市公司，公司供应商
德福科技	指	九江德福科技股份有限公司，上市公司，公司供应商
胜宏科技	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司，同行业上市公司
景旺电子	指	深圳市景旺电子股份有限公司，同行业上市公司
博敏电子	指	博敏电子股份有限公司，同行业上市公司
骏亚科技	指	广东骏亚电子科技股份有限公司，同行业上市公司
奥士康	指	奥士康科技股份有限公司，同行业上市公司
依顿电子	指	广东依顿电子科技股份有限公司，同行业上市公司
世运电路	指	广东世运电路科技股份有限公司，同行业上市公司
中京电子	指	惠州中京电子科技股份有限公司，同行业上市公司
崇达技术	指	崇达技术股份有限公司，同行业上市公司
中富电路	指	深圳中富电路股份有限公司，同行业上市公司
威尔高	指	江西威尔高电子股份有限公司，同行业上市公司
科翔股份	指	广东科翔电子科技股份有限公司，同行业上市公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股	指	人民币普通股
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
保荐机构、保荐人、主承销商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
发行人律师、国枫律所	指	北京国枫律师事务所
审计机构、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《吉安满坤科技股份有限公司章程》
《证券期货法律适用意见第 18 号》	指	《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
报告期	指	2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-6 月
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日及 2026 年 6 月 30 日

二、专业术语

印制电路板、PCB	指	英文名称“Printed Circuit Board”，即采用电子印刷术制作的、在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板。印制电路板是电子元器件的支撑体和电气连接载体，又可称为“印制线路板”、“印刷线路板”
单面板	指	英文名称“Single-Sided Boards”，即仅在绝缘基板的一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其中一面的 PCB
双面板	指	英文名称“Double-Sided Boards”，即在基板两面形成导体图案的 PCB，两面间一般有适当的导孔相连
多层板	指	英文名称“Multi-Layer Boards”，即具有更多层导电图形的 PCB（通常层数都是偶数），生产中需采用定位技术将 PCB、绝缘介质交替粘结并根据设计要求通过适当的导孔互联
小批量板	指	订单面积小于 50 平方米的产品认定为小批量产品
大批量板	指	订单面积在 50 平方米以上的产品认定为大批量产品
高多层、高多层板	指	具有多层导电图形的印制电路板，层间有绝缘介质粘合，并有导通孔互连，公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以上的印制电路板
刚性电路板、刚性板	指	英文名称“Rigid PCB”，即由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板，其优点为可以附着上的电子元件提供一定支撑
柔性板（挠性板）、FPC	指	Flexible Printed Circuit，柔性印制电路板，利用挠性基材制成，并具有一定弯曲性的印制电路板，又称软板、柔性板
刚挠结合板	指	英文名称“Rigid-flex PCB”，简称 RFPCB，即将刚性板和挠性板有序地层压在一起，并以金属化孔形成电气连接的电路板。使得一块 PCB 上包含一个或多个刚性区和柔性区，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲性
高密度互连电路板、HDI 板	指	英文名称“High Density Interconnection”，即高密度互连技术。HDI 是印制电路板技术的一种，具备提供更高密度的电路互连、容纳更多的电子元器件等特点
EMS	指	英文名称“Electronic Manufacturing Services”，即电子制造服务。EMS 包括产品开发设计、产品生产、原材料采购、产品品质管理及物流运输等一系列服务
基板、基材	指	制造 PCB 的基本材料，具有导电、绝缘和支撑等功能，可分为刚性材料（纸基、玻纤基、复合基、陶瓷和金属基等特殊基）和柔性材料两大类
覆铜板/CCL	指	覆铜箔层压板，Copper Clad Laminate，PCB 的基本材料，由铜箔、树脂、补强材料及其它功能补强添加物组成的刚性电路板加工基材
半固化片	指	一种用于制作多层板、主要由树脂和增强材料组成的主要材料。其中增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型，目前制作多层印制板所使用的半固化片大多采用

		玻纤布做增强材料
沉铜	指	英文名称“Plating Through Hole”，即在已钻孔的不导电的孔壁基材上，用化学方法沉积一层薄薄的化学铜，以作为后面电镀铜的基底
电镀	指	英文名称“Vertical conveyor plating”，即垂直连续电镀，采用喷射镀铜工艺及垂直连续输送装置，比传统悬吊式（龙门）电镀品质大幅提升
压合	指	制作多层板的一个重要工序，将内层线路板、半固化片（PP）、外层铜箔等基材通过高温高压粘合为整体，同时实现层间绝缘与线路互联
过孔	指	英文名称“Via hole”，即在双面板和多层板中，为连通各层之间的印制导线，在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔，即过孔，又可称为金属化孔。过孔一般又分为三类：盲孔、埋孔和通孔
蚀刻	指	将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术，通过曝光、显影后，将要蚀刻区域的保护膜去除，在蚀刻时接触化学溶液，达到溶解腐蚀的作用
涂布	指	为了防腐、绝缘、装饰等目的，以液体或粉末形式在织物、纸张、金属箔或板等物体表面上涂盖塑料薄层
棕化	指	对生产板进行铜面处理，在内层铜箔表面生成一层氧化层以提升多层线路板在压合时铜箔和环氧树脂之间的接合力
导线	指	英文名称“Conductor trace line”，即用于连接元器件引脚，传递电流信号，实现电路物理连接的电气网络铜膜，又可称为铜膜走线。导线的布置对整个印刷电路板的性能有直接影响，是印刷电路板设计的核心
HSP	指	Heat Spreading Paste，高散热膏技术，一种通过在 PCB 铜面采用印刷工艺涂覆高散热膏，借助散热膏的高效热传导特性，快速传导 PCB 板上电子元器件工作时产生的热量，从而实现 PCB 板散热效率提升的技术方案
VMI	指	供应商管理库存模式，英文名称“Vendor Managed Inventory”，即供应商在客户的要求下将货物运送至客户指定仓库，并根据客户需求维护库存水平，客户领用之前的货物仍归供应商所有
OZ	指	盎司，作为长度单位时，1OZ 代表 PCB 的铜箔厚度约为 36um
5G	指	第五代移动通信技术的简称，以全新的网络架构，提供至少十倍于 4G 的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，实现网络性能新的跃升
CPCA	指	英文名称“China Printed Circuit Association”，即中国电子电路行业协会。CPCA 是中国工业和信息化部主管、民政部批准成立的国家一级行业协会

Prismark	指	Prismark Partners LLC，是一家印制电路板领域内的知名市场分析机构，其发布的数据在 PCB 行业有较大影响力
Statista	指	Statista.com 总部位于德国的全球化数据网站，提供专业化的第三方数据以及市场研究报告

注：本募集说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 本次发行概况

一、公司基本情况

中文名称	吉安满坤科技股份有限公司
英文名称	Ji'an Mankun Technology Co., Ltd.
成立日期	2008 年 4 月 9 日
上市日期	2022 年 8 月 10 日
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91360805672429045F
法定代表人	洪俊城
注册资本	148,086,249 元
注册地址	吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号
办公地址	吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	满坤科技
股票代码	301132.SZ
董事会秘书	耿久艳
邮政编码	343100
互联网网址	www.mankun.com
电子邮箱	board.office@mankun.com
电话号码	0796-8406089
传真号码	0796-8406089
经营范围	线路板生产、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家产业政策鼓励 PCB 产业发展

国家产业政策对印制电路板产业的鼓励体现为多层次、多维度的战略布局。2023 年 12 月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，将高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板等列为鼓励类产业；2024 年 5 月，工业和信息化部办公厅发布《工业重点行业领

域设备更新和技术改造指南》，提出以电子元器件及电子材料生产检测设备的自动化、智能化、柔性化、节能化改造为重点，推动电子元器件产品向集成化、高频化、高精度、高可靠发展，加快微型化、高频化产品研发，争取到 2027 年，全行业设备改造后，基本满足我国电子元器件及相关行业对高性能、高效率、智能化、绿色化生产检测设备的使用需求，部分领域行业龙头企业的设备水平达到世界一流；2025 年 10 月，中共中央发布《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》指出，推动技术改造升级，促进制造业数智化转型，发展智能制造、绿色制造、服务型制造，加快产业模式和企业组织形态变革。增强质量技术基础能力，强化标准引领、提升国际化水平，加强品牌建设。前述国家一系列产业政策的出台为印制电路板行业的健康发展奠定了良好的政策基础。

2、全球 PCB 产值持续增长，市场前景良好

电子电路行业是电子信息产业的核心支柱，亦是数字经济发展的关键基石。PCB 作为承载电子元器件、实现电路互联的核心载体，素有“电子产品之母”的美誉，是现代电子信息产品不可或缺的核心元器件。据 Prismark 数据统计，2025 年全球 PCB 产业产值为 851.52 亿美元，同比增长 15.80%；展望未来，全球 PCB 产业产值有望稳步攀升，至 2030 年预计将达到 1,233.48 亿美元，2025 至 2030 年期间年复合增长率预计为 7.7%。其中，中国大陆 PCB 产业 2025 年增速达 19.2%，2025 至 2030 年预计年复合增长率为 7.0%，将持续稳固全球第一大 PCB 生产基地的地位。在此行业发展趋势下，公司积极推进泰国生产基地布局，有利于构建海外产能供应体系，精准匹配海外客户订单需求，培育新的盈利增长点，进而有效提升公司核心国际竞争力。

3、顺应 PCB 行业发展趋势、优化公司产能布局

泰国巴真武里府地处泰国东部，属于“一带一路”倡议核心区域和泰国“东部经济走廊”区域，是连接中南半岛与中国市场的重要陆路通道。该区域已发展成为泰国汽车电子、智能电器制造产业的核心聚集高地，经过长期产业积淀已形成涵盖原材料采购、核心零部件加工、成品组装及物流配套的完整上

下游产业链体系，当前重点聚焦并大力吸引新能源汽车、高端电子制造等战略新兴产业落地扎根，能够与周边优质企业形成高效的产业协同效应与资源互补优势。公司于泰国巴真武里府投资建设新的生产基地，能够充分依托当地的资源禀赋优势、关税减免及贸易便利化政策红利，以及核心区位带来的交通物流优势，进一步深化与境内外核心客户的业务对接频次与合作深度，积极挖掘并拓展新的战略合作机遇与市场发展空间。此次泰国印制电路板项目生产基地的建设，系公司顺应行业发展趋势、优化公司产能布局的重要战略举措，符合公司长期战略部署和股东利益。

（二）本次发行的目的

1、拓展境外市场规模、增强公司抗风险能力

近年来，各种贸易壁垒令国内企业产品出口压力增加，以技术标准、知识产权、关税为代表的贸易壁垒层出不穷，给产业链带来的潜在风险不容忽视。未来如果国际贸易摩擦持续发生，导致相关国家对公司的产品提高关税、采取限制政策，或者公司的主要客户被有关国家列入出口管制清单，或者相关国家采取其他贸易保护的相关措施，将给公司的生产经营带来不利影响。公司在东南亚投资建设新的生产基地，一方面可以在一定程度上规避由于潜在贸易摩擦带来的额外税费成本，以更加灵活的产能规划和销售网络布局应对世界政经形势变化带来的潜在风险；另一方面有助于更好地服务现有客户、拓展新的市场，增强公司的盈利能力，形成可以向国际市场快速供货的生产基地格局，增强公司的抗风险能力。

2、提升公司自动化和智能化生产水平

公司将持续深耕汽车电子、通信电子、消费电子、工控安防等下游应用领域，不断优化产品结构。尤其是在人工智能、工业自动化、5G 通信、新能源汽车、半导体以及数字经济等新兴技术加速渗透的背景下，PCB 市场需求不断增长，PCB 行业将进入产能扩张、产品迭代、技术创新的新阶段。公司拟通过本次募集资金投资项目的建设，对公司现有生产基地实施智能化升级改造，通过在关键工序增设智能化设备，提升关键工序精度与设备处理能力，进而升级产

品结构、提升产品质量，形成更强的产能匹配力与供应稳定性，以提升客户黏性和市场份额。

3、搭建数字化信息系统，提升经营管理效率

在我国宏观经济迈入高质量发展新常态的时代背景下，“建设数字中国”“发展数字经济”已明确上升为国家核心战略，国家层面先后出台《“十四五”智能制造发展规划》《制造业数字化转型行动方案》等一系列重磅产业扶持政策，从顶层设计到落地执行层面全方位为制造业企业数字化、智能化转型提供政策指引与支持保障。与此同时，近年来公司凭借核心技术优势与市场拓展能力，产品矩阵实现持续扩容升级，客户数量与合作深度亦逐年稳步提升，在此过程中公司业务规模不断扩大、业务复杂度显著攀升，这对公司研发设计、生产制造、市场营销及售后服务全业务流程的信息处理效率、跨部门协同管理能力以及精细化运营水平提出了更为严苛的要求。本次募投项目聚焦公司现有信息系统数字化升级改造，通过功能模块的迭代完善实现数字化管理在全业务链条的全域覆盖与深度渗透，能够有效优化内部管理流程、降低运营成本，显著提升生产环节协同效率与公司整体运营管控能力；此外，依托灾备机房建设构建全方位、多层次的信息安全防护体系，能够进一步强化公司数据资产安全与系统运行稳定性，夯实公司数字化运营底层基石，为公司业务高效、稳定运转提供坚实可靠的技术支撑，助力公司在数字化转型浪潮中构筑核心竞争优势。

三、本次发行基本情况

（一）本次发行注册情况

本次发行已经公司 2025 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第七次会议以及 2025 年 10 月 31 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。2026 年 6 月 12 日，深圳证券交易所上市审核委员会审议并通过了发行人的本次发行申请。2026 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉安满坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1757 号）。

（二）本次可转债基本条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 76,000.00 万元（含 76,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值人民币 100.00 元。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 9 月 28 日至 2032 年 9 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 1.80%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026年10月9日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2027年4月9日至2032年9月27日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

8、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 66.97 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得向上修正。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

9、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会或董事会授权人士有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 为转股数量，V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司董事会或董事会授权人士有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1）转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2) 本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在可转换公司债券最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而

可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能在同一计息年度内多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

13、转股后的利润分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行对象

（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2026 年 9 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东。

(2) 网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

(3) 保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

15、发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 9 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购不足 76,000.00 万元的余额由保荐人（主承销商）包销。

(1) 向发行人原股东优先配售

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2026 年 9 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的持有的发行人股份数量按每股配售 5.1521 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100.00 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，不足 1 张的部分按照精确算法原则处理，即每股配售 0.051521 张可转债。

发行人现有总股本 148,086,249 股，剔除发行人回购专户库存股 575,124 股后，可参与原股东优先配售的股本总数为 147,511,125 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 7,599,920 张，占本次发行的可转债总额 7,600,000 张的 99.9989%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“381132”，配售简称为“满坤配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

原股东网上优先配售不足 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，

数量小的进位给数量大的参与优先配售的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

（2）网上发行

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“371132”，申购简称为“满坤发债”。每个账户最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。

申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。

16、债券持有人会议相关事项

（1）可转换公司债券持有人的权利

1) 依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

2) 依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

3) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

4) 根据约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票;

5) 根据约定的条件行使回售权;

6) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;

7) 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息;

8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

若公司发生因持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益回购股份而导致减资的情形时, 本次可转换债券持有人不得因此要求公司提前清偿或者提供相应的担保。

(2) 可转换公司债券持有人的义务

1) 遵守公司发行本次可转债条款的相关规定;

2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议;

4) 除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外, 不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

(3) 债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期内, 有下列情形之一的, 应当召集债券持有人会议:

1) 公司拟变更《募集说明书》的重要约定:

- ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
 - ②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
 - ③变更债券投资者保护措施及其执行安排；
 - ④变更募集说明书约定的募集资金用途；
 - ⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
- 2）拟修订公司可转换公司债券持有人会议规则；
- 3）拟变更、解聘债券受托管理人或变更《可转换公司债券受托管理协议》的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；
- 4）公司已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；
- 5）公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- 6）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响；
- 7）公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
- 8）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
- 9）公司提出重大债务重组方案的；
- 10）公司或者其控股股东、实际控制人因无偿或者以明显不合理对价转让资产、放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
- 11）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

12) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

1) 公司董事会;

2) 单独或合计持有本次可转债未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议;

3) 债券受托管理人;

4) 相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

17、本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 76,000.00 万元(含 76,000.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	泰国高端印制电路板生产基地项目	50,175.07	47,000.00
2	智能化与数字化升级改造项目	30,455.00	29,000.00
合计		80,630.07	76,000.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

18、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

19、评级事项

公司聘请中证鹏元对本次可转债进行了评级，根据评级机构出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AA-”，本次可转债信用等级为“AA-”。在本次发行的可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。

20、募集资金存管

公司已建立《募集资金管理制度》，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

21、本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。

（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户

1、预计募集资金量

本次发行可转债的预计募集资金量为不超过 76,000.00 万元（含 76,000.00 万元）。

2、募集资金专项存储账户

本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。

（四）本次可转债的受托管理人

公司聘任平安证券作为本期债券的受托管理人，并同意接受平安证券的监督。在本期可转债存续期内，平安证券应当勤勉尽责，根据相关法律、法规和规则、募集说明书及《受托管理协议》的规定，行使权利和履行义务。凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期可转债的投资者，均视同自愿接受平安证券担任本期可转债的受托管理人，同意《受托管理协议》

中关于甲方、乙方、可转债持有人权利义务的相关约定。经可转债持有人会议决议更换受托管理人时，亦视同可转债持有人自愿接受继任者作为本期可转债的受托管理人。

（五）承销方式及承销期

本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 76,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 76,000.00 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 22,800.00 万元。当包销比例超过本次发行的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。

本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，本次可转债发行的承销期为 2026 年 9 月 23 日至 2026 年 10 月 9 日。

（六）发行费用

序号	项目	金额（万元）
1	承销及保荐费用	403.63
2	律师费用	18.87
3	审计及验资费用	28.30
4	资信评级费用、信息披露等其他费用	44.59
合计		495.39

（七）主要日程与停、复牌安排

日期	交易日	发行安排	停牌安排
2026 年 9 月 23 日 周三	T-2 日	披露《募集说明书》及摘要、《募集说明书提示性公告》《发行公告》《网上路演公告》等	正常交易
2026 年 9 月 24 日	T-1 日	原股东优先配售股权登记日 网上路演	正常交易

周四			
2026年9月 28日 周一	T 日	披露《可转债发行提示性公告》 原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上申购摇号中签率	正常交易
2026年9月 29日 周二	T+1 日	披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》 网上申购摇号抽签	正常交易
2026年9月 30日 周三	T+2 日	披露《中签号码公告》 网上中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）	正常交易
2026年10月 8日 周四	T+3 日	保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况 确定最终配售结果和包销金额	正常交易
2026年10月 9日 周五	T+4 日	披露《发行结果公告》 募集资金划至公司账户	正常交易

上述日期均为交易日。若相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇不可抗力、重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

（八）本次发行证券的上市流通

本次发行的证券不设持有期限限制。发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

（九）违约情形、责任及争议解决

1、违约情形

以下事件构成《受托管理协议》项下的公司违约事件：

（1）公司已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息；

（2）公司已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本次债券发生违约的；

(3) 公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5,000 万元，且可能导致本次债券发生违约的；

(4) 公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证且导致公司偿债能力面临严重不确定性的，或其被托管/接管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

(5) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

(6) 公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

(7) 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化的；

(8) 本次债券存续期内，公司违反受托管理协议项下的陈述与保证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务等义务与职责以致对公司对本次债券的还本付息能力产生重大不利影响，且一直持续 20 个连续工作日仍未得到纠正；

(9) 公司发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

2、违约责任及其承担方式

如果公司违约事件发生，根据债券持有人会议规则的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知公司，宣布本次债券本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果公司在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知公司宣布取消加速清偿的决定：

(1) 向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：

- ①债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；
- ②所有迟付的利息；
- ③所有到期应付的本金；
- ④适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；

(2) 公司违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；

(3) 债券持有人会议同意的其他救济措施。

3、争议解决机制

因《受托管理协议》所引起的或与《受托管理协议》有关的任何争议，争议各方之间应协商解决。如果协商不成，应提交深圳国际仲裁院仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

四、本次发行的相关机构

(一) 发行人

名称	吉安满坤科技股份有限公司
法定代表人	洪俊城
董事会秘书	耿久艳
联系人	耿久艳
办公地址	吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号
联系电话	0796-8406089
传真	0796-8406089

(二) 保荐机构（主承销商）、受托管理人

名称	平安证券股份有限公司
法定代表人	何之江
保荐代表人	杨惠元、甘露

项目协办人	姜雄健
项目经办人	李俊灏、赵书言、孙晓云
住所	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系电话	95511-8
传真	0755-82400862

（三）律师事务所

名称	北京国枫律师事务所
负责人	张利国
经办律师	袁月云、潘波
住所	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
联系电话	010-88004488
传真	010-66090016

（四）审计机构

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	张立琰
签字注册会计师	龙琦、王巧君
住所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
联系电话	0571-88216888
传真	0571-88216999

（五）资信评级机构

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人	张剑文
签字评级人员	董斌
住所	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7008 阳光高尔夫大厦 1509
联系电话	0755-82872897

（六）主承销商收款银行

户名	平安证券股份有限公司
账号	19014512078885
开户行	平安银行深圳平安银行大厦支行

（七）申请上市的证券交易所

名称	深圳证券交易所
办公地址	深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话	0755-88668888
传真	0755-88666000

（八）股份登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系电话	0755-21899999
传真	0755-21899000

五、发行人与本次发行有关机构及人员之间的关系

截至本募集说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

第三节 风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）募投项目实施风险

1、募投项目海外投资及政策变动的相关风险

本次募集资金部分将用于公司泰国高端印制电路板生产基地的建设，泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司泰国子公司泰国泰坤现已正式获得泰国投资促进委员会（BOI）核发的投资促进证书，可享受最长 8 年的企业所得税豁免，若未来泰国 BOI 政策发生调整，或公司在投资进度、产能建设等方面未能持续满足 BOI 优惠维持条件，存在被暂停、取消税收优惠资格的风险，将直接增加公司境外运营成本与税负水平，对公司经营业绩产生不利影响。同时，若泰国当地的土地管理、环保、税务等相关法律法规和政策发生变化，或境外市场环境发生重大变化，发行人将面临募投项目无法在计划时间内建设完成，以及项目建成后效益不达预期的风险。

2、募投项目效益未达预期的风险

公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证。根据募投项目的可行性研究报告，泰国高端印制电路板生产基地项目在运营期可实现年均营业收入 86,480.00 万元，年均净利润 3,868.50 万元，项目税后内部收益率达 16.17%。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术、市场发展趋势的判断等因素作出的，但在项目实施过程中，仍存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替、产能消化不及预期等原因造成募投项目延期或者无法产生预期收益的风险。

目前由于全球经济复苏仍存在不确定性、地缘政治格局复杂多变，若未来下游领域需求增速不及预期，可能出现行业竞争加剧的情形，导致募投项目新

增产能无法及时消化；同行业上市公司可能出现降价以获取订单，从而使行业利润空间缩小；本次募投项目将新增较多固定资产，预计达产后新增折旧摊销金额将会影响公司利润水平。因此，若未来募投项目产能消化不足、产品价格下降，将会影响本次募投项目效益情况。同时，在募投项目实施过程中，可能存在经营风险、意外事故或其他不可抗力因素而导致募投项目投资周期延长、投资超支、投产延迟等情况，从而产生募投项目未能实现预期效益的风险。

3、项目投产后的产能消化风险

报告期内，公司产能利用率分别为 84.05%、90.95%、87.18%和 76.77%，考虑到产线排期及订单准备切换、设备例行检修等因素以及报告期内公司新建三厂的产能爬坡因素，公司整体的产能利用率处于较高水平。报告期内，公司产品产销率分别为 100.48%、98.57%、96.15%和 104.40%，公司产品销售状况良好。鉴于前次募投项目已于 2025 年末建成达产，目前处于产能爬坡阶段，本次募集资金投资项目建成投产后将新增年产 110 万平方米印制电路板的产能，公司未来期间生产能力提高较快，若 PCB 市场增速或公司客户开拓力度不及预期，以及本次募投项目客户与目前客户重合度较高的话，则公司现有或拟建产能将存在一定的产能消化风险。尤其是本次募投项目涉及泰国生产基地的建设，未来基地建设进度、境外客户拓展、订单获取以及技术能力的验证存在一定的不确定性，公司未来境外生产基地将存在一定的产能消化风险。

4、募投项目折旧摊销增加导致利润下滑的风险

由于本次募投项目涉及大额设备采购和建设工程等资本性支出，项目建成后，公司每年将产生较高金额的折旧摊销费用。根据测算，本次募投项目预计每年新增折旧摊销费用最高为 7,018.61 万元，对公司利润总额将产生一定影响。尽管公司已对募投项目开展充分论证与可行性分析，且根据项目效益预测，新增效益足以抵消上述新增折旧摊销费用，但上述募投项目收益受宏观经济、产业政策、市场环境、竞争格局、技术迭代等多方面因素影响，若未来项目效益实现不达预期，上述募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响。

（二）财务风险

1、业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 121,699.39 万元、126,773.20 万元、164,715.46 万元和 94,238.36 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 10,978.15 万元、10,649.80 万元、11,947.81 万元和 4,398.12 万元。2026 年上半年，公司归属于母公司所有者的净利润同比下滑 30.46%。2024 年，受下游消费电子领域需求疲软、原材料成本上升等多重因素影响，公司四层板、六层及以上 PCB 板毛利率下降，叠加处置子公司深圳满坤电子的影响，公司呈现增收不增利的情况；2025 年，受下游汽车电子领域需求变化以及公司吉安三厂处于产能爬坡期的影响，公司六层及以上 PCB 产品毛利率略有下降、HDI 产品毛利率处于相对低位，进而导致公司主营业务毛利率略有下降。2026 年上半年，公司经营业绩的同比下降主要受上游原材料价格上涨、固定成本增加、公司加大研发投入以及理财规模下降、美元汇率波动等因素综合影响所致。下游市场需求对公司的经营业绩存在较大的影响，倘若未来宏观经济表现不佳，相关行业政策、技术发生重大不利变化或公司高多层产品无法实现毛利率的提升、吉安三厂无法实现良好的经济效益，抑或国际贸易摩擦、地缘政治冲突等方面出现持续不利的变化，将对公司盈利情况产生较大不利影响。在个别极端情况下或者多个风险叠加的情况下，发行人可能存在发行可转债当年业绩下滑 50%以上、甚至亏损的风险。

2、经营活动现金流净额持续下滑的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 11,585.92 万元、10,962.40 万元、4,977.69 万元和 4,712.98 万元。受公司新增吉安三厂产能的影响，公司原材料采购规模、用工成本及相关税费以及相应采用银行承兑汇票结算的金额增加，导致公司当期经营活动现金流量净额同比大幅下降。如果公司在未来无法采取有效措施缓解经营活动现金流压力，可能会影响公司生产经营活动的正常开展，进而对公司的持续经营和偿债能力带来不利影响。

3、毛利率下滑风险

报告期内，公司销售毛利率分别为 19.65%、18.64%、18.02%和 16.66%，受产品种类、销售价格、原材料采购成本、产能利用率等因素的影响，公司销售毛利率会产生一定程度的波动。如果未来行业竞争进一步加剧导致公司产品销售价格下降，而公司未能及时通过提高技术水平、产品质量以应对市场竞争，或者原材料价格上升，而公司未能有效控制产品成本或传导至下游客户等情况发生，则存在毛利率下滑、盈利能力下降的风险。

4、应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 39,441.39 万元、47,492.09 万元、55,967.99 万元和 59,759.65 万元，占营业收入的比例分别为 32.41%、37.46%、33.98%和 31.71%，其中账龄一年以内的应收账款占比在 99%以上，发生坏账的风险较小。公司应收账款余额随业务规模的扩大呈不断增加的趋势，若下游客户财务状况、经营情况发生重大不利变化，公司将面临应收账款不能按期或无法收回而发生坏账的风险，从而对公司的资金周转和生产经营产生不利影响。

5、存货规模较大及存货跌价风险

报告期内随着公司经营规模的扩大，公司存货规模上升较多。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 10,534.23 万元、15,338.27 万元、24,766.47 万元和 28,239.95 万元，占公司总资产的比例分别为 4.63%、5.51%、8.37%和 9.14%。2026 年 6 月末存货账面价值占总资产比例增长幅度较大主要系公司吉安三厂新建产能增加以及原材料价格上涨导致原材料、在产品增加所致。若未来公司主要原材料和产品价格在短期内发生大幅下降，或因国家政策和市场需求造成客户变更或取消订单计划，从而导致公司产品难以在短期内实现销售，则可能造成存货的可变现净值低于账面价值，届时需计提存货跌价准备，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

6、税收优惠政策变化的风险

2024 年 10 月公司通过高新技术企业复审，有效期三年。报告期内公司均享受 15%的企业所得税优惠税率。税收优惠政策期满后，如公司不能继续被认定为高新技术企业或国家主管税务机关对上述税收优惠政策作出调整，对公司经营业绩和利润水平将产生一定程度的不利影响。

7、本次发行摊薄即期股东收益的风险

报告期内，公司基本每股收益为 0.74 元/股、0.72 元/股、0.81 元/股和 0.30 元/股，加权平均净资产收益率为 6.59%、6.16%、6.68%和 2.40%。本次可转债发行后，公司可转债投资者持有的可转换公司债券将可能部分或全部转股，公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，公司收益增长可能不会与净资产增长保持同步，因此公司存在短期内每股收益、净资产收益率下降的风险。

（三）经营风险

1、原材料价格波动风险

公司原材料成本占比较高，报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例约为 69%，直接材料的采购价格对主营业务成本存在显著影响。公司生产所需的主要原材料包括覆铜板、铜箔、铜球、半固化片和金盐等，上述原材料价格受铜、黄金、石油等大宗商品的市场价格影响较大。近年来受全球经济以及国际政治局势的影响，国际铜价、金价和石油价格出现了大幅波动，公司主要原材料采购价格同样出现明显波动。若未来公司主要原材料采购价格大幅上涨，而公司未能通过向下游转移、技术工艺创新、产品结构优化等方式应对价格上涨的压力，将会对公司盈利水平产生不利影响。

2、业务规模扩大导致的管理风险

报告期各期末，公司资产总额分别为 227,627.61 万元、278,253.02 万元、295,897.72 万元和 309,125.52 万元，报告期内公司营业收入分别为 121,699.39 万元、126,773.20 万元、164,715.46 万元和 94,238.36 万元，公司资产和营收规模持续扩大。本次发行完成后，公司的资产规模、经营规模将进一步提高，本

次募投项目之泰国项目亦是公司首次在境外设立生产基地，将在市场开拓、生产管理、内部控制、员工管理以及各部门的工作协调性、连续性等方面对公司管理层提出更高的要求，公司将面临一定的管理风险。若公司的管理制度和管理体系无法持续满足经营规模扩大的需求，将会对公司的经营效率带来不利影响。

3、实际控制人不当控制的风险

本次发行前，公司实际控制人洪氏家族合计控制公司 67.62%的表决权，股权比例较高。本次发行后，预计公司实际控制人通过控股股东持股比例依然较高，处于绝对控股地位。若控股股东、实际控制人利用其控制地位通过股东会、董事会等行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施不当影响，将可能对公司或其他股东利益造成不利影响。

4、贸易摩擦风险

公司在多年生产经营过程中积累了部分稳定的境外客户，外销收入对公司营业收入以及毛利润贡献明显。报告期内，公司外销收入占营业收入的比例分别为 18.67%、17.59%、18.09%和 18.78%，产品主要出口地包括中国台湾、东南亚、日韩及欧美等地区。尽管目前我国已经成为全球最大的 PCB 生产基地，且具备较强的产能消化能力，但如果因贸易摩擦而导致对我国 PCB 产品采取限制政策、提高关税及其他方面的贸易保护主义措施，将会对我国 PCB 行业造成一定冲击，从而可能对公司的业务发展产生不利影响。

（四）技术风险

1、技术创新风险

公司主要从事 PCB 的研发、生产与销售，产品研发及规模化生产融合了电子、机械、计算机、光学、材料、化工等多学科技术，属于技术密集型行业。工艺的优化和升级、产品的开发和更新、产品性能的提高都依赖于创新，科技创新和产品创新对于保持和提升公司市场地位起到较为重要的作用。但由于创新存在一定的不确定性，若公司未来创新偏离客户的需求或行业发展趋势，或

者创新成果转化失败，均会导致公司创新无法达到预期效果，进而对公司的竞争地位和经营业务带来不利影响。

2、核心技术人员流失风险

PCB 行业生产工艺复杂、技术难度大，需要具备对产品结构、制造工艺进行深入研究和创新开发，并提升产品稳定性、可靠性的能力，以帮助客户快速完成新产品开发、抢占市场先机，研发和技术人员是公司生存和发展的重要基础。若未来核心技术人员流失或未能及时引进所需人才，将会对公司业务造成不利影响。

3、研发失败的风险

报告期内，公司研发费用分别为 5,096.63 万元、5,380.08 万元、6,320.79 万元和 4,679.03 万元，占当期公司营业收入的比例分别为 4.19%、4.24%、3.84% 和 4.97%。若公司在未来开发过程中出现关键技术未能突破或者产品具体指标、开发进度无法达到预期、新产品未能满足市场需求等情形，将对公司生产经营带来一定程度的不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）宏观经济波动风险

PCB 作为电子产品和信息基础设施不可缺少的基础电子元器件，其应用范围广泛，与全球宏观经济形势关联度较高。2023 年，由于下游需求疲软、高库存调整等因素影响，抑制了 PCB 行业的新增需求，当年全球 PCB 产值为 695.17 亿美元，同比大幅下降 15.0%；2024 年，受汽车电子、卫星通信、AI 服务器、光通信等领域对高多层板、HDI 等产品需求大幅增加的影响，PCB 市场需求逐步回暖，全球 PCB 总产值 735.65 亿美元，同比增长 5.8%；2025 年，全球 PCB 总产值为 851.52 亿美元，同比大幅增长 15.8%。目前受贸易摩擦、地缘政治、境外通货膨胀等因素影响，国内外宏观经济形势存在不稳定因素。若未来宏观经济出现明显回落或下游行业出现周期性波动等不利因素，PCB 产业发展速度可能出现放缓或下降，对公司经营情况造成不利影响。

（二）市场竞争加剧的风险

全球 PCB 行业竞争格局较为分散，生产厂商众多，市场竞争充分。随着近年来行业内企业国际化布局加速，东南亚地区 PCB 新建产能较多，未来市场竞争可能进一步加剧，行业集中度逐步提升。经过多年积累，公司产能规模逐步扩大、营业收入不断增长，服务客户的广度和深度不断提高，但与行业龙头企业相比，公司在业务规模、市场占有率等方面仍存在一定差距。若未来下游领域需求增速不及预期，或 PCB 行业扩产产能集中释放，公司未能持续提高技术水平、生产管理能力和产品质量以应对市场竞争，则可能出现行业竞争加剧的情形，进而导致盈利下滑的风险。

（三）汇率波动风险

公司境外销售主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。未来随着本次募投项目建成达产，公司会有部分原材料采购自泰国本地并以外币结算，亦会产生汇率波动风险。报告期内，公司汇兑损益的金额分别为-437.11 万元、-376.39 万元、674.27 万元和 1,029.42 万元。如果未来公司境外业务规模进一步增长，在汇率波动的情况下，以外币计值的资产折算将产生汇兑损益，从而对公司的财务状况和经营业绩产生一定影响。

（四）环保风险

公司 PCB 生产过程中涉及蚀刻、电镀等工序，会产生废水、废气及固体废物等污染物和噪声。公司自成立以来始终视节能环保为企业发展基石，生产期间未发生重大环境污染事故。但在生产经营过程中，无法完全排除因管理疏忽或者不可抗力事件导致出现环保事故的可能性，届时可能会给周围环境造成污染，触犯环保相关的法律法规，对公司经营造成不利影响。同时，公司在环境保护方面的投入会随着新环保政策的出台而加大，在一定程度上会增加公司的运营成本。

（五）安全生产风险

PCB 企业普遍在生产过程中存在生产工序长、大型设备多、生产员工多的特点。公司高度重视安全生产管理，报告期内公司未发生重大安全事故。但如果公司在生产经营过程中因操作不当、设备故障或自然灾害等因素而造成安全生产事故，将会对公司的生产经营产生一定程度不利影响。

（六）产业政策变动风险

近年来，国家、地方陆续出台了一系列产业政策，支持和鼓励包括 PCB 在内的电子信息产业发展。但随着宏观经济环境的逐渐变动，未来阶段政策发展仍可能存在一定的不确定性，如果对 PCB 等电子行业、下游行业的产业政策支持逐步减少，则可能导致 PCB 及下游行业发展速度减缓，对公司业绩、盈利能力造成一定的不利影响。

三、其他风险

（一）本息兑付风险

在本次可转债的存续期内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金。除此之外，在可转债触发回售条件时，公司还需承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等多种不可控因素的影响，如公司的经营活动未达到预期回报，将可能使公司无法从预期还款来源获得足够资金，进而影响公司对可转债本息按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

（二）本次发行失败或募集资金不足的风险

本次募集资金将用于泰国高端印制电路板生产基地项目、智能化与数字化升级改造项目。如本次发行失败或募集资金未达到本次募投项目建设需求，公司将利用经营积累和银行融资等多种融资方式继续推进募投项目建设，在一定期间内可能造成公司资金紧张，对公司生产经营及募投项目建设存在一定影响。若未来公司自身财务状况出现重大不利变化，亦将导致项目实施存在不确定性。

（三）信用评级变化的风险

公司聘请中证鹏元对本次可转债进行了评级，根据评级机构出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AA-”，本次可转债信用等级为“AA-”。在本次发行的可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

（四）可转换公司债券提前赎回的风险

在本次发行的可转换公司债券的转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。可转换公司债券的存续期内，在相关条件满足的情况下，如果公司行使了上述有条件赎回条款，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面临投资期限缩短、丧失未来预期利息收入的风险。

（五）不满足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险

公司为创业板上市公司，参与转股的本次可转债持有人应当符合创业板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合创业板股票投资者适当性管理要求，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定；有条件赎回价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合创业板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

（六）可转债二级市场价格波动的风险

可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、转股价格向下修正条款、上市公司股票价格走势、赎回条款、回售条款及投资者心理预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专业知识。本次向不特定对象发行的可转债在上市交易过程中，市场价格存在波动风险，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而使投资者不能获得预期的投资收益。因此，公司提醒投资者须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

（七）可转债未设立担保的风险

公司本次发行可转债未设立担保。如在本次可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本次发行可转债可能因未设担保而增加兑付风险。

第四节 发行人基本情况

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人股本总额为 148,086,249 股，股本结构如下：

股份性质	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	53,345,507	36.02%
其中：高管锁定股	53,345,507	36.02%
二、无限售条件流通股	94,740,742	63.98%
三、总股本	148,086,249	100.00%

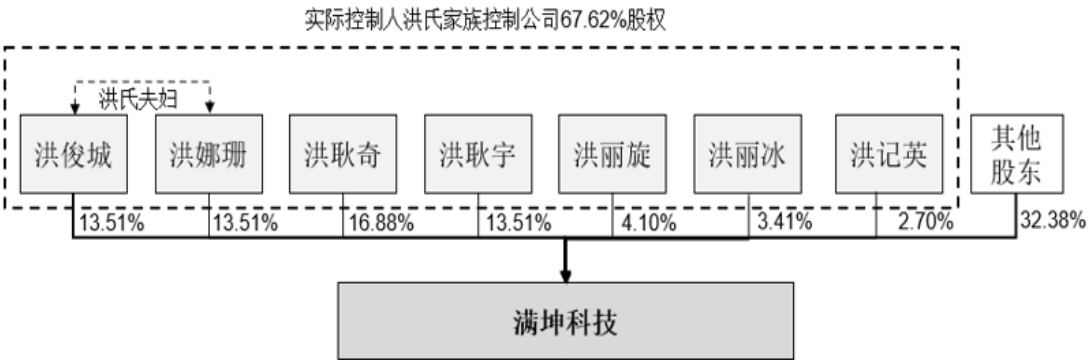
截至 2026 年 6 月 30 日，公司前十名股东及其持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量
1	洪耿奇	境内自然人	25,000,000	16.88	18,750,000	-
2	洪娜珊	境内自然人	20,000,000	13.51	15,000,000	-
3	洪耿宇	境内自然人	20,000,000	13.51	-	-
4	洪俊城	境内自然人	20,000,000	13.51	15,000,000	-
5	洪丽旋	境内自然人	6,070,000	4.10	4,552,500	-
6	洪丽冰	境内自然人	5,048,696	3.41	-	-
7	洪记英	境内自然人	4,000,000	2.70	-	-
8	屠施恩	境内自然人	1,008,988	0.68	-	-
9	UBS AG	境外法人	554,088	0.37	-	-
10	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	532,261	0.36	-	-
合计			102,214,033	69.03	53,302,500	-

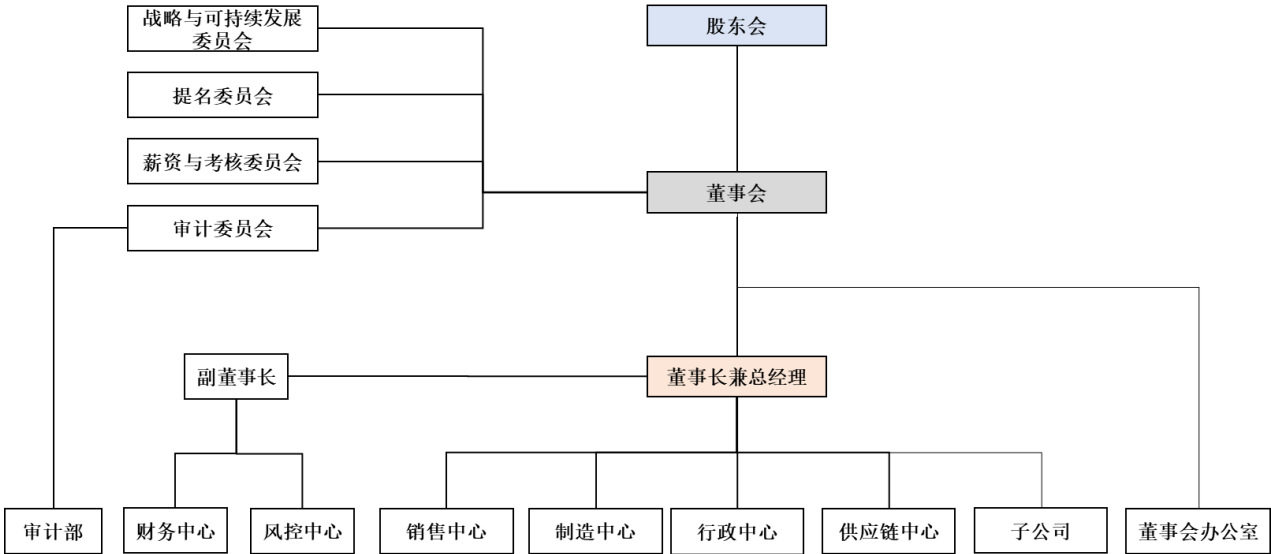
二、组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）股权结构图

截至 2026 年 6 月 30 日，公司股权结构图如下：



（二）组织架构图



（三）对其他企业的重要权益投资情况

1、控股子公司、参股公司基本情况

截至本募集说明书签署日，公司拥有四家控股子公司，具体情况如下：

序号	公司名称	成立时间	主要经营地	注册资本	实收资本	持股比例		主营业务
						直接	间接	
1	伟仁达	2017-12-05	中国香港	3,000 万港币	3,000 万港币	100%	-	从事印制电路板销售业务，公司境外销售平台
2	深圳满坤科技	2022-09-07	深圳	5,000 万元	4,000 万元	100%	-	从事印制电路板销售业务，公司境内销售平台
3	新加坡泰坤	2024-04-24	新加坡	1 万新加坡元	1 万新加坡元	-	100%	境外贸易主体

序号	公司名称	成立时间	主要经营地	注册资本	实收资本	持股比例		主营业务
						直接	间接	
4	泰国泰坤	2024-06-04	泰国	62,500 万泰铢	17,182.75 万泰铢	-	99.99%	PCB 的设计、生产、销售与进出口业务

2、重要控股子公司经营情况

公司重要控股子公司最近一年及一期的简要财务情况如下表所示：

序号	公司名称	财务指标	2026-6-30/ 2026 年 1-6 月	2025-12-31/ 2025 年度
1	伟仁达	总资产（万美元）	2,444.59	2,530.63
		净资产（万美元）	628.76	539.02
		营业收入（万美元）	1,040.88	1,607.89
		净利润（万美元）	89.74	122.20
2	深圳满坤科技	总资产（万人民币）	4,557.71	1,867.07
		净资产（万人民币）	3,026.04	1,091.40
		营业收入（万人民币）	880.28	2,427.54
		净利润（万人民币）	-165.37	-423.01
3	新加坡泰坤	总资产（万美元）	542.13	542.87
		净资产（万美元）	1.36	2.09
		营业收入（万美元）	-	-
		净利润（万美元）	-0.74	0.16
4	泰国泰坤	总资产（万泰铢）	16,954.83	16,940.69
		净资产（万泰铢）	16,934.18	16,909.11
		营业收入（万泰铢）	-	-
		净利润（万泰铢）	25.06	-261.08

注：2026 年 1-6 月财务数据未经审计。

3、发行人分公司情况

截至本募集说明书签署之日，发行人未设立分公司。

三、控股股东和实际控制人基本情况

（一）控股股东和实际控制人

截至 2026 年 6 月 30 日，洪俊城、洪娜珊、洪耿奇、洪耿宇、洪丽旋、洪丽冰、洪记英等洪氏家族成员直接持有公司股份分别为 2,000 万股、2,000 万股、2,500 万股、2,000 万股、607 万股、504.8696 万股、400 万股，占公司总股本比例分别为 13.51%、13.51%、16.88%、13.51%、4.10%、3.41%、2.70%，合计持有公司 10,011.8696 万股，占公司总股本的比例为 67.62%，洪氏家族未间接持有公司股份，为公司的控股股东和实际控制人。

其中，洪俊城、洪娜珊系夫妻关系，洪俊城担任公司董事长、总经理，洪娜珊担任公司董事；洪耿奇、洪耿宇系洪氏夫妇之子，洪耿奇担任公司董事、副总经理，洪耿宇担任公司董事长助理、供应链中心副总经理；洪丽旋、洪丽冰系洪氏夫妇之女，洪丽旋担任公司副董事长，洪丽冰担任公司风控中心副总经理；洪记英系洪俊城之妹，担任公司高级顾问。自上市以来，公司控股股东、实际控制人未发生过变动，公司控股权亦未发生变动。

自 2017 年 12 月 29 日洪氏家族签署《一致行动协议》以来，洪氏家族在公司的重大决策过程中均保持了一致行动，《一致行动协议》中协议各方承诺：（1）协议各方一致承诺，在其作为满坤科技的股东期间，确保其全面履行本协议的义务；（2）协议各方应在公司股东大会投票表决前通过友好协商、讨论等方式就有关事宜达成一致表决意见。如经协商仍未能达成一致表决意见的，协议各方应按照各方持股比例就有关事宜进行内部表决，以持股比例少数服从多数的原则得出表决意见，在公司的股东大会投票表决时应依据协议各方内部协商或表决确定的表决意见予以表决，并以该表决意见的投票结果作为投票结果，确保一致行动。若协议各方按照各方持股比例进行内部表决时达成平票或无法得出多数表决意见，则以洪俊城的表决意见予以表决，并以其表决意见的投票结果作为投票结果，确保一致行动。（3）如各方现在或未来在公司担任董事的，担任公司董事的协议各方应在董事会会议表决前通过友好协商、讨论等方式就有关事宜达成一致表决意见。如经协商仍未能达成一致表决意见的，担任公司董事的协议各方应按照各方持股比例就有关事宜进行内部表决，以持股比例少数服从多数的原则得出表决意见，在公司的董事会会议投票表决时应依据担任董事的协议各方内部协商或表决确定的表决意见予以表决，并以该表决意见的

投票结果作为投票结果，确保一致行动。若协议各方按照各方持股比例进行内部表决时达成平票或无法得出多数表决意见，则以洪俊城的表决意见予以表决，并以其表决意见的投票结果作为投票结果，确保一致行动。

公司控股股东、实际控制人简历情况如下：

洪俊城先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000 年 4 月至 2004 年 2 月，担任深圳市若美电子有限公司董事、总经理；2003 年 12 月至 2004 年 6 月，担任深圳满坤电子监事；2004 年 6 月至 2009 年 10 月，担任深圳满坤电子执行董事；2004 年 6 月至 2024 年 4 月，担任深圳满坤电子总经理；2007 年 4 月至今，担任满坤电子（惠州）有限公司董事；2008 年 4 月至 2018 年 10 月，担任满坤有限董事、总经理；2013 年 6 月至 2017 年 12 月，担任江西省满坤电子科技有限公司执行董事、总经理；2014 年 11 月至 2020 年 7 月，担任香港满坤集团有限公司董事；2017 年 12 月至今，担任伟仁达董事；2018 年 10 月至 2022 年 9 月，担任公司董事长、总经理；2022 年 9 月至 2024 年 1 月，担任公司董事长；2024 年 1 月至今，担任公司董事长，总经理；2024 年 4 月至今，担任新加坡泰坤董事；2024 年 6 月至今，担任泰国泰坤董事。

洪娜珊女士，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年 12 月至 2004 年 6 月，担任深圳满坤电子执行董事、总经理；2004 年 6 月至 2024 年 4 月，担任深圳满坤电子监事；2007 年 4 月至今，担任满坤电子（惠州）有限公司董事长；2008 年 4 月至 2018 年 9 月，担任满坤有限监事；2012 年 9 月至今，担任香港满坤电子有限公司董事；2013 年 3 月至 2024 年 11 月，担任启明科技有限公司董事；2014 年 7 月至今，担任深圳市恒盈富达资产管理有限公司监事；2018 年 10 月至今，担任公司董事。

洪耿奇先生，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 4 月至 2021 年 2 月，担任 H&L（HONGKONG）DEVELOPMENT CO., LIMITED 董事；2016 年 11 月至 2018 年 10 月，历任满坤有限销售副总监、销售总监；2018 年 10 月至今，担任公司董事、副总经理；2024 年 4 月至今，

担任新加坡泰坤董事；2024年6月至今，担任泰国泰坤董事；2024年6月至今，担任深圳满坤科技执行董事、总经理。

洪耿宇先生，男，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年10月至今均在公司任职，目前担任公司董事长助理、供应链中心副总经理。

洪丽旋女士，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年4月至今，担任满坤电子（惠州）有限公司监事；2010年2月至2018年9月，历任深圳满坤电子总经理助理、合规总监，满坤有限总经理助理、财务经理、合规总监；2016年4月至2021年2月，担任H&L（HONGKONG）DEVELOPMENT CO., LIMITED董事；2018年10月至2023年6月，担任公司董事会秘书；2018年10月至今，担任公司董事；2020年4月至2022年1月，担任井冈山经济技术开发区满坤职业技术培训学校负责人；2020年9月至2020年11月，担任深圳零和投资有限公司执行董事、总经理；2022年9月至2024年6月，担任深圳满坤科技执行董事、总经理；2022年9月至2024年1月，担任公司总经理；2024年1月至今，担任公司副董事长。

洪丽冰女士，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至2019年10月，担任深圳满坤电子总经理助理；2019年10月至今，均在公司任职，历任公司资金主任、总经办主任、运营副总经理，现担任公司风控中心副总经理；2020年9月至2020年11月，担任深圳零和投资有限公司监事；2020年11月至2024年6月，担任深圳零和投资有限公司执行董事、总经理。

洪记英女士，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年4月至2018年10月，担任满坤有限采购部负责人；2009年10月至2024年4月，担任深圳满坤电子执行董事；2013年6月至2017年12月，担任江西省满坤电子科技有限公司监事；2018年10月至2022年12月，担任公司副总经理；2022年12月至今，担任公司高级顾问。

（二）控股股东和实际控制人所持股权质押情况

截至本募集说明书签署之日，公司控股股东及实际控制人持有的公司股份不存在质押的情况。

（三）控股股东及实际控制人投资的其他企业及兼职情况

截至 2026 年 6 月 30 日，控股股东及实际控制人投资的其他企业主要是满坤电子（惠州）有限公司、香港满坤电子有限公司及恒盈资本有限公司。

截至 2026 年 6 月 30 日，控股股东及实际控制人在发行人及其控股子公司以外主体的兼职情况如下：

姓名	职务	任职的其他单位名称	兼职职务	兼职单位与公司关系
洪俊城	董事长、总经理	满坤电子（惠州）有限公司	董事	关联公司
洪娜珊	董事	满坤电子（惠州）有限公司	董事长	关联公司
		香港满坤电子有限公司	董事	关联公司
		深圳市恒盈富达资产管理有限公司	监事	关联公司
洪丽旋	副董事长	满坤电子（惠州）有限公司	监事	关联公司

四、重要承诺及履行情况

（一）报告期内发行人、控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员作出的重要承诺及其履行情况

发行人及相关主体已作出的重要承诺及其履行情况参见发行人已于 2026 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）披露的《吉安满坤科技股份有限公司 2025 年年度报告》之“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

截至本募集说明书签署日，相关承诺人未出现违背承诺的情形。

（二）与本次发行相关的承诺

1、关于填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺

（1）公司控股股东、实际控制人

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出承诺如下：

“一、不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；

二、自本承诺函出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；

三、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应补偿责任。”

（2）公司董事、高级管理人员

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出承诺如下：

“（一）忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益；

（二）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（三）对本人的职务消费行为进行约束；

（四）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（五）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（六）如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（七）本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

（八）承诺函出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。”

2、关于持续满足债券余额不超过净资产 50%的承诺

本公司现就本次可转债发行相关事项作出如下承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，公司拟申请发行不超过人民币 76,000.00 万元（含人民币 76,000.00 万元）可转债，本次发行可转债的期限为自发行之日起六年。除前述情况外，公司不存在其他已发行、已注册未发行或拟注册的债务融资工具。

2、本公司承诺将综合考虑资金需求、净资产情况、资本结构、偿债能力、市场情况等因素，确保本次发行不会导致公司累计债券余额超过最近一期末净资产额的 50%。若本次可转债未出现终止注册的情况，公司计划在本次可转债发行前，不发行任何其他计入累计债券余额的公司债及企业债，并且不向相关监管机构提交公司债/企业债的注册/备案申请文件。”

3、发行人控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员针对认购本次可转债的说明及承诺

公司持股 5%以上股东及董事、高级管理人员将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。

(1) 控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东承诺

“1、若本人、本人之配偶、父母、子女（以下合称“关系密切的家庭成员”）在本次可转换公司债券发行期首日起前六个月存在减持公司股票的情形，本人承诺本人及关系密切的家庭成员不参与本次可转换公司债券的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转换公司债券的发行认购。

2、若在本次可转换公司债券发行首日前六个月内，本人及关系密切的家庭成员不存在减持公司股票的情形，将根据本次发行时的市场情况及资金安排决定是否参与本次可转换公司债券的认购，并严格履行相应信息披露义务。若认购成功，本人承诺本人及关系密切的家庭成员、一致行动人严格遵守相关法律法规关于短线交易的要求，自本次可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转换公司债券发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转换公司债券。

3、本人自愿作出本承诺，并自愿接受本承诺的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反本承诺减持公司股票或可转换公司债券，因此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

(2) 其他董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺

“1、若本人、本人之配偶、父母、子女（以下合称“关系密切的家庭成员”）在本次可转换公司债券发行期首日起前六个月存在减持公司股票的情形，本人承诺本人及关系密切的家庭成员、一致行动人不参与本次可转换公司债券的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转换公司债券的发行认购。

2、若在本次可转换公司债券发行首日前六个月内，本人及关系密切的家庭成员不存在减持公司股票的情形，将根据本次发行时的市场情况及资金安排决定是否参与本次可转换公司债券的认购，并严格履行相应信息披露义务。若认购成功，本人承诺本人及关系密切的家庭成员严格遵守相关法律法规关于短线交易的要求，自本次可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转换公司债券发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转换公司债券。

3、本人自愿作出本承诺，并自愿接受本承诺的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反本承诺减持公司股票或可转换公司债券，因此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

(3) 独立董事承诺

“1、本人承诺本人及本人配偶、父母、子女不参与认购满坤科技本次向不特定对象发行的可转换公司债券，亦不会委托其他主体参与本次可转换公司债券的发行认购。

2、本人自愿作出本承诺，并自愿接受本承诺的约束。如本人及本人之配偶、父母、子女违反上述承诺，因此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

五、董事、高级管理人员及其他核心人员

(一) 现任董事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况

截至本募集说明书出具之日，公司现任董事、高级管理人员及其他核心人员基本情况如下：

单位：万元

序号	姓名	性别	年龄	职务	2025 年从公司领取税前报酬总额
1	洪俊城	男	64	董事长、总经理	117.75
2	洪娜珊	女	65	董事	-
3	洪耿奇	男	34	董事、副总经理	111.97
4	洪丽旋	女	40	副董事长	84.90
5	刘晓波	男	50	职工董事	41.62
6	刘宝华	男	39	独立董事	8.00
7	徐艳萍	女	38	独立董事	8.00
8	张晗	女	40	独立董事	8.00
9	耿久艳	女	43	董事会秘书、财务总监	83.02

根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》及

中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

2025年8月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案。为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，发行人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》相关内容予以修订。公司董事会已设立审计委员会，由徐艳萍、刘宝华、洪娜珊三位董事组成，其中徐艳萍任主任委员。

（二）现任董事、高级管理人员及其他核心人员的简历

1、董事

洪俊城先生，参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人”。

洪娜珊女士，参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人”。

洪耿奇先生，参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人”。

洪丽旋女士，参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人”。

刘晓波先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年10月至2012年7月，历任东莞普思电子有限公司采购工程师，捷普电子（广州）有限公司高级工程师，中山欧科电子有限公司采购主管及采购经理；2012年9月至2017年10月，担任深南电路股份有限公司供应链经理；2017年11月至2018年11月，担任奥士康科技股份有限公司计划物控处长；2018年12月至2021年4月，担任胜宏科技（惠州）股份有限公司订单管理总监、销

售总监；2021年5月至2025年7月，担任公司市场总监、销售副总；2025年8月至今，担任公司销售中心副总经理、职工代表董事。

刘宝华先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2016年7月至2019年9月，担任西南交通大学经济管理学院讲师；2019年9月至2021年9月，担任四川大学商学院特聘副研究员；2021年9月至今，担任四川大学商学院会计学副教授；2023年11月至今，担任富森美（002818.SZ）独立董事；2025年12月至今，担任成都迈科康生物科技股份有限公司独立董事；2024年11月至今，担任公司独立董事。

徐艳萍女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2016年7月至2019年10月，担任暨南大学会计学助理教授；2019年10月至2023年12月，担任暨南大学会计学副教授；2023年6月至2025年10月，担任珠海农村商业银行股份有限公司监事；2024年5月至今，担任中山大学会计学副教授；2024年11月至今，担任公司独立董事。

张晗女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年11月至2018年11月，担任北京国枫（深圳）律师事务所律师；2018年11月至2023年4月，担任广东华商律师事务所合伙人；2023年5月至今，担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人；2024年11月至今，担任公司独立董事。

2、除董事以外的高级管理人员

耿久艳女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师非执业会员。2007年10月至2011年9月，担任安永华明会计师事务所深圳分所高级审计员；2011年10月至2015年3月，担任泰龙拉链（深圳）有限公司财务经理；2015年7月至2016年11月，担任深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司董事会秘书；2016年8月至2022年6月，担任深圳市卓硕电子股份有限公司董事；2017年2月至2019年5月，担任深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司董事；2019年9月至2022年10月，担任深圳满坤电子财务经理；2022年9月至2023年1月，担任深圳满坤科技财务经理；2023年1月

至 2023 年 6 月，担任公司内部审计负责人；2023 年 6 月至今，担任公司董事会秘书；2024 年 12 月至今，担任公司财务总监。

3、其他核心人员

肖学慧先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2006 年 10 月，担任东莞红板多层线路板有限公司工程部工程师；2006 年 10 月至 2010 年 3 月，担任东莞同昌电子有限公司工程部副经理；2010 年 3 月至 2011 年 6 月，担任深圳市星河电路股份有限公司工程部经理；2011 年 6 月至今，历任满坤有限及公司工程部经理、董事长助理、客户项目技术管理部副总经理、二厂厂长、总监；2018 年 10 月至 2025 年 8 月，担任公司监事会主席。

邹伟强先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 7 月，担任健鼎（无锡）电子有限公司客诉组组长；2015 年 4 月至 2017 年 6 月，先后担任江门崇达电路技术有限公司工程师及主管；2019 年 7 月至 2020 年 6 月，担任公司品质主管；2020 年 7 月至 2022 年 9 月，担任吉安生益电子有限公司品质主管；2022 年 10 月至今，先后担任公司制造中心品质经理、总监。

张先鲁先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006 年 11 月至 2020 年 4 月，先后担任志超科技股份有限公司 FQC 课长、IPQC 课长、IPQC 副主任及品质部主任等；2021 年 2 月至今，先后担任公司销售中心光电产品经理、总监。在任职期间，先后参与 5 项江西省新产品试制计划项目，其中 2 项产品获得江西省优秀新产品三等奖；作为专利发明人获得 2 项发明专利、1 项实用新型专利。

（三）现任董事、高级管理人员及其他核心人员的对外兼职情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司董事洪俊城、洪娜珊、洪耿奇和洪丽旋对外投资及兼职情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东和

实际控制人基本情况”之“（三）控股股东及实际控制人投资的其他企业及兼职情况”。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司除控股股东、实际控制人外的董事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位名称	担任职务	兼职单位与公司关系
刘宝华	独立董事	成都富森美家居股份有限公司	独立董事	无
		成都迈科康生物科技股份有限公司	独立董事	无
		四川大学商学院	副教授	无
徐艳萍	独立董事	中山大学	副教授	无
张晗	独立董事	北京市竞天公诚（深圳）律师事务所	合伙人	无

（四）现任董事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股份及变动情况

截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股份情况如下：

姓名	职务	持股方式	持股比例
洪俊城	董事长、总经理	直接持股	13.51%
洪娜珊	董事	直接持股	13.51%
洪耿奇	董事、副总经理	直接持股	16.88%
洪丽旋	副董事长	直接持股	4.10%
刘晓波	职工代表董事	间接持股	通过吉安市明德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有比例合计为 0.0041%
刘宝华	独立董事	-	-
徐艳萍	独立董事	-	-
张晗	独立董事	-	-
耿久艳	董事会秘书、财务总监	直接和间接持股	直接持有及通过吉安市信德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有比例合计为 0.03%
肖学慧	核心技术人员	直接和间接持股	直接持有及通过吉安市明德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）和吉安市信德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有比例合计为 0.11%
邹伟强	核心技术人员	-	-
张先鲁	核心技术人员	-	-

（五）发行人董事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况

1、董事变动情况

报告期初，公司董事由洪俊城、洪娜珊、洪耿奇、洪丽旋、罗宏、刘娥平、张清伟担任。

2024年1月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，选举洪丽旋女士为第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2024年10月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司有提名资格的股东提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名洪俊城先生、洪娜珊女士、洪耿奇先生、洪丽旋女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

2024年11月13日，经公司2024年第二次临时股东大会审议，选举洪俊城先生、洪娜珊女士、洪耿奇先生、洪丽旋女士为公司第三届董事会非独立董事；选举刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。

2024年11月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举洪俊城先生为公司第三届董事会董事长，选举洪丽旋女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2025年8月13日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举刘晓波先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

报告期内，公司董事未发生其他变动。

2、取消监事会前在任监事会成员变动情况

报告期初，公司监事由肖学慧、彭威、杨向丽担任。

2024 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司有提名资格的股东提名，公司监事会同意提名肖学慧先生、彭威女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2024 年 11 月 12 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举吴泽燕女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2024 年 11 月 13 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议，选举肖学慧先生、彭威女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》

《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

2025 年 8 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案。为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，发行人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》相关内容予以修订。

报告期内，公司监事未发生其他变动。

3、高级管理人员的变动情况

报告期初，公司高级管理人员为总经理洪俊城、副总经理洪耿奇、董事会秘书洪丽旋、副总经理洪记英、财务总监胡小彬。

2022年9月9日，洪俊城先生申请辞去公司总经理职务，公司召开第二届董事会第四次会议，聘任洪丽旋女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2022年12月17日，洪记英女士辞去公司副总经理职务，公司召开第二届董事会第七次会议，聘任雷成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2023年6月30日，洪丽旋女士辞去公司董事会秘书职务，胡小彬先生辞去公司财务总监职务。公司召开第二届董事会第十一次会议，聘任何惠红女士为公司财务总监，聘任耿久艳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2023年7月28日，雷成先生辞去公司副总经理职务。

2024年1月16日，洪丽旋女士辞去公司总经理职务，公司召开第二届董事会第十八次会议，聘任洪俊城先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2024年11月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任洪俊城先生担任公司总经理，聘任洪耿奇先生担任公司副总经理，聘任何惠红女士担任公司财务总监，聘任耿久艳女士担任公司董事会秘书，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2024年12月30日，何惠红女士辞去公司财务总监职务，公司召开第三届董事会第二次会议，聘任耿久艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

报告期内，公司高级管理人员未发生其他变动。

4、其他核心人员的变动情况

报告期初，公司核心技术人员为肖学慧、廖乐华。2022 年 10 月，廖乐华自公司离职。

报告期内，公司核心技术人员除肖学慧外，新增邹伟强及张先鲁等人员。

（六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，2023 年 8 月 31 日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师出具相应报告。

2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 10 日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到对本次拟首次授予激励对象提出的任何异议，并于 2023 年 9 月 14 日披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司于 2023 年 9 月 14 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2023 年 9 月 19 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2023 年 9 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，律师出具了相应报告。

2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，2024 年 9 月 2 日，公司分别召开第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，律师出具了相应报告。

2024 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，2024 年 9 月 26 日，公司分别召开第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，律师出具了相应报告。

2025 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，2025 年 7 月 29 日，公司分别召开第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，律师出具相应报告。

2026 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会独立董事第四次专门会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会同意作废《激励计划》首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票 86.8532 万股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票 28.494 万股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。本次作废完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划实施完毕。

除上述情况以外，公司不存在正在实施的股权激励（如员工持股计划、限

制性股票、股票期权）及其他制度安排和执行情况。

六、公司所处行业的基本情况

（一）发行人所处行业概况

公司主营业务为印制电路板（Printed Circuit Board）的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”之“C3982 电子电路制造”；根据国家统计局印发的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”项下的“新型电子元器件及设备制造”行业。

公司是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业。印制电路板主要为电子信息产品中的电子元器件提供预定电路的连接、支撑等功能，发挥了信号传输、电源供给等重要作用。公司主要产品为单/双面、多层高精密印制电路板，产品以刚性板为主，广泛应用于汽车电子、通信电子、消费电子、工控安防等领域。

（二）行业主管部门和监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门

工信部是印制电路板行业的主管部门，负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

2、行业自律性协会

中国电子电路行业协会（CPCA）是 PCB 行业的自律组织，由电子电路（PCB）、覆铜薄板（CCL）、原辅材料、专用设备及电子装联（SMT）和电子

制造服务（EMS）企业以及相关科研院校自愿结成的全国性、行业性社会团体。中国电子电路行业协会主要职责包括：开展对本行业的基础资料 and 市场的调查、搜集、统计、整理和交流工作，并积极向政府部门提出制定行业规划、经济和技术政策、技术标准及经济立法等方面的建议，及时向有关部门和会员单位提供情况、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作等。

3、行业主要法律法规和政策

电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，印制电路板作为电子信息产业的基础产品，国家相继推出了一系列扶持和鼓励印制电路板行业发展的产业政策，从而推进行业的产业升级及战略性调整。

序号	名称	发布机构	发布时间	主要内容
1	《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	中共中央	2025 年	推动技术改造升级，促进制造业数智化转型，发展智能制造、绿色制造、服务型制造，加快产业模式和企业组织形态变革。增强质量技术基础能力，强化标准引领、提升国际化水平，加强品牌建设。
2	《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	国务院	2025 年	该文件指出，到 2027 年率先实现人工智能与 6 大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到 2030 年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。
3	《机械工业数字化转型实施方案》	工业和信息化部等八部门	2025 年	旨在研制一批智能装备、建设一批智能工厂、拓展一批智慧服务，推动机械工业高端化、智能化、绿色化发展，为推进新型工业化提供坚实的技术装备保障。

序号	名称	发布机构	发布时间	主要内容
4	《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》	工业和信息化部	2024 年	提出以电子元器件及电子材料生产检测设备的自动化、智能化、柔性化、节能化改造为重点，推动电子元器件产品向集成化、高频化、高精度、高可靠发展，加快微型化、高频化产品研发。
5	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	工业和信息化部等七部门	2024 年	重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展，下游应用领域的拓展将推动 PCB 产业升级扩容。
6	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	国家发展和改革委员会	2023 年	将“高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板、高密度高细线路（线宽/线距 $\leq 0.05\text{mm}$ ）柔性电路板”列为“鼓励类”产业。
7	《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》	工业和信息化部、财政部	2023 年	提出 2023 至 2024 年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速 5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破 24 万亿元，推动电子信息制造业包括 PCB 行业的稳定增长。
8	《“十四五”数字经济发展规划》	国务院	2022 年	实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。
9	《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》	国家统计局	2021 年	印刷电路板被列入数字经济核心产业。
10	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》	工业和信息化部	2021 年	连接类元器件中，重点发展高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板。
11	《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》	国家发展和改革委员会、商务部	2020 年	明确将“高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板、高密度高细线路（线宽/线距 $\leq 0.05\text{mm}$ ）柔性电路板”列入鼓励外商投资产业目录。
12	《新能源汽车产业	国务院办公	2020 年	支持基础元器件、关键生产装备、

序号	名称	发布机构	发布时间	主要内容
	发展规划（2021-2035年）》	厅		高端试验仪器、开发工具、高性能自动检测设备等基础共性技术研发创新。

（三）行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况和未来发展趋势

1、印制电路板简介

印制电路板，又称印刷电路板或印刷线路板，是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板，主要由绝缘基材与导体两类材料组成，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起到中继传输的作用。作为电子零件装载的基板和关键互连件，印制电路板的制造品质不但直接影响电子产品的可靠性，而且影响系统产品整体竞争力，因此被称为“电子系统产品之母”。PCB 行业作为应用电子信息产品行业的基础行业，应用行业涵盖范围广泛，承载着汽车电子、消费电子、工业控制、通信电子、医疗健康、航空军事和半导体等下游应用领域的发展。

2、印制电路板的分类

印制电路板行业分类方法较多，结合产品主要特点和通用的分类方法，印制电路板可以分为以下几类：

产品种类			产品特征	应用领域
刚性板	单面板		最基本的印制电路板，零件集中在其中一面，导线则集中在另一面上	普通家电、电子遥控器和简单的电子产品等
	双面板		在基材的两面都有布线，两面间有适当电路连接，可以用于较复杂的电路上	消费电子、计算机、汽车电子、通信设备、工业控制等
	多层板		四层及以上导电图形与绝缘材料压制而成，层间导电图形通过导孔进行互连	消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、军工、航空航天等
	特种板	HDI 板	高密度互连（High Density Interconnect）板，具有高密度化、精细导线化、微小孔径化等特性，HDI 板一般采用积层法制造，采用激光打孔技术对积层进行打孔导通，使整	智能手机、平板电脑、通信设备、计算机、汽车电子、工业控制、医疗设备等

产品种类			产品特征	应用领域
			块印制电路板形成了以埋、盲孔为主要导通方式的层间连接	
		厚铜板	任何一层铜厚为 2oz 及以上的印制电路板，厚铜板可以承载大电流和高电压，同时具有良好的散热性能，厚铜板由于线路铜厚较厚，对压合层间粘结剂填胶、钻孔、电镀等工艺要求较高	工业电源、军工电源、发动机设备等
		高频板	高频板是指使用特殊的低介电常数、低信号损耗材料生产出来的印制电路板，具有较高的电磁频率。一般来说，高频可定义为频率在 1GHz 以上。高频板对信号完整性要求较高，材料加工难度较大，具体体现在对图形精度、层间对准度和阻抗控制方面要求更为严格	通信基站、服务器/存储器、微波传输、卫星通信、导航雷达等
		高速板	高速板是由低信号损耗的高速材料压制而成的印制电路板，主要承担芯片组间与芯片组与外设间高速电路信号的数据传输、处理与计算，以实现芯片的运算及信号处理功能。高速板对精细线路加工及特性阻抗控制技术 & 插入损耗控制要求较高	通信和服务器、存储器、交换机等领域
		金属基板	由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制电路板，金属基板具有散热性好、机械加工性能佳等特点，主要应用于发热量较大的电子系统中	汽车电子、通信无线基站、微波通信等
		内埋器件板	是将电子元件嵌埋至线路板内部，从而使电路板模块具有小型化，缩短元件之间的连接路径，降低传输损失等优点	便携电子设备、消费电子、汽车等
挠性板			简称软板或 FPC，以柔性绝缘基材制成的印制电路板，具有轻薄、可弯曲的特点	智能手机、医疗设备、便携式电子设备、可穿戴智能设备等
封装基板			又称“IC 载板”，直接用于搭载芯片，可为芯片提供封装、电连接、保护、散热等功能	各类电子设备的芯片封装

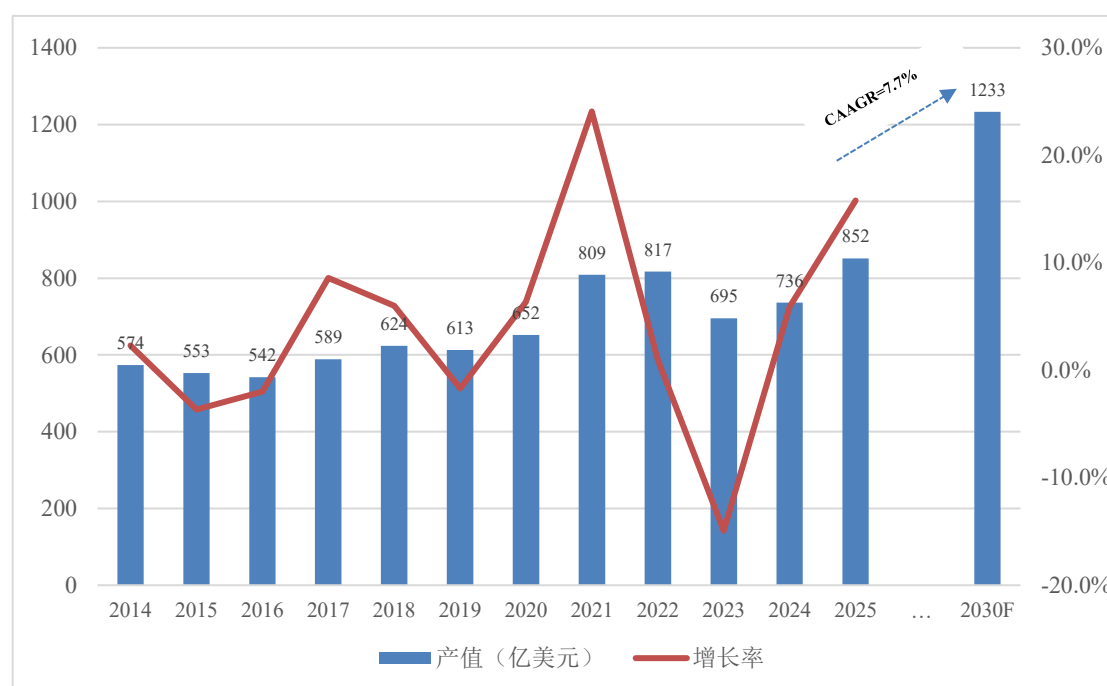
3、行业发展概况及发展前景

(1) 全球印制电路板市场概况

1) 市场规模

PCB 广泛应用于汽车电子、消费电子、通信电子、计算机、工控医疗、航空航天等领域，是现代电子产品中不可或缺的电子元器件。根据 Prismark 数据，2025 年全球 PCB 产业总产值为 851.52 亿美元，同比增长 15.8%。在智能化、低碳化趋势推动下，人工智能、新能源汽车、5G/6G 通信、物联网及智能终端等下游应用将持续扩张，带动 PCB 需求稳步增长。Prismark 预计，2030 年全球 PCB 产值将达 1,233.48 亿美元，2025 年至 2030 年复合年增长率约为 7.7%。

2014-2030 年全球 PCB 产值及增长率（亿美元）



数据来源：Prismark

2) 全球 PCB 产业分布

近年来凭借中国大陆、中国台湾及东南亚在劳动力、资源、政策及产业集聚等方面的综合优势，全球电子制造业产能持续向亚洲地区转移，形成了以中国大陆、中国台湾、东南亚等地为制造中心的产业格局。2006 年，中国大陆超越日本成为全球第一大 PCB 生产地区，产量与产值均居世界首位。此后，亚洲地区在全球 PCB 市场的主导地位进一步巩固，自 2013 年以来，亚洲 PCB 产量占全球比重已超过 90%，中国自 2016 年起全球产量占比超过 50%，并持续保持领先。近年来，在下游电子行业产业转移的带动下，东南亚地区（主要是泰

国、越南、马来西亚）基于税收、政策、物流、人工等优势，承接了来自全球的大量 PCB 产业转移，因此东南亚地区 PCB 产值保持较高增速。

2025-2030 年全球 PCB 产值年均复合增长率预测（按地区）

单位：亿美元

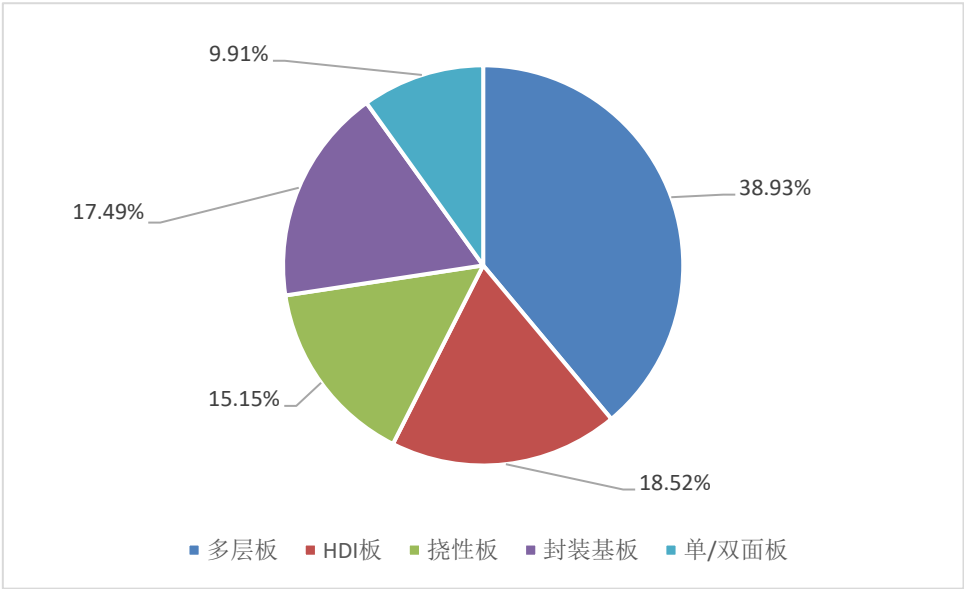
地区	2025 年产值	增长率	2030 年产值（预估）	复合增长率（预估）
中国大陆	489.69	19.20%	685.35	7.00%
中国台湾	99.02	14.10%	146.02	8.10%
亚洲	141.22	11.09%	236.55	10.87%
日本	64.99	11.30%	94.68	7.80%
美洲	37.96	7.50%	47.81	4.70%
欧洲	18.64	13.80%	23.07	4.40%
合计	851.52	15.80%	1,233.48	7.70%

数据来源：Prismark，本表中亚洲指除中国、日本外的其他亚洲国家或地区。

3）全球 PCB 产品结构

根据 Prismark 统计，2025 年全球 PCB 细分产品的市场结构如下：

2025 年全球 PCB 细分产品结构



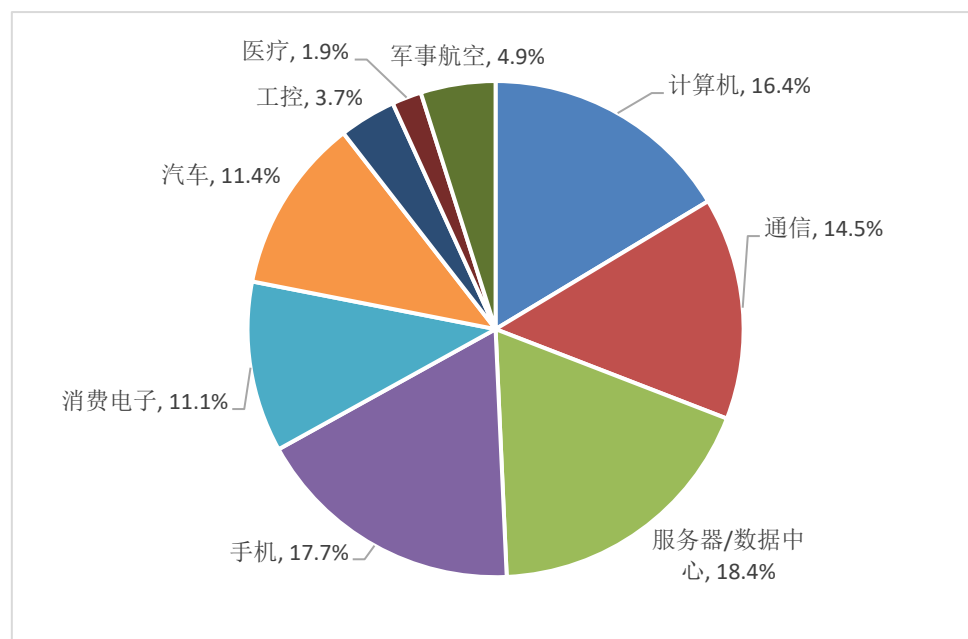
数据来源：Prismark

在全球 PCB 细分产品结构中，刚性板市场规模最大，其中多层板占比 38.93%，单/双面板占比 9.91%，HDI 板占比 18.52%；其次是封装基板，占比约 17.49%；挠性板占比约 15.15%。随着电子电路技术的快速发展，元器件集成度不断提高，电子产品对 PCB 高密度化的需求更加突出。未来在高速网络、人工智能、服务器/数据储存、汽车电子、卫星通讯等下游行业需求增长驱动下，高多层板、HDI 板的市场需求将以领先于行业整体增速而持续增长。

4) 全球 PCB 下游应用领域

全球 PCB 下游应用市场分布广泛，具体情况如下：

2025 年全球 PCB 下游应用领域情况



数据来源：Prismark

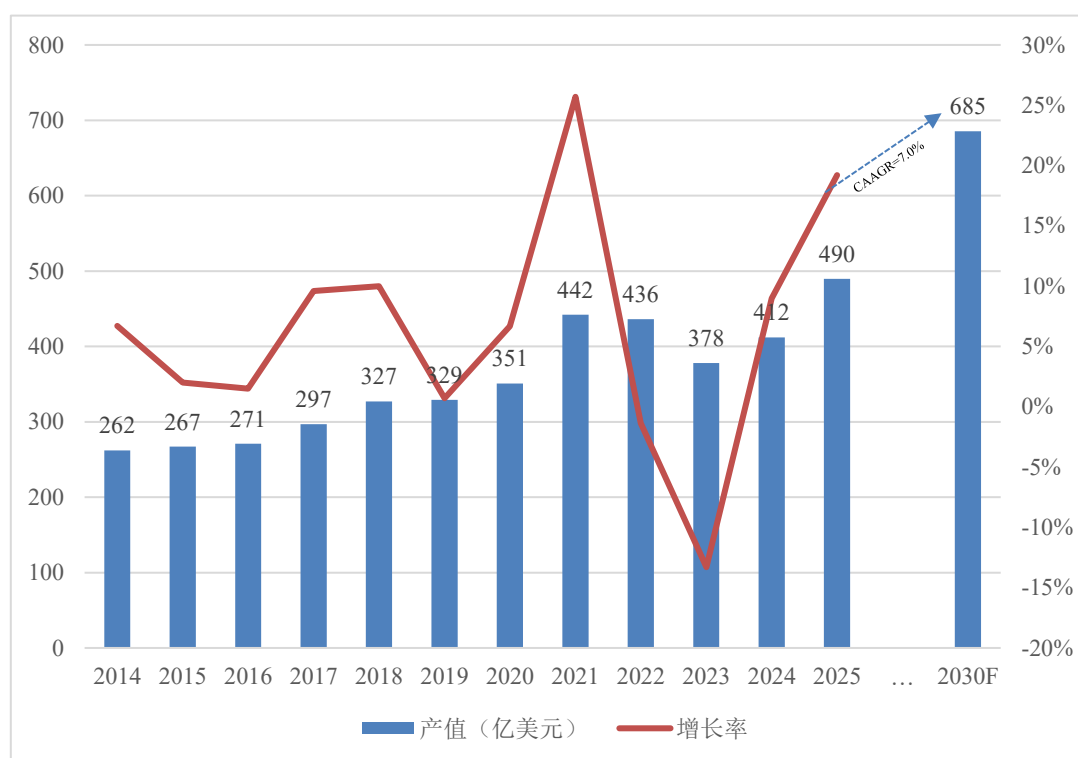
PCB 行业与下游电子信息产业的发展紧密相关。根据 Prismark 数据，2025 年 PCB 主要应用领域中，手机、计算机以及服务器/数据中心分别占据较高比重分别为 17.7%、16.4%以及 18.4%；其中，受 AI 数据中心投资驱动，服务器/数据存储板块在 2025 年同比增长 43.6%，成为 PCB 需求增长的重要驱动力。2025 年汽车电子领域产值约为 2,780 亿美元，随着新能源汽车渗透率持续提升、车联网与高级驾驶辅助（ADAS）技术快速发展，预计 2025 年至 2030 年汽车电子市场将保持约 3.9%的年均复合增长率。

（2）中国大陆 PCB 市场概况

1）中国大陆 PCB 市场规模

根据 Prismark 数据，2025 年中国大陆 PCB 产业产值为 489.69 亿美元，占全球市场的 57.51%。2025 年至 2030 年，中国大陆 PCB 市场年均复合增长率将达 7.0%，产业前景广阔。

2014-2030 年中国大陆 PCB 产值及增长率（亿美元）

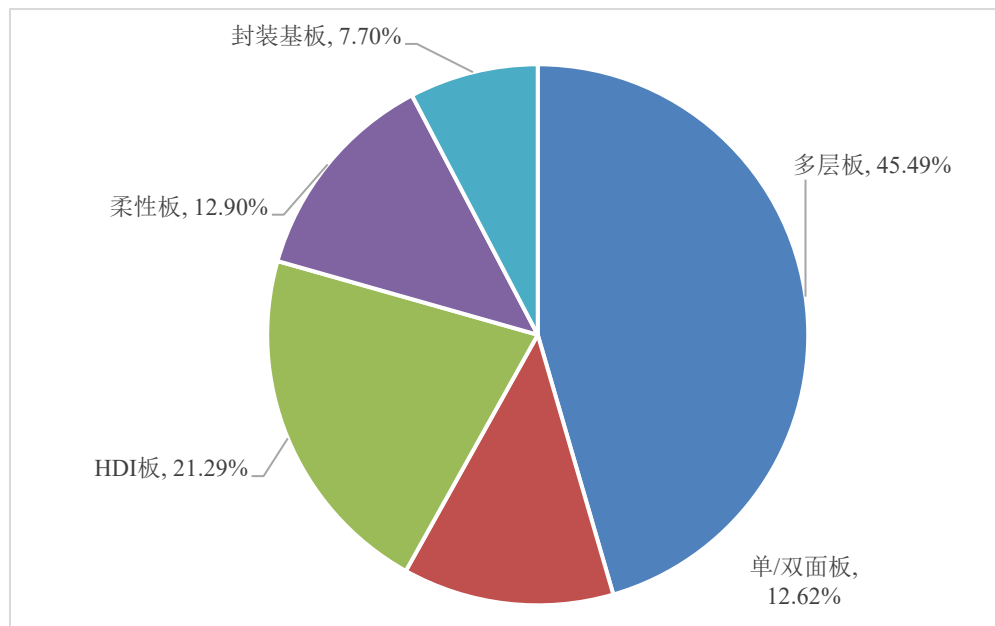


数据来源：Prismark

2）中国大陆 PCB 产品结构

根据 Prismark 统计，2025 年中国大陆刚性板依旧是市场主体，其中多层板占比达 45.49%，单/双面板占比为 12.62%；其次为 HDI 板，占 21.29%；FPC 与封装基板的占比分别为 12.90%和 7.70%。从中长期趋势看，人工智能、高速通信及汽车电子等领域的强劲需求将持续推动高端 HDI、多层板以及封装基板等细分领域的发展。根据 Prismark 预测，2025 年至 2030 年中国大陆 18 层及以上高多层板、HDI 板与 FPC 板的年均复合增长率分别可达 21.6%、9.1%、3.9%。

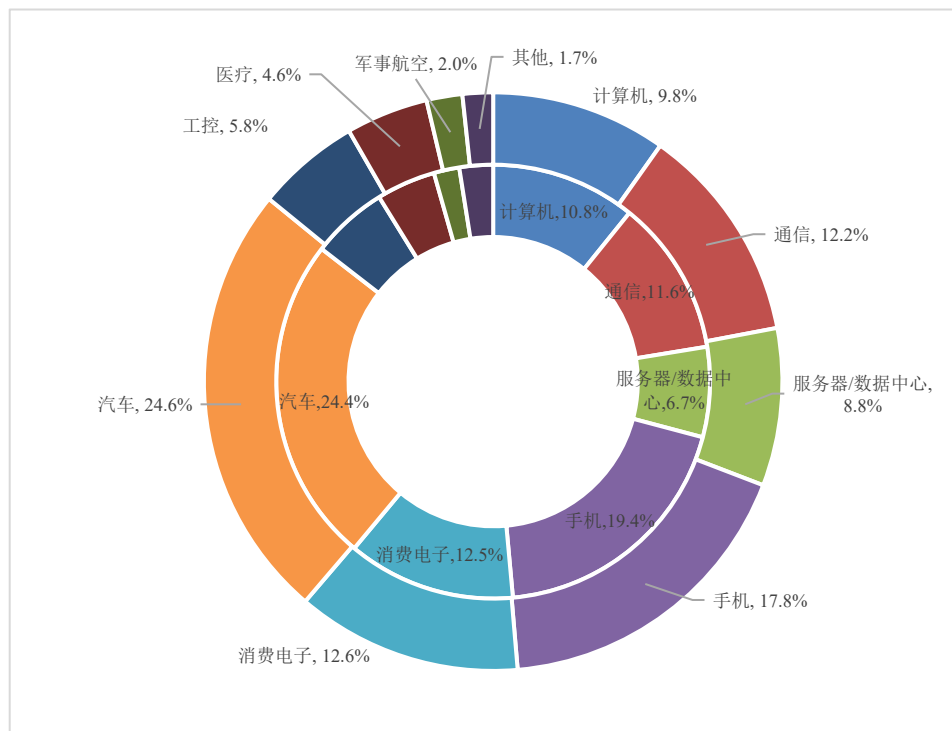
2025 年中国大陆 PCB 细分产品结构



数据来源：Prismark

3) 中国大陆 PCB 下游应用领域

根据 CPCA 数据，2024 年中国大陆 PCB 应用领域中占比最高的是汽车电子，市场份额约为 24.6%；其次为手机，占比约 17.8%；消费电子和通信设备的市场份额分列第三、第四，分别占比 12.6%和 12.2%；计算机占比约 9.8%，服务器/数据中心占比 8.8%；工业控制和医疗电子占比分别为 5.8%、4.6%。与 2023 年相比，服务器/数据中心板块占比由 6.7%显著提升至 8.8%，主要是受 AI 服务器和云计算基础设施投资快速增长带动。

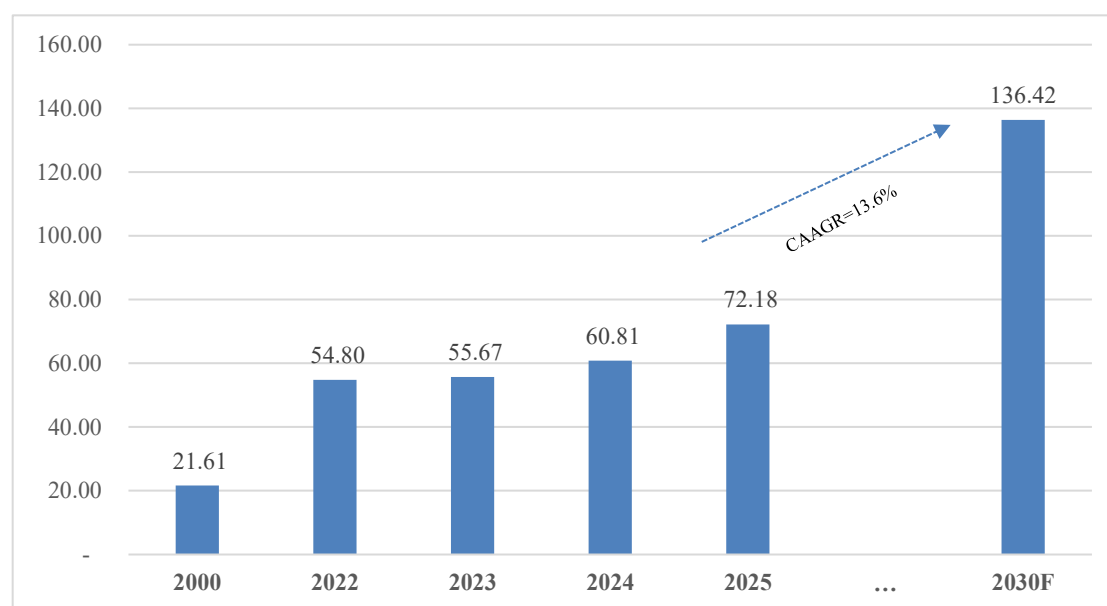
2023-2024 年中国大陆 PCB 下游应用领域情况

数据来源：CPCA（内环为 2023 年数据，外环为 2024 年数据）

（3）东南亚及泰国 PCB 市场概况

近年来，随着“一带一路”、RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）等区域合作政策的倡导，以及国际贸易摩擦、地缘政治冲突等外部环境影响，东南亚在 PCB 产业领域的投资政策、市场潜力、人工成本等方面的竞争优势逐渐凸显。根据 Prismark 数据显示，东南亚及其他地区的 PCB 产值预计将在 2030 年达到 136.42 亿美元，2025 年至 2030 年间的年均复合增长率高达 13.6%，成为全球 PCB 产业中增速最快的区域。近年来，越来越多的日本、韩国、中国台湾和中国大陆电路板企业开始在东南亚投资建厂，其中包括 A 股沪电股份、中京电子、奥士康、生益电子、中富电路，日本 CMK、Kyoden，中国台湾的泰鼎、敬鹏、瀚宇博德、竞国、欣兴、和硕，以及韩国的三星电机等企业，纷纷在泰国、越南、马来西亚设立生产基地，推动该地区 PCB 产业链成熟度及市场份额的快速提升。

2000-2030 年东南亚及其他地区 PCB 产值（亿美元）



数据来源：Prismark

泰国作为新兴市场经济体，凭借土地资源、基础设施建设、税收优惠、供应链等多方面的比较优势承接了大量 PCB 下游应用行业的产业转移，大量电子制造、汽车生产厂商已经在泰国布局生产基地，相应地增加了对于 PCB 的采购需求。

泰国的汽车产业具有显著优势，是东盟最大的汽车生产国和第二大汽车销售市场。泰国政府自 2022 年起出台多项政策，积极扶持电动汽车及零部件产业，推动汽车电子零件和设备制造业升级。全球知名汽车及零配件制造商，包括比亚迪、长安汽车、长城汽车、广汽埃安在内的整车厂商也纷纷在泰国建立生产基地，中国车企在泰国的布局呈现加速趋势，在税收优惠和政策补贴的推动下，泰国新能源汽车市场迎来了爆发式增长。汽车产业的兴起带动了汽车电子 PCB 需求的快速增长。

国内动力电池、光伏和储能厂商如宁德时代、中创新航、国轩高科、阳光电源、天合光能、阿特斯、润阳科技等也先后在泰国建设了工厂，部分企业已启动本地化生产，泰国已成为中国新能源企业在东盟布局的关键节点。此外，泰国还是全球计算机硬盘配件及驱动器的重要生产基地，拥有完善的机械硬盘产业链，西部数据、希捷、日立等主流硬盘厂商均在泰国设厂。下游应用产业的蓬勃发展，将持续推动东南亚地区 PCB 市场需求的扩大，并进一步确立东南

亚在全球 PCB 产业格局中的战略地位。

4、影响行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

1) 国家产业政策的出台为 PCB 行业发展提供支持指引

电子信息产业是我国重点发展的战略性支柱产业，印制电路板作为电子信息产品的基础产品，国家相继推出了一系列扶持和鼓励印制电路板行业发展的产业政策，将 PCB 相关产品列为重点发展对象，从而推进行业的产业升级与结构调整。2023 年，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，将高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板、高密度高细线路柔性电路板等列为鼓励类产业；《“十四五”智能制造发展规划》指出，制造业企业立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。上述技术进步与应用领域革新均需要使用印制电路板，相关领域的技术革新将会给印制电路板行业持续带来新的增长机会。

随着国家“一带一路”倡议深入推进，越来越多中国企业选择走向海外，其中东南亚地区是中国周边外交政策的优先方向。国内外多家 PCB 厂商先后选择东南亚地区进行投资设厂，开拓国际市场，承接海外客户市场订单。国家产业政策的支持为我国 PCB 行业持续发展提供了保障，并为行业的发展提供了方向指引。

2) 中国电子行业产业链完整

中国电子信息产业一直保持快速发展，带动了产业链上下游的快速发展。目前中国电子行业规模大、配套能力强、产业集聚效应明显。中国印制电路板行业上游行业发展迅速，主要原材料覆铜板、半固化片、铜箔等厂商生产供应能力强，能快速响应 PCB 企业的需求。PCB 行业作为电子信息产业的基础行业，

在产业链中起承上启下的关键作用，完整的产业链使 PCB 企业既能快速采购原材料，又能快速响应客户需求，保障 PCB 产业稳定发展。2020 年以来，面对全球宏观经济波动、国际贸易摩擦等重大事件，受益于国内产业链相对完整，中国 PCB 产业整体上仍实现了稳健发展。

3) 下游市场的蓬勃发展为 PCB 行业需求增长提供重要支撑

印制电路板的下游行业广泛，包括工业控制、通讯设备、计算机、消费电子、汽车电子、军事航空、医疗器械等。广泛的应用分布为印制电路板行业提供巨大的市场空间，降低了行业发展的风险。下游领域对 PCB 产品的高系统集成、高性能化的要求推动了 PCB 产品不断朝着“轻、薄、短、小”的方向迭代升级；另一方面，PCB 行业的技术革新为下游领域产品的推陈出新提供了新的可能性。随着云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术、新应用不断涌现，5G 网络建设的大规模推进及商用，新能源汽车渗透率不断提高，汽车电子化程度、自动驾驶技术和车联网不断发展，PCB 产业将迎来新一轮的快速发展。PCB 应用行业的技术革新以及新兴产业的发展为 PCB 行业带来新机遇，为 PCB 市场发展提供了重要支撑。

(2) 不利因素

1) 技术水平存在一定差距

目前，中国的 PCB 行业产值已经稳居全球第一位，但与欧美、日韩等 PCB 强国相比，中国承接的高端产值比例依然低于外资企业。根据中国电子电路行业协会（CPCA）统计数据，我国在 18 层以上电路板领域的产值相对较低；中国企业在生产技术、产品研发方面投入强度不足导致 PCB 行业基础技术与开发相对薄弱；中国院校的人才培养机制不完善造成科研人才缺乏，这些因素在一定程度上制约了 PCB 制造企业的发展。

2) 市场竞争程度加剧

PCB 行业作为电子元器件的基础行业，在全球主要经济体经济增长率放缓的背景下，PCB 行业产值整体增长规模有限，这也使得 PCB 生产企业竞争更加

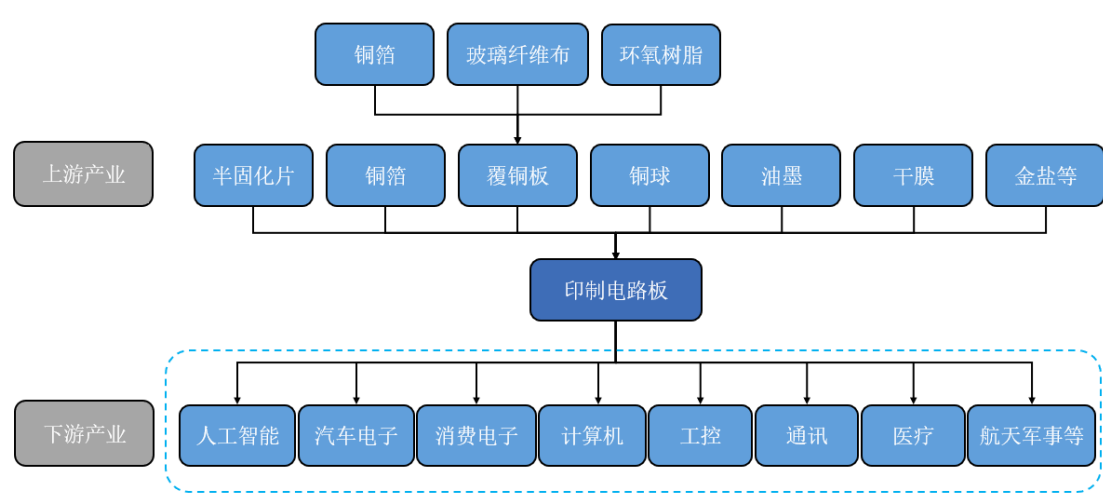
激烈。同时，随着国内外 PCB 厂商陆续布局产能扩张项目，市场竞争日趋激烈，行业集中度日益提升，部分落后的中小企业将逐步退出市场，产能优势将集中到龙头企业。

3) 安全生产、环境保护等监管要求不断提高

当前政府主管部门对企业安全生产和环境保护的要求不断提升，相关法律法规的标准保持从严趋势，执法力度不断加大，舆论监督的关注度也在不断提高，一方面带动了企业安全生产和环境保护水平的提高，有利于经济的可持续发展，另一方面也增加了企业的前期投入和生产成本，使企业面临更大的竞争压力。

5、发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游发展状况

公司所处 PCB 行业上下游产业链情况如下：



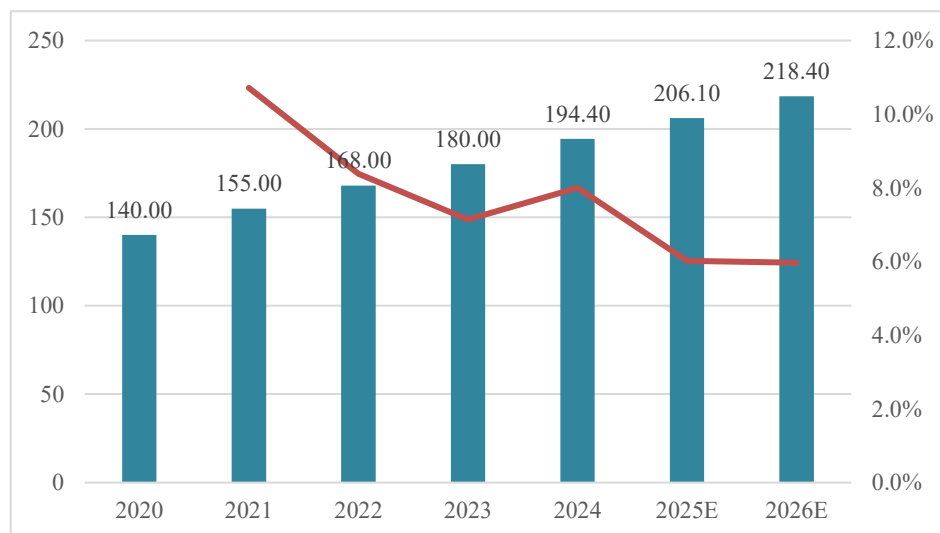
(1) 上游行业与 PCB 行业的关联性及发展状况

PCB 生产所需原材料包括覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、干膜、油墨等，上游配套成熟，供应充足、竞争充分，配套服务满足行业发展需求。覆铜板作为核心材料，承担导电、绝缘、支撑功能，其性能直接影响 PCB 产品性能，占生产成本 20%-40%，价格波动对成本影响显著。铜球、铜箔等铜基材料亦为重要原材料，铜价变化对成本有较大影响。

1) 覆铜板

覆铜板作为 PCB 制造的核心材料，是将玻璃纤维布或其他补强材料浸以树脂，一面或两面覆以铜箔经热压而成，再经过蚀刻、电镀、多层板压合等工序处理后制成印制电路板。中国覆铜板产值在全球占据主导地位，占全球产品 70% 以上。根据维科网统计，2024 年全球覆铜板产值达到 194.4 亿美元。

2020-2026 年全球覆铜板市场规模（亿美元）



数据来源：维科网

2) 铜球及铜箔

铜箔的作用是在由覆铜板做成的印制电路板上形成导电路径，其电路的形成是在覆铜板上有选择地经过蚀刻等工艺制成。而铜球作为阳极材料在 PCB 电镀中，通过电解作用持续供给铜离子，于孔壁和线路上形成均匀、致密且导电性良好的铜镀层。铜球、铜箔一般按照“铜价+加工费”方式进行定价。

2023 年至 2026 年上半年中国有色网铜价走势图（元/吨）



数据来源：Wind 资讯

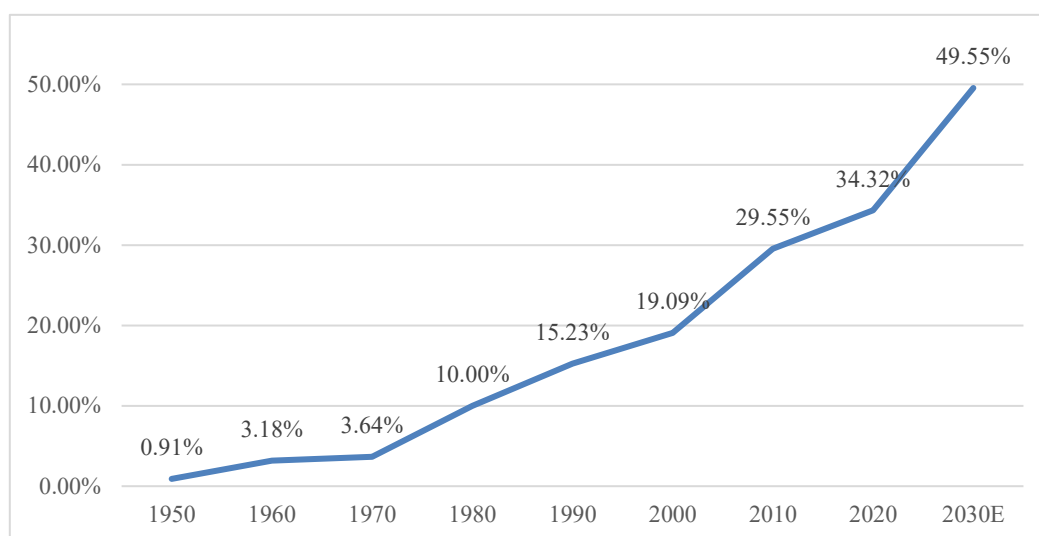
（2）下游行业与 PCB 行业的关联性及发展状况

PCB 下游应用领域主要包括汽车电子、消费电子、通信电子、工控安防、人工智能、半导体等，各应用领域的发展现状及未来发展趋势情况如下：

1) 汽车电子领域

电动化、智能化、网联化已成为全球汽车产业核心发展趋势，新能源汽车产业链覆盖电机、电池、电控系统及充电配套设施等关键环节，而 PCB 作为车载电子与电气设备的核心基础部件，是产业链功能实现的重要支撑。当前，人工智能、5G、车联网及新型感知技术加速迭代，叠加消费者对车载信息娱乐、安全功能的需求持续升级，推动汽车电子系统智能化与电子化水平显著提升，进而带动汽车电子占整车制造成本比重不断攀升。据中国产业信息网数据，汽车电子成本占比自 1950 年的 0.91%稳步增长，至 2020 年已达 34.32%，预计 2030 年有望升至 49.55%。汽车电子成本占比的提升直接拉动汽车用 PCB 需求扩容，同时汽车功能的持续升级也驱动 PCB 产品向更高性能、更复杂工艺方向迭代优化。

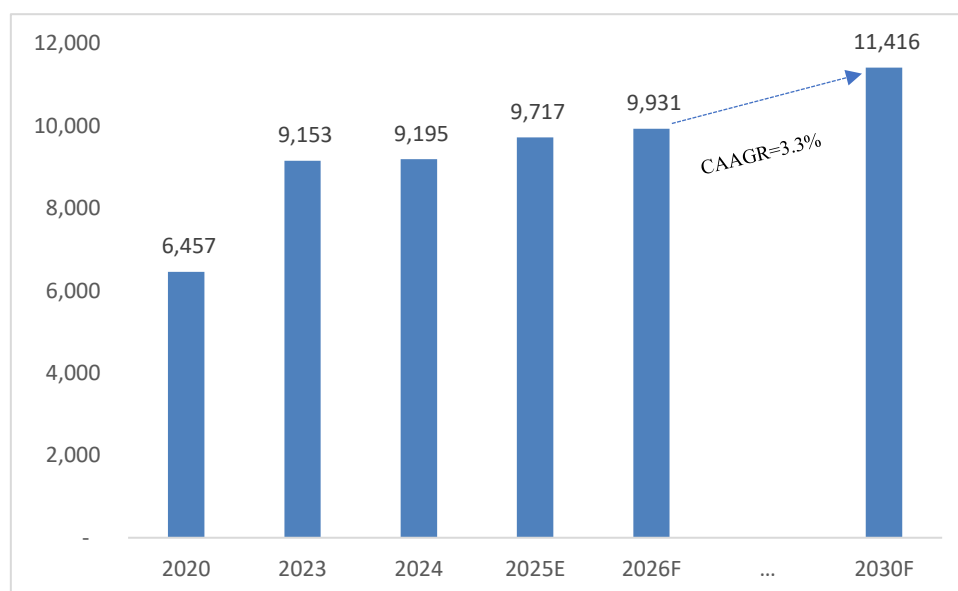
1950-2030 年汽车电子占整车制造成本比重及预测



数据来源：中国产业信息网

汽车电子持续增长的需求带动车用 PCB 市场快速增长，根据 Prismark 数据，2025 年至 2030 年全球汽车电子 PCB 产值年均复合增长率为 3.3%，2030 年预计产值达 114.16 亿美元。

2020-2030 全球汽车电子 PCB 产值（百万美元）

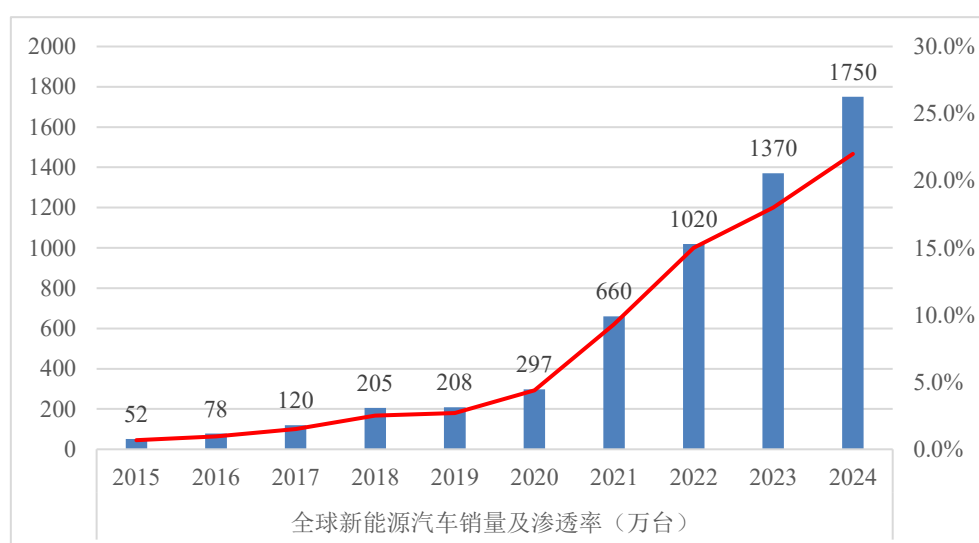


数据来源：Prismark

①新能源汽车

根据国际能源署（IEA）数据显示，近年来全球新能源汽车销量快速增长，从 2010 年的 0.75 万辆快速增长至 2024 年的 1,750 万辆，期间年复合增长率高达 74%；2024 年全球新能源汽车销量突破 1,700 万辆，同比增长 28%，市场份额首次突破 20%。其中国产车占据市场主导地位，中国新能源汽车销量超 1,100 万辆，约占全球销量的 65%，电动汽车的市场渗透率近 50%。在强劲市场需求的推动下，新能源汽车三电系统（电池、电机、电控）以及充电设施等核心环节对高性能 PCB 的依赖不断增强，将持续带动汽车电子领域 PCB 的增量需求。

2015-2024 年全球新能源汽车销量及渗透率（万辆）

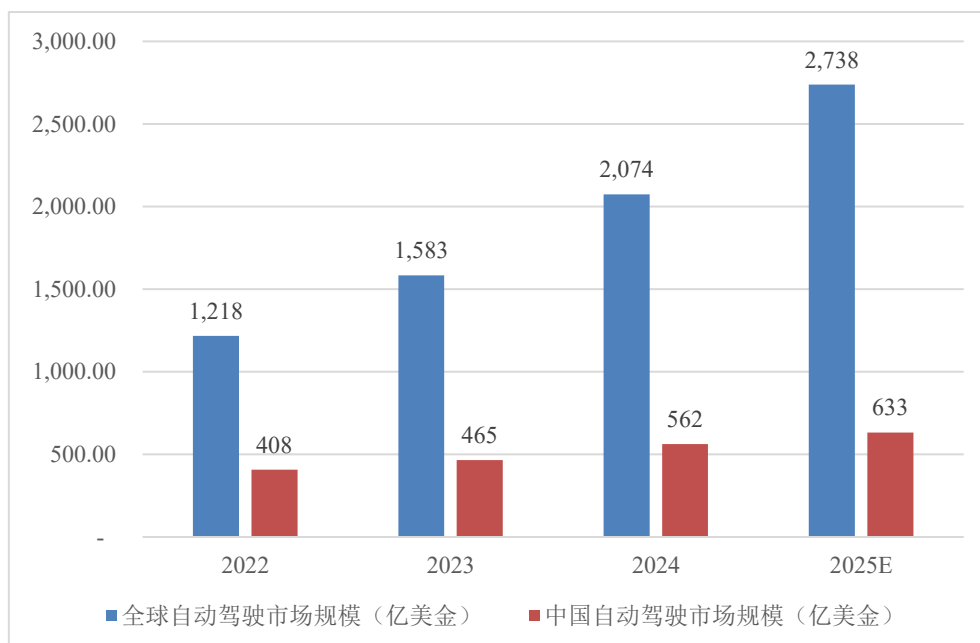


数据来源：Wind 资讯

②智能驾驶

智能驾驶融合人工智能、传感器与计算机视觉等技术，使车辆具备自主感知、决策与控制能力。当前，行业正处于快速发展期，技术突破与渗透率提升构成核心驱动力。未来数年智能驾驶相关的政策扶持及头部企业协作将进一步加速技术落地，为消费者带来更安全、便捷、舒适的出行体验。据统计 2023 年全球自动驾驶市场规模约 1,583 亿美元，同比增长 29.97%；预计 2025 年有望攀升至 2,738 亿美元。

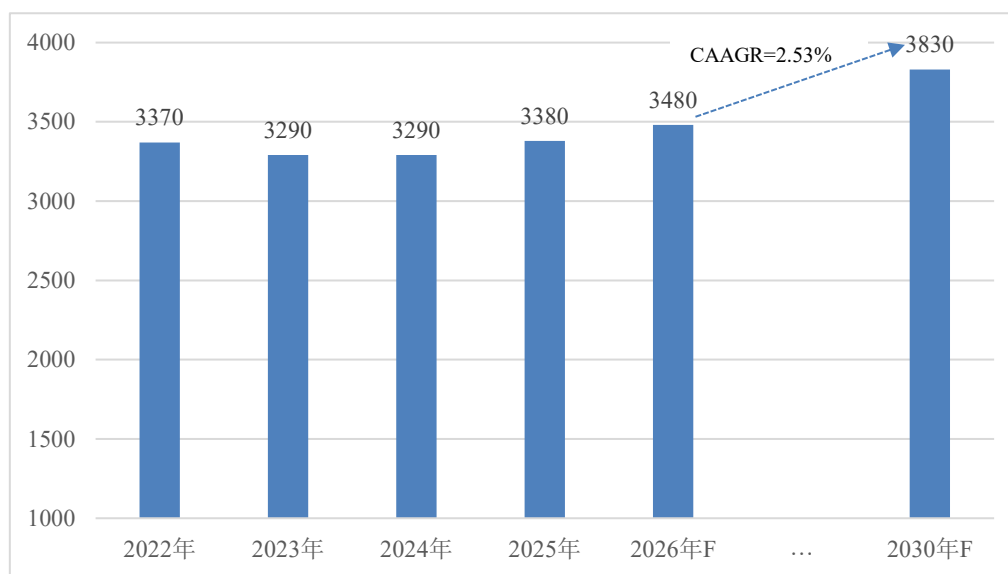
全球自动驾驶市场规模（亿美元）



数据来源：中商产业研究院

2）消费电子领域

消费电子作为电子信息制造业的核心组成部分，与居民日常生活需求紧密相连，涵盖手机、电脑、家电、可穿戴设备等诸多细分领域。该品类所用 PCB 通常具备大批量、轻薄化与小型化特征。消费电子行业下游需求变化快、产品迭代周期短、新品类持续涌现，每一轮新消费热点的兴起均驱动产品升级换代，进而带动印制电路板需求增长。当前，行业正步入以人工智能、物联网和智能家居为代表的新增长阶段，预计先进技术将持续深化对消费场景的渗透，为 PCB 市场注入新动力。根据 Prismark 统计预测，2026 年全球消费电子市场规模达到 3,480 亿美元，较 2025 年增长 2.96%，预计 2030 年全球消费电子产值将达到 3,830 亿美元。

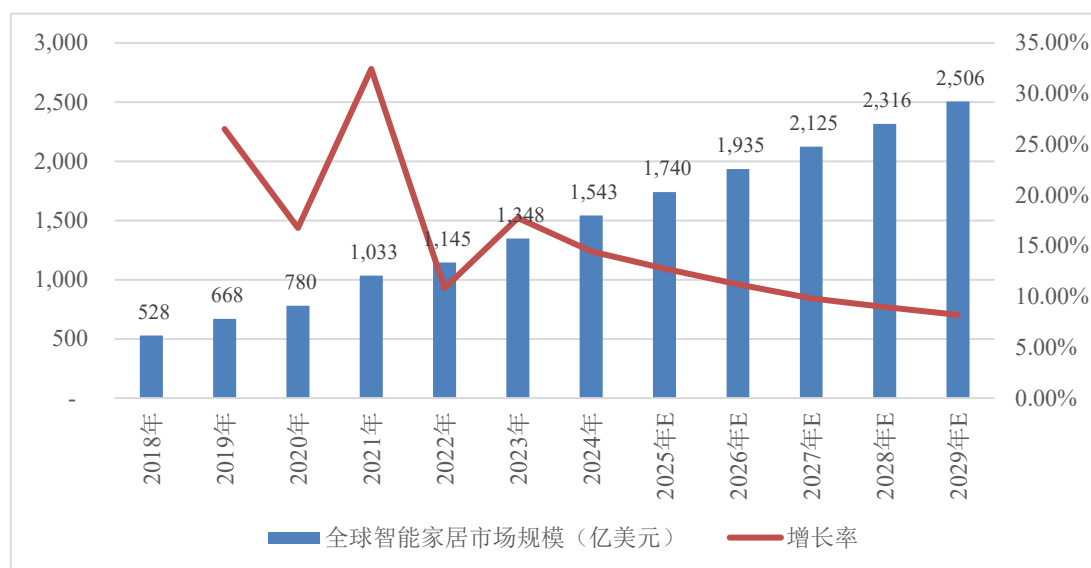
2022-2030 年全球消费电子市场规模及增长预测情况（亿美元）

数据来源：Prismark

①智能家居

以各类家用电器为代表的智能家居产品，已逐步成为现代家庭生活的刚需，行业整体规模庞大。智能家居市场具有体量大、单品附加值高、成长空间广阔等特征。根据 Statista 数据统计，全球智能家居行业市场规模自 2018 年的 528 亿美元增长至 2024 年的 1,543 亿美元，复合增长率达到 19.57%。2025 年，全球智能家居行业市场规模预计为 1,740 亿美元，预计至 2029 年，全球智能家居行业市场规模将增长至 2,506 亿美元，行业发展空间广阔。

2018-2029 年全球智能家居市场规模（亿美元）

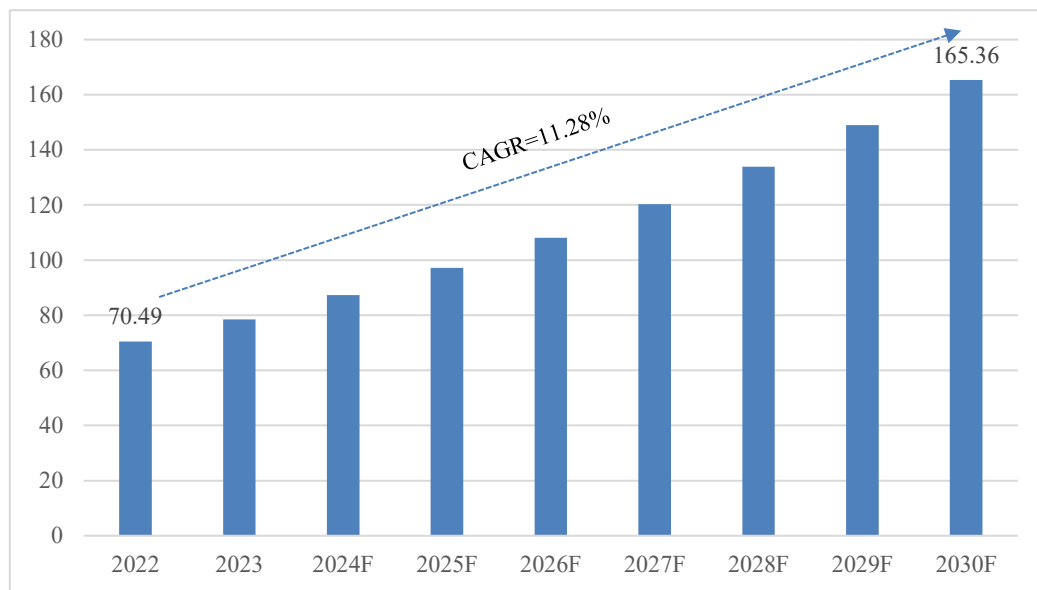


数据来源：Statista

②LED 照明市场

2023 年全球照明行业市场规模达到 1,287.6 亿美元，预计在 2024 至 2032 年期间保持约 7.3%的年均复合增长率，到 2032 年市场规模将达到约 2,427.1 亿美元。与传统白炽灯和节能灯相比，LED 照明在光效、寿命及环保性能等方面具有显著优势，随着节能环保理念的普及，LED 灯具正逐步取代传统光源。2022 年全球 LED 照明市场规模约为 704.9 亿美元，预计到 2030 年将增长至 1,653.6 亿美元，2022 至 2030 年的年均复合增长率约为 11.28%。

2022-2030 全球 LED 照明市场规模（十亿美元）

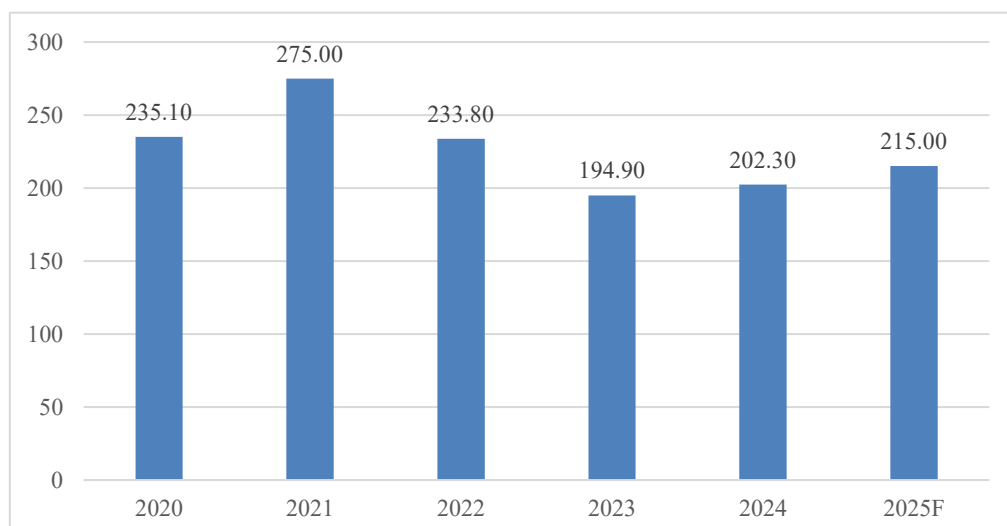


数据来源：Zion Market Research

③笔记本电脑

计算机用 PCB 作为行业的传统重要领域，主要应用于台式机、笔记本电脑及液晶显示器等产品。2020 年起，全球远程办公与在线教育需求显著提升，驱动笔记本电脑出货量快速增长。根据 Canalys 数据，尽管 2022 年因宏观经济承压出货量略有回落，但随着居家办公与在线教育常态化，笔记本电脑作为核心生产力工具，持续为计算机用 PCB 带来稳定需求。

2020-2025 年全球笔记本电脑出货量（百万台）

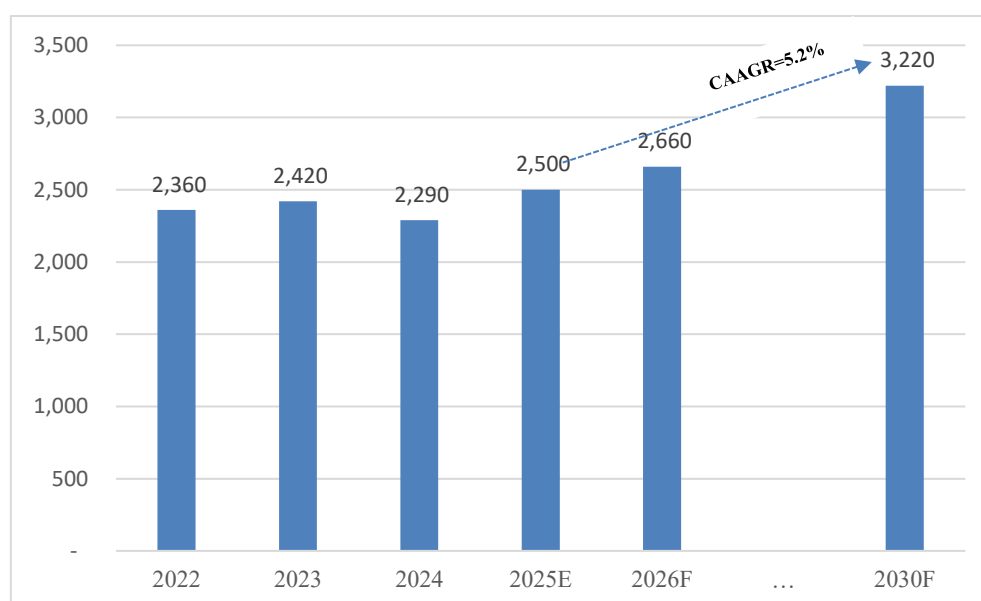


数据来源：Canalys

3) 通信领域

通信设备是支撑有线与无线网络传输的核心基础设施，主要包含通信基站、路由器、交换机、基站天线、射频器件及骨干网传输设备等类别。随着 5G-A 技术加速普及，通信设备对 PCB 的高频特性、高速工艺及配套材料提出更高标准；在通信电源领域，低功耗与高功率密度的性能需求进一步凸显；同时，全球数据流量持续攀升推动高速芯片与高多层板协同应用深化，尤其对保障信号高速传输的高频高速板产品需求显著增长。根据 Prismark 预测，2030 年全球无线与有线通信设备市场规模有望达到 3,220 亿美元，2025-2030 年期间年均复合增长率约为 5.2%，行业增长趋势下，通信领域 PCB 需求将同步受益于市场扩容与技术升级。

2022-2030 年全球有线及无线通信设备市场规模及预测（亿美元）



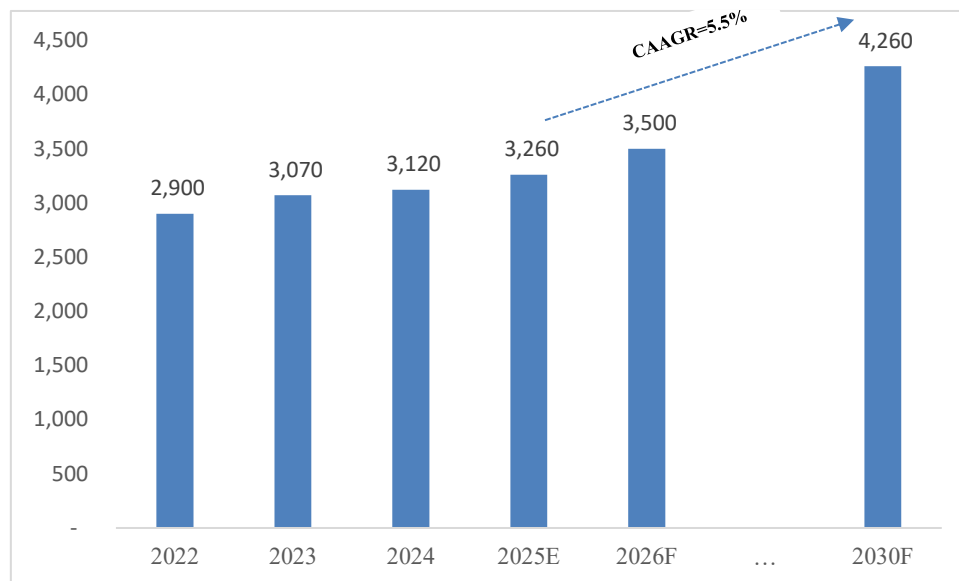
数据来源：Prismark

4) 工控安防

工业控制指利用电子电气、机械技术与软件系统，实现生产制造过程的自动化、精准化、高效化，并提升流程可控性与可视性。当前，在全球各国政策对工业自动化持续推动、物联网与人工智能技术加速渗透，以及制造业对效率

与生产力不断提升需求等因素共同作用下，工控与工厂自动化市场迎来显著增长。随着制造业自动化水平不断提高，工控市场规模持续扩张，为上游 PCB 行业带来稳定且持续的需求支撑。根据 Prismark 预测，预计 2030 年全球工业控制市场规模将达到 4,260 亿美元，2025 至 2030 年复合年均增长为 5.5%。

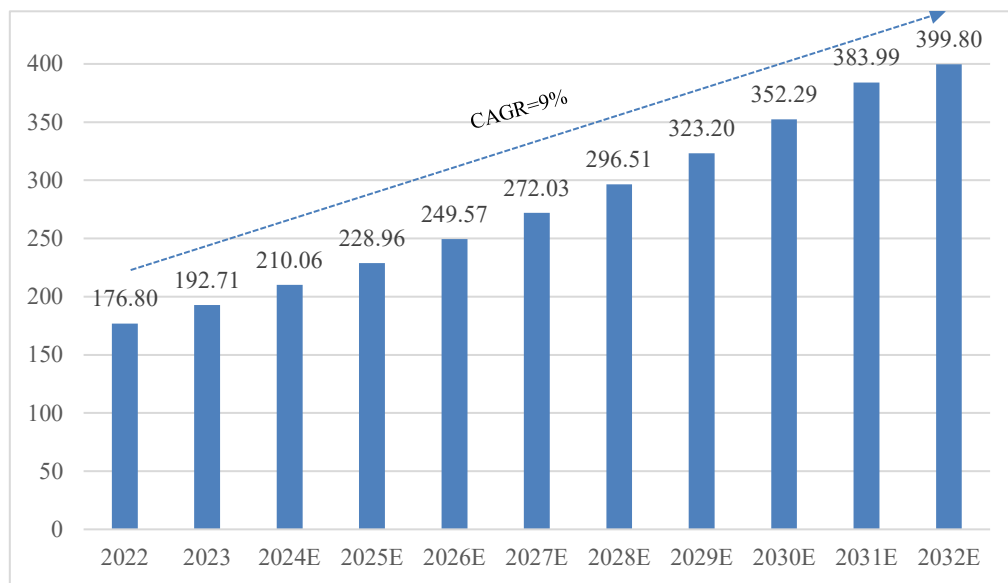
2022-2030 年全球工业控制市场规模（亿美元）



数据来源：Prismark

安防行业涵盖公共安全、交通管理、智慧城市、家庭监控等多元化场景，随着人工智能、大数据及物联网技术的深度融合，视频监控产品正加速向智能化、高清化和联网化方向升级，从而带动对高性能 PCB 的持续需求。根据 Business Research 数据，2032 年全球视频监控市场规模预计达 399.80 亿美元，2022-2032 年期间年均复合增长率约为 9%。

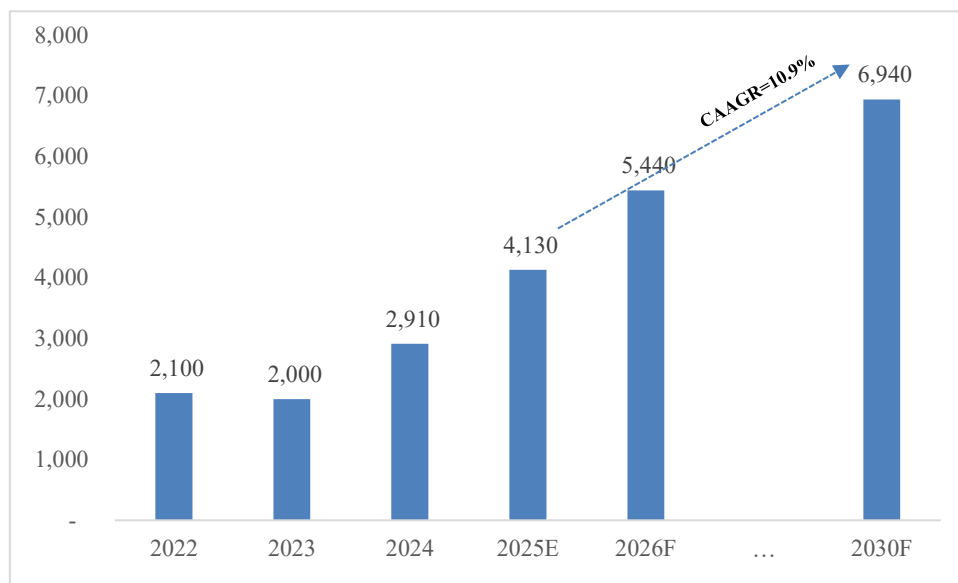
全球智能安防市场规模（亿美元）



数据来源：Business Research

5) 人工智能领域

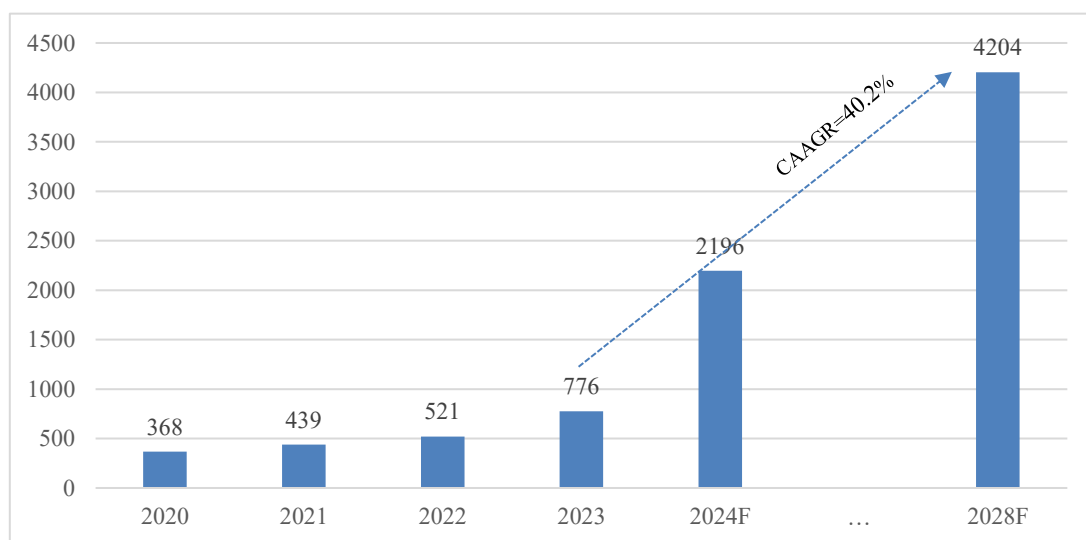
人工智能领域 PCB 应用主要集中于 AI 服务器、高性能计算（HPC）及数据中心基础设施，涵盖 AI 加速服务器、存储阵列、通用服务器及高速互连模块等产品。此类设备对 PCB 提出高多层、低损耗、高速传输及高效散热等严苛要求：海量数据训练与推理推高算力密度和功耗，带动多层板、HDI 及高速封装基板需求，同时服务器电源需实现高效率、低损耗与高功率密度，以保障 AI 集群稳定运行。Prismark 预测，2026 年全球服务器/数据存储市场规模将达 5,440 亿美元，同比增长 31.7%；数据中心/服务器相关 PCB 市场占比预计从 2025 年的 14.70%提升至 2030 年的 19.02%，对应复合年增长率约 10.90%，为增长最快的应用板块之一。

2022-2030 年服务器/数据存储 PCB 市场（百万美元）

数据来源：Prismark

①AI 服务器/数据存储

AI/HPC 服务器 PCB 市场在 2022-2023 年实现了 48.9%的爆发式增长，并将在 2023-2028 年间保持 40.2%的年均复合增长率，带来远超常规服务器的巨大增量需求，成为推动整个 PCB 行业结构升级的核心驱动力。

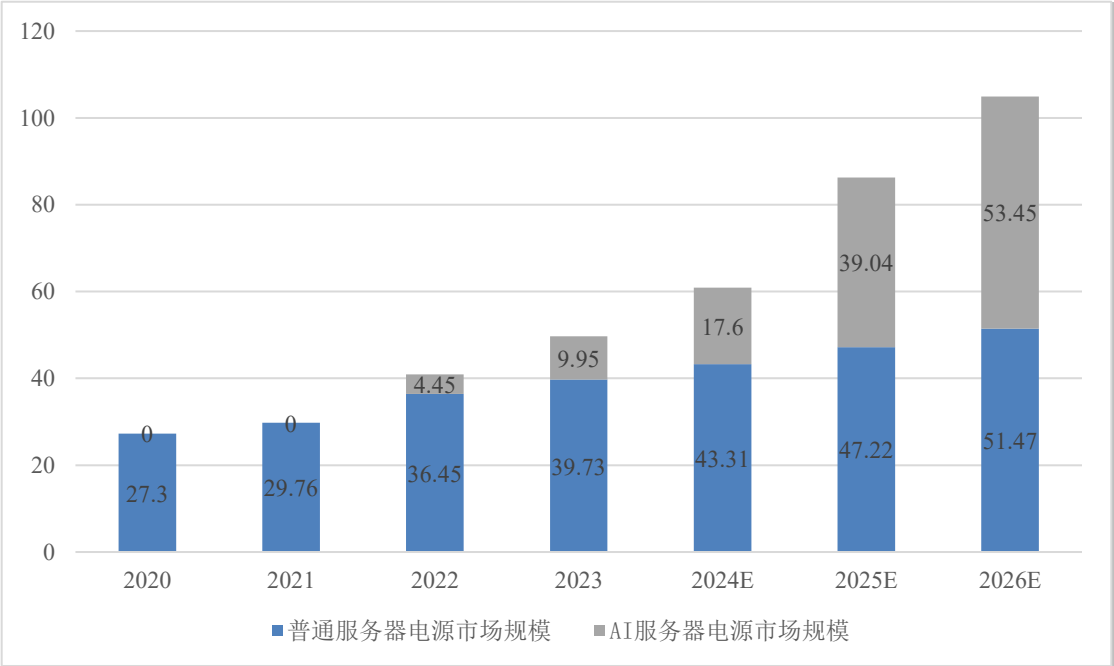
2020-2028 年 AI 服务器/数据存储 PCB 市场（百万美元）

数据来源：Prismark

②服务器电源

服务器电源模块作为服务器系统的核心供电单元，其功能是将交流电转换为服务器所需的直流电，为服务器提供稳定、高效的能源支持。与传统线性电源相比，服务器电源具备高效率、小型化、低热损耗、高稳定性及宽电压适应性等优势，尤其在 AI 服务器领域，其电源系统需通过不间断电源或高压直流（UPS/HVDC）、交流变直流（AC/DC）、直流变直流（DC/DC）三级转换，最终输出 12V（CPU）和 0.8V（GPU）等多级电压，以满足 AI 算力对高精度、高稳定性的严苛要求。受益于 AI 算力需求爆发式增长，AI 服务器电源（AC/DC）作为电源组件市场的核心增量赛道，展现出强劲成长趋势。根据 TechInsight 报告，2025-2026 年 AI 服务器电源市场规模年增长率达 36.91%，至 2026 年将达到 53.45 亿美元。

AI 服务器电源（AC/DC）市场规模（亿美元）



数据来源：TechInsight

AI 服务器电源的认证门槛较高，其对 PCB 产品的认证流程涉及质量控制、交付能力、成本控制等多维度评估，认证周期较长。随着 AI 服务器市场持续扩

张及终端客户对多元供应商需求的增加，国产厂商有望在 AI 服务器电源领域加速渗透，实现市场份额的快速提升。

6) 半导体封装领域

集成电路产业是国家信息安全的重要基石。我国虽已成为全球最大的集成电路消费市场，但长期以来仍依赖进口，集成电路连续多年位居我国第一大类进口商品，自主可控的集成电路产业体系建设极为迫切。近年来，随着国内产业链的逐步完善，我国在晶圆制造、封装与测试环节已取得一定进展。封装基板作为芯片封装的关键材料，广泛应用于手机、计算机、数据存储、工业控制、汽车电子、智能家居、虚拟现实等终端领域。

目前，我国封装基板市场需求旺盛，但整体供给能力仍显不足，具备规模化生产能力的本土企业数量有限，行业自给率偏低。随着下游应用市场持续扩张，封装基板作为支撑半导体发展的核心环节，市场潜力巨大，发展前景广阔。根据 Prismark 数据，2025–2030 年全球封装基板市场产值的复合增长率预计为 10.9%，在 PCB 各细分品类中增速领先。与此同时，在国际经贸摩擦及国际地缘政治格局影响下，国内半导体产业链投资建设力度持续加大，对封装基板的需求将不断攀升。

6、行业未来发展趋势

AI 工业革命的兴起，推动算力、高速网络通信和新能源汽车等下游领域高速发展。未来在人工智能的引领下，汽车电子、服务器/数据储存等下游行业需求将持续增长，带动高多层板、HDI 板保持较高增长。与此同时，传统应用迭代升级亦为 PCB 产业注入新的增长动能。面向未来，电子产品朝着微型化、轻量化、多功能化演进，将驱动 PCB 产品向高密度、高性能、绿色环保方向不断升级，行业技术含量有望持续提升。

(1) 高密度化

高密度化对电路板的孔径、布线宽度、层数及叠孔结构提出更高要求，高阶 HDI 技术是 PCB 技术的重要体现。与传统多层板相比，HDI 板通过盲孔与

埋孔技术减少通孔数量，提升元器件密度，实现更高集成度。高阶 HDI 技术在 AI 高速 PCB 中尤为关键，其材料、设计及工艺的协同优化对信号完整性与可靠性提出更高要求。随着 AI 算力需求的提升，高阶 HDI 技术正向超高多层、超低损耗方向发展。

（2）高性能化

高性能化主要是指 PCB 提高功能性如散热性、阻抗等方面的性能，从而增强产品的功能及可靠性。现代电子产品对信息传送量要求加大，促进信号往更加高频化方向发展，具备良好信号完整性特性的 PCB 才能保障信息的有效传输，保证最终产品性能的稳定性。高性能的产品功率较大、发热较多，具备良好散热性能的 PCB 才能保证产品在适宜温度下工作，在此趋势下，金属基板、厚铜板等散热性能较好的 PCB 得到广泛应用。PCB 产品呈现向高性能化发展的特点。

（3）环保发展

PCB 行业生产工艺复杂，其中部分工艺会对环境产生污染，污染物处理过程比较复杂。随着各国环保要求的提高，PCB 行业制定了一系列的环保规范，考虑到可持续发展的需要，使用新型环保材料、提高工艺技术从而制造出节能环保的新型产品成为 PCB 行业的发展趋势。

（四）行业的竞争状况

1、全球 PCB 行业竞争格局

全球 PCB 生产企业众多，行业集中度较低，市场竞争较为充分。根据 Prismark 统计，2025 年全球前十大 PCB 厂商收入情况如下：

2025 年全球前十大 PCB 企业

单位：亿美元

序号	公司名称	国家/地区	基本情况
1	ZDTech（臻鼎）	中国台湾	中国台资控股厂商，主营柔性板、HDI 板、刚性板及封装基板
2	Unimicron（欣兴电子）	中国台湾	中国台资控股厂商，主营封装

			基板、HDI 板、多层板等
3	DongshanPrecision（东山精密）	中国大陆	内资厂商，主营柔性板、刚性板
4	ShennanCircuit（深南电路）	中国大陆	内资厂商，主营印制电路板、电子装联、封装基板
5	TTMTechonologies（迅达）	美国	北美最大的电路板厂商，主营刚性板、HDI 板、柔性板等
6	WUSGroup（沪电股份）	中国大陆	中国台资控股厂商，主营多层刚性板，HDI 板等
7	VictoryGiant（胜宏科技）	中国大陆	内资厂商，主营高端多层板、HDI 板、柔性电路板及软硬结合板
8	Compeq（华通）	中国台湾	中国台资控股厂商，主营多层刚性板、HDI 板、软板与刚挠结合板等
9	Tripod（健鼎）	中国台湾	中国台资控股厂商，主营多层刚性板等
10	Kinwong（景旺电子）	中国大陆	内资厂商，主营多层刚性板、柔性板等

2、中国 PCB 市场竞争格局

目前我国 PCB 行业已形成充分竞争、百花齐放的格局。根据 CPCA 公布的中国电子电路行业排行榜，2025 年中国主要 PCB 厂商排名情况如下：

2025 年中国 PCB 企业排名

单位：亿元

序号	公司名称	2025 年营业收入	基本情况
1	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	391.47	臻鼎的控股子公司，其生产基地分布在深圳、淮安、秦皇岛、营口、印度清奈、泰国巴真等地
2	苏州东山精密制造股份有限公司	256.20 ^注	内资厂商，A 股上市公司，其大陆生产基地分布在苏州、盐城和珠海等地
3	深南电路股份有限公司	236.47	内资厂商，A 股上市公司，生产基地分布在深圳、无锡、南通、泰国等地
4	胜宏科技（惠州）股份有限公司	192.92	内资厂商，A 股上市公司，主营产品为刚性电路板、柔性电路板、HDI 板等，生产基地分布在惠州、长沙、益阳、泰国、越南、马来西亚等地
5	沪士电子股份有限公司	189.45	中国台资控股厂商，A 股上市公司，主营单双面板、多层及 HDI 板，生产基地分布在昆山、

			黄石、常州和泰国等地
6	健鼎科技股份有限公司	153.52	中国台资控股厂商，主营多层刚性板等，生产基地分布在无锡、仙桃、中国台湾等地
7	深圳市景旺电子股份有限公司	153.08	内资厂商，A 股上市公司，主营产品为刚性板、柔性板、金属基板，生产基地分布在深圳、龙川、江西、珠海、泰国等地
8	华通电脑股份有限公司	125.63	中国台资控股厂商，主营多层刚性板、HDI 板、软板与刚挠结合板等，生产基地分布在重庆、苏州、惠州、中国台湾、美国等地
9	欣兴电子股份有限公司	124.06	中国台资控股厂商，主营封装基板、HDI 板、多层板等，生产基地分布在深圳、苏州、昆山、黄石、中国台湾、泰国等地
10	建滔集团有限公司	122.00	中国港资控股厂商，主营单双面板、多层板及 HDI 板

数据来源：CPCA、上市公司年报；上表东山精密的营业收入为其 PCB 业务收入。

3、公司市场地位

公司深耕 PCB 制造领域多年，已建立覆盖全工序的生产体系与完善的服务配套。依托持续的市场开拓和客户资源积累，公司市场份额稳步扩大，行业影响力不断增强。根据中国电子电路行业协会（CPCA）发布的行业排行榜，公司 2014 年至 2025 年连续 12 年入选“中国电子电路行业排行榜百强企业”，2025 年位居综合 PCB 企业第 48 位。报告期内，募投项目“吉安高精密印制线路板生产基地”已部分投产，产能有序释放，自动化、智能化水平持续提升。随着后续产能进一步扩充，公司市场份额及竞争地位有望继续巩固和提升。

4、主要竞争对手

PCB 生产企业较多，企业生产经营情况受到产能规模、产品类型、下游应用领域等影响差别较大。公司产品主要应用于汽车电子、消费电子、通讯设备、工业控制等领域。公司主要竞争对手有胜宏科技（300476.SZ）、中富电路（300814.SZ）、科翔股份（300903.SZ）、中京电子（002579.SZ）、崇达技术（002815.SZ）、奥士康（002913.SZ）、景旺电子（603228.SH）、依顿电子（603328.SH）、骏亚科技（603386.SH）、世运电路（603920.SH）、博敏电子（603936.SH）、威尔高（301251.SZ）等同行业公司，基本情况如下：

单位：亿元

证券简称	地区	上市日期	产品特征及应用领域	2025 年营业收入
景旺电子	广东深圳	2017/1/6	大批量刚性板、柔性板和金属基板，主要应用于通信、汽车领域	153.08
胜宏科技	广东惠州	2015/6/11	大批量刚性电路板为主，主要应用于计算机、通信等领域	192.92
崇达技术	广东深圳	2016/10/12	大批量刚性及柔性电路板为主，主要应用于通讯、工控、汽车电子等领域	75.44
世运电路	广东鹤山	2017/4/26	大批量刚性电路板为主，主要应用于汽车、通讯领域	51.58
奥士康	湖南益阳	2017/12/1	大批量刚性及柔性电路板、金属基板，主要应用于汽车、消费电子等领域	55.30
依顿电子	广东中山	2014/7/1	大批量刚性电路板为主，主要应用于汽车、通讯、计算机、医疗工控等领域	40.25
科翔股份	广东惠州	2020/11/5	大批量刚性电路板为主，主要应用于汽车、消费电子、工控及通信领域	37.20
博敏电子	广东梅州	2015/12/9	大批量刚性电路板为主，主要应用于数据、通讯、汽车电子、工控安防等领域	36.12
中京电子	广东惠州	2011/5/6	大批量刚性电路板为主，主要应用于消费电子等领域	31.41
骏亚科技	广东惠州	2017/9/12	大批量刚性线路板为主，主要应用于消费电子、工控及医疗等领域	25.36
中富电路	广东深圳	2021/8/12	大批量刚性电路板为主，主要应用于通信、工业控制、汽车电子、消费电子等领域	18.79
威尔高	江西吉安	2023/9/6	多层印制电路板、双面印制电路板，主要应用于 AI 服务器电源、显示和汽车电子等领域	15.44

注：上述信息来源于同行业公司的招股说明书、定期报告、行业研究报告等资料。

5、所处行业的主要壁垒

PCB 行业是典型的技术密集型、资金密集型行业，市场潜在进入者面临技术、客户、环保、资金、管理能力等多方面的行业壁垒。

（1）技术壁垒

印制电路板产品类型丰富，涵盖单面、双面、多层、HDI、柔性、刚挠结合及封装基板等多个品类，且需针对不同下游应用在层数、材料、厚度公差、散热及可靠性等方面进行高度定制。其制造流程复杂，涉及电子、机械、计算机、光学、材料与化工等多学科技术，对工艺水平要求极高。随着人工智能、高性能计算、汽车电子、5G/6G 通信及可穿戴设备等新兴领域快速发展，行业正加速向高密度、高精度、轻薄化演进。企业唯有持续投入研发、不断提升工艺能力，方能及时响应客户不断升级的技术需求，行业因此形成显著的技术壁垒。

（2）客户壁垒

印制电路板是电子产品的关键元器件，其质量稳定性、交期及环保合规性直接决定终端可靠性。下游客户在遴选供应商时，普遍设置严格准入门槛，综合评估企业规模、自动化水平、环保资质、财务状况等，认证周期通常为数月至一年以上，并须经过小批量到量产的逐级验证。合作关系一旦确立，客户黏性较高，轻易不会更换供应商，由此对新进入者形成显著的客户认证壁垒。

（3）环保壁垒

印制电路板制造在电镀、蚀刻、印刷等环节产生废水、废气及固废。近年来，生态环境部门通过在线监测、现场执法等手段强化监管，对排放不达标企业实施关停或限期整改。我国相继出台了《电子信息产品污染控制管理办法》《清洁生产标准—印制电路板制造业》《中华人民共和国环境保护税法》《印制电路板行业规范条件》《排污许可证申请与核发技术规范—电子工业》等法规，对有害物质、清洁生产、排放许可提出更高要求。环保标准持续提升，要求企业同时具备成熟的环保处理技术、经验及稳定达标能力，并持续投入升级环保设施与运营系统，形成对新进入者的显著壁垒。

（4）资金壁垒

PCB 行业资金壁垒较高，企业需在投产前期一次性投入大量资金，购置多品类生产设备及高端检测系统，以保障产品一致性与可靠性；后续仍需持续追加资本，用于生产线升级、工艺改进及研发投入，方能维持技术领先与产品竞争力。因此，PCB 制造呈现明显的资金密集型特征，对潜在进入者构成较高门槛。

（5）管理能力壁垒

PCB 产品品类多、批次杂、定制化程度高，生产流程长、工序繁多。企业需具备覆盖研发、采购、生产、品质管控、交付、环保合规等多环节的精细化管理能力才能生产出符合客户要求的产品。由于下游电子产品精密性和生产模式的特点，印制电路板品质不稳定或交货不及时均会较大程度影响客户对产品的信心，因此成本控制、产品品质的稳定性、准时交货能力是 PCB 企业核心竞争力的体现。构建高效运转、柔性化的生产经营管理体系需要长期经验积累。该要求对新进入者构成了较高的进入障碍。

6、发行人的竞争优势和劣势

（1）发行人的竞争优势

1) 技术研发优势

公司是高新技术企业、中国电子电路行业协会（CPCA）会员单位。公司经过多年的自主研发和实践积累，在产品流程设计、生产流程管理、工艺技术改造、新产品研发等方面积累了丰富的经验。公司能够对客户需求进行快速、优质的响应，提供针对性的配方调整和定制化的解决方案，并为客户提供具有高可靠性、长寿命、高品质等富有竞争力的产品。报告期内，公司研发投入占当期营业收入的比例分别为 4.19%、4.24%、3.84%和 4.97%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司共取得了 186 项专利，其中发明专利 41 项，实用新型专利 143 项，外观设计专利 2 项。

公司始终紧跟下游电子信息产品的发展趋势，专注于细分领域的技术研发，形成并拥有多项自主研发的核心技术，涉及高密度互连（HDI）、高多层板、高频高速板等产品及其先进材料、先进制造工艺、电学参数设计和控制及质量管控技术。公司自主研发的“耐高温高压树脂油墨印制电路板”“320IR 环保型影像显示印制光电路板”“C55-33452B 高频控制传感器印制电路板”“097EQ 智能车载印制电路板”“319XQ 汽车变速箱控制系统 HSP 工艺印制电路板”“047IE 平面式 UPS 变压器印制电路板”等 6 款产品被江西省工业和信息化厅认定为达到同类产品“国际先进”水平，另有十余款产品被认定达到同类产品“国内领先”水平或“国内先进”水平。

2) 客户资源优势

公司实行多行业布局的市场战略，在汽车电子、通信电子、消费电子、工控安防等领域具备丰富的行业经验，积累了一批行业地位领先、市场影响力强、资质信誉和社会形象优秀的知名客户。公司与海康威视（002415.SZ）、德赛西威（002920.SZ）、普联技术、视源股份（002841.SZ）、台达电子（2308.TW）、群创光电（3481.TW）、捷温电子（THRM）、航盛电子、格力电器（000651.SZ）、洲明科技（300232.SZ）、强力巨彩、江苏天宝、京东方（000725.SZ）、马瑞利（Marelli）等众多优质客户保持长期稳定的合作关系。同时，公司高度重视下游领域涌现的新机遇，在稳定传统优势领域的基础上，积极布局 AI 服务器、机器人、新能源汽车以及各种 AI 加持的智能终端与智能装备，进行富有成效的接触、试样、试产及联合研发等，以赢得潜在客户的信任。凭借公司深厚的研发实力、优秀的生产制造优势和卓越的品质保障能力，公司得以深耕头部客户，参与大客户新产品预研，突破超高多层板、高阶 HDI 新技术，为公司业绩高速增长提供新的动力源泉。

3) 生产管理优势

PCB 下游用户通常要求 PCB 具备高可靠性、使用寿命长和可追溯性强等特点，对 PCB 生产商的工艺和材料等要求较高。公司建立了完善的质量控制体系，确保为客户提供高品质的 PCB 产品。印制电路板生产涉及内层、压合、钻孔、

电镀、干膜、绿油、文字、表面处理、外形、电测、终检、包装等十几道工序，具有技术复杂、生产流程长、制造工序多的特点，且下游市场对 PCB 产品的精密密度、可靠度、先进性等要求日益提高，对 PCB 制造企业的生产管理和质量控制能力有着较高的要求。PCB 产品高度定制化的特征客观上要求企业具备高效、快速反应和实现柔性化生产的能力。

公司秉承“品质第一、服务优良、持续改进、追求卓越”的品质方针，通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001、QC080000、UL、CQC、ISO13485、ISO27001、ISO14064 和 ISO14067 等涉及产品质量、安全、环境的体系认证，在销售、采购、生产各环节建立了完善的品质管理体系，严格把控产品品质，保证产品质量的高标准。公司秉持以服务打造市场口碑的理念，建立了客户全面覆盖的服务网络，以迅速解决问题为导向，为客户提供从售前、售中到售后的一站式服务。公司凭借稳定、可靠的产品质量和优质、及时的服务树立了竞争优势，获得了客户的高度认可。

4) 专业人才优势

公司将人才梯队建设置于战略核心位置，构建了先进的人才管理平台与完善的员工培育体系，通过系统化培养与发展机制，打造出一支兼具高素质、高职业素养与强协作能力的经营管理团队及研发队伍。公司管理团队核心成员均拥有多年行业深耕经验，具备扎实的专业知识储备与敏锐的市场趋势洞察力，能够精准把握行业发展机遇、高效统筹企业运营，为公司业务快速拓展与经营效率提升提供坚实支撑。核心技术人员团队普遍具备深厚的专业背景与丰富的实践经验，是公司核心技术沉淀、产品创新研发的关键力量。近年来，核心技术团队在经营实践中成效突出，成功研发多项核心专利技术，持续推动公司产品向新应用领域延伸，有效保障了公司经营业绩的稳步增长，为企业长期发展奠定了坚实的技术与人才基础。

(2) 发行人的竞争劣势

1) 公司经营规模相对较小

相较于行业内较早上市的同行业公司，公司目前整体营业收入规模相对偏小。尽管近年来公司主营业务收入呈现逐年增长态势，经营业绩稳步提升，但与境内外印制电路板行业龙头企业相比，在营业收入体量及市场份额方面仍存在一定差距，未来公司需进一步扩大业务规模，持续提升市场占有率，以增强行业竞争力。

2) 品牌知名度有待提升

国内印制电路板行业参与者众多，竞争充分。尽管公司已在江西吉安拥有三个专业化工厂，且在泰国积极布局新的生产基地，具备稳定制造能力，并与若干知名客户建立了稳固长期合作关系，但相较行业领先企业，公司的品牌影响力仍待提升。

七、发行人主营业务情况

(一) 公司的主营业务及主要产品

公司自成立以来一直专注于印制电路板（Printed Circuit Board）的研发、生产和销售。公司主要产品为单/双面、多层高精密印制电路板，产品以刚性板为主，涵盖高频/高速板、厚铜板、金属基板、高阶 HDI 板、内埋器件板等类型，广泛应用于汽车电子、消费电子、通信电子、工业控制、智能安防等领域。

公司在 PCB 制造领域拥有丰富的行业经验和长期的技术积累，具备 PCB 全制程生产能力和全方位服务体系，经过多年市场开拓和客户积累，市场份额不断扩大，行业影响力不断增强。公司在细分市场领域拥有了较为稳定的客户资源，与海康威视（002415.SZ）、德赛西威（002920.SZ）、普联技术、视源股份（002841.SZ）、台达电子（2308.TW）、群创光电（3481.TW）、捷温电子（THRM）、航盛电子、格力电器（000651.SZ）、洲明科技（300232.SZ）、强力巨彩、江苏天宝、京东方（000725.SZ）、马瑞利（Marelli）等众多优质客户保持长期稳定的合作关系，目前公司产品已远销欧洲、亚洲、美洲等国家和地区。公司持续挖掘各细分领域产品需求，为客户提供具有高可靠性、长寿命、高品质等富有竞争力的产品。

作为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级绿色工厂、江西省发展升级示范企业、江西省瞪羚企业、江西省智能制造试点示范项目企业、江西省智能制造标杆企业、江西省管理创新示范企业、海关 AEO 高级认证企业，公司在产品质量、交付效率、技术服务等方面得到客户广泛认可。公司连续 12 年（2014 年-2025 年）荣获中国电子电路行业协会（CPCA）授予的中国电子电路行业排行榜百强企业称号。其中，2025 年公司在综合 PCB 企业中名列第 48 位。

自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司的主要经营模式

1、盈利模式

公司的盈利主要来源于为客户提供定制化 PCB 产品，即公司凭借先进的技术水平、稳定的产品品质、优质的营销服务、以及对客户需求的深度理解获取下游客户订单，通过原材料、生产装置设备以及相关专利技术，根据客户 PCB 设计文件提出的产品功能要求，生产制造符合客户需求的产品，销售给境内外客户来获取合理利润。

2、采购模式

公司设置了供应链中心，负责对公司主要原材料、辅助原材料、设备及工程的采购进行统筹管理，主要职能包括制订采购管理制度、制定采购策略和采购计划、执行采购计划、开发供应商及采购管理工作等。公司制定了《供应商管理程序文件》《物料试用材料承认作业流程》《采购作业流程》《来料检验作业指导书》《供应商年度稽核评鉴作业流程》等文件，用于指导和规范采购工作的开展，并根据实际情况及时进行修订。

公司主要采用“以产定购”与“保持安全库存量”相结合的采购模式，采购的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和金盐等。针对不同特性的原材料，公司采取以下两种方式进行采购：

(1) 对于常备物料如覆铜板、铜箔、铜球、半固化片等通用主辅材，每月由物控部根据生产排产计划、历史平均耗用量、备料周期等因素，结合安全库存情况综合做出物料需求计划，安排集中采购；

(2) 对于非常备物料如特殊耗材等，需求部门提出申请后，公司安排采购。

在物料交付时，对于免检物料，仓库负责核对确认收货数量，进行外观包装检验；对于受检物料，品质处依据《IQC 质量检验规范》进行检验，并出具检验报告，对符合条件的物料安排入库。

3、生产模式

公司建立了完善的生产流程，能够快速、有效处理客户订单，保证按时生产、发货。由于 PCB 为定制化产品，公司主要采用“以销定产”的生产模式。制造中心负责公司的生产运营，下设一厂、二厂、三厂等生产部门以及运营处、技术处、品质处等职能部门，生产部门内设计划部、生产部、设备部、工艺部等部门。公司具体生产流程为：市场部将客户订单传递给计划部，计划部根据客户订单的产品规格和数量、客户交货周期等关键因素进行生产排期，生产部接到排单指令后领料生产，工艺部负责设置及优化产品生产参数，设备部负责对生产设备及辅助设施进行维护保养，品质处负责对产品制定质量控制计划并按控制计划在相应工序进行检验检测。

4、销售模式

公司采用以直销为主的销售模式，绝大部分销售订单或合同均与产业链下游客户直接签订，少数通过贸易类客户进行买断式销售。公司通常与客户签署合作协议或框架协议、质量协议等，约定产品下单方式、质量标准、交货方式、交货周期、违约责任等。在合作期间内客户按照实际需求向公司发出订单申请，约定产品型号、技术要求、销售价格、销售数量、交货时间等，公司据此安排产品生产与交货。经过多年发展，公司建立了较为完善的销售网络和售后服务体系，统一由销售中心负责。公司与下游主要客户建立了长期稳定的合作关系。

5、研发模式

公司始终坚持自主研发，设立研发处负责公司整体研发工作，并制定了客户需求及主动创新相结合的研发策略，一方面加强对原应用领域产品的更新迭代，不断将新材料、新工艺应用于产品制造中，从而满足下游应用领域需求的不断变化；另一方面主动选择发展前景良好、与公司发展战略相匹配的领域，进行重点布局、主动创新和技术储备。近年来，公司进一步加强对高阶 PCB、HDI、超厚铜板、埋铜块等特殊产品的工艺研发，同时优化产品结构，提高产品快速响应能力，满足客户个性化生产需求。

（三）发行人销售情况

1、公司产品生产和销售情况

报告期内，公司产能、产量、销量情况如下：

单位：万m²

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
产能	188.08	360.32	268.82	277.52
产量	144.39	314.13	244.50	233.26
销量	150.74	302.04	241.01	234.37
产能利用率	76.77%	87.18%	90.95%	84.05%
产销率	104.40%	96.15%	98.57%	100.48%

注 1：产能主要依据生产过程中瓶颈工序设备数量、设备参数、计划生产时间计算。
注 2：2024 年产能下降主要系公司处置子公司深圳满坤电子所致。

报告期内，公司产量、销量均有所增长，其中产能利用率分别为 84.05%、90.95%、87.18%和 76.77%，公司整体产能利用率处于较高水平。2026 年公司产能利用率较低主要系受公司吉安三厂当年尚处于产能爬坡期，新产线产能释放滞后，拉低当期产能利用率所致。公司采用“以销定产”模式，因此报告期各期产销量总体较为接近，产销率均处于 96%以上，公司产品销售状态良好。

2、主营业务收入构成情况

报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分情况如下：

单位：万元、%

产品类别	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
------	--------------	---------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
单双面板	29,296.15	35.14	53,637.17	36.48	44,646.56	38.85	48,324.80	42.80
四层板	33,283.10	39.92	58,299.98	39.65	53,481.52	46.53	48,163.88	42.66
六层及以上	17,757.27	21.30	27,289.57	18.56	16,804.14	14.62	16,414.21	14.54
HDI 板	3,035.93	3.64	7,824.79	5.32	-	-	-	-
合计	83,372.44	100.00	147,051.51	100.00	114,932.21	100.00	112,902.89	100.00

3、报告期前五大销售客户情况

报告期内，公司向前五大客户销售情况如下：

单位：万元、%

2026 年 1-6 月			
序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例
1	海康威视	9,971.42	11.96
2	视源股份	7,934.57	9.52
3	台达电子	7,727.22	9.27
4	德赛西威	6,491.22	7.79
5	普联技术	6,289.33	7.54
合计		38,413.76	46.07
2025 年度			
序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例
1	台达电子	13,940.34	8.46
2	海康威视	12,934.80	7.85
3	普联技术	11,470.40	6.96
4	视源股份	11,146.91	6.77
5	德赛西威	10,251.57	6.22
合计		59,744.02	36.27
2024 年度			
序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例
1	海康威视	11,330.33	8.94
2	普联技术	11,182.97	8.82
3	德赛西威	9,918.16	7.82
4	视源股份	6,863.48	5.41
5	台达电子	6,251.75	4.93
合计		45,546.69	35.92
2023 年度			
序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例
1	海康威视	10,438.06	8.58
2	普联技术	8,903.66	7.32

3	德赛西威	7,926.12	6.51
4	视源股份	7,698.59	6.33
5	格力电器	7,552.33	6.2
合计		42,518.77	34.94

注：上表已将同一控制下相关主体的数据合并披露。

报告期内，公司向前五名客户销售合计金额占当期营业收入比例分别为 34.94%、35.92%、36.27%和 46.07%，不存在向单个客户的销售占比超过 50% 或严重依赖于少数客户的情况。发行人的董事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方及持有发行人 5%以上股份的股东在上述客户中均未拥有权益。

（四）发行人采购情况

1、原材料采购情况

报告期内，公司主要原材料采购金额及占原材料采购总额的比例情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
覆铜板	26,703.13	42.04	43,099.37	40.04	31,431.35	39.76	26,171.78	37.30
铜球	7,958.46	12.53	14,327.53	13.31	10,491.36	13.27	8,454.27	12.05
铜箔	5,008.54	7.89	8,807.76	8.18	5,530.11	6.99	4,178.70	5.96
半固化片	4,580.81	7.21	6,703.91	6.23	4,454.44	5.63	3,907.47	5.57
金盐	6,087.69	9.58	9,403.74	8.74	5,233.58	6.62	4,055.24	5.78
合计	50,338.63	79.25	82,342.31	76.50	57,140.84	72.27	46,767.46	66.66

2、主要能源采购情况

报告期内，公司生产所需能源以电力为主，其采购具体情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
电量（万千瓦时）	8,706.52	18,095.23	14,127.45	10,682.25
电费（万元）	5,495.21	11,682.02	9,273.41	7,290.25
用电平均单价（元/千瓦时）	0.63	0.65	0.66	0.68

3、报告期向前五大原材料供应商采购情况

单位：万元、%

2026年1-6月			
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
1	生益科技	9,103.80	14.33
2	江南新材	7,217.07	11.36
3	广东盈华电子材料有限公司	5,959.60	9.38
4	烟台招金励福贵金属股份有限公司	5,909.96	9.30
5	毅尔翔商贸（上海）有限公司	5,443.49	8.57
合计		33,633.92	52.94
2025年度			
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
1	生益科技	20,403.93	18.96
2	南亚新材	13,476.27	12.52
3	江南新材	10,316.57	9.58
4	毅尔翔商贸（上海）有限公司	9,231.37	8.58
5	烟台招金励福贵金属股份有限公司	6,444.68	5.99
合计		59,872.82	55.62
2024年度			
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
1	生益科技	13,535.59	17.44
2	南亚新材	9,034.55	11.64
3	江南新材	7,427.80	9.57
4	毅尔翔商贸（上海）有限公司	6,454.17	8.32
5	德福科技	3,108.23	4.01
合计		39,560.34	50.98
2023年度			
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
1	生益科技	9,149.04	13.32
2	毅尔翔商贸（上海）有限公司	6,142.41	8.94
3	江南新材	5,344.85	7.78
4	南亚新材	4,746.23	6.91
5	湖北中科铜箔科技有限公司	3,582.00	5.21
合计		28,964.53	42.17

注：上表已将同一控制下相关主体的数据合并披露。

报告期内，发行人向前五名原材料供应商采购金额合计占当期原材料采购总额的比例分别为 42.17%、50.98%、55.62%和 52.94%，供应商集中度相对较高。发行人与前五名供应商合作时间较长，业务稳定持续。报告期内，公司不存在向单一供应商采购金额占采购总额的比例超过 50%或严重依赖于少数供应

商的情况。发行人的董事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方及持有发行人 5%以上股份的股东在上述供应商中均未拥有权益。

（五）安全生产

公司严格遵循国家及相关部委安全生产法律法规与规章制度，结合生产实际全面落实安全生产责任制，构建了健全的安全生产管理制度，形成覆盖各级的安全管理网络及劳动保护监察体系。针对生产工艺特点与物料特性，同步建立了配套的事故应急救援预案，筑牢安全生产防线。

公司各厂区全面承担安全生产管理与监督职能，构建了覆盖工厂、车间、班组的层级化责任体系及全员参与的安全生产考核机制。公司严格遵照国家相关规定，系统开展员工安全教育培训，规范落实公用及个人劳动防护用品配发，严格执行从业人员持证上岗制度。同时，公司为主要生产设备投保财产保险，并在关键部位配备连锁、自控等安全设施，全方位筑牢安全生产防线。

报告期内，公司未发生过重大安全生产事故，发行人前控股子公司深圳满坤电子存在一项行政处罚事项，详见本募集说明书之“第六节 合规经营与独立性”之“一、合规经营”之内容。

（六）环保情况

1、公司所在行业不属于重污染行业

公司是专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）分类标准，公司所属行业为“C398 电子元件及电子专用材料制造”下的“C3982 电子电路制造”，不属于《环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于印发<企业环境信用评价办法（试行）>的通知》（环发[2013]150 号）中所列明的“火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业”等重污染行业。

2、主要环境污染物及环保措施

公司生产过程中产生的污染物包括废水、废气、固体废弃物和噪声。报告期内，公司各环保设施均能有效运行，处理能力可以负荷日常生产的污染物排放。公司行政中心负责公司环保事项，设置环保经理一人，并配备专人对废水、废气、固体废弃物和噪声的处理进行专项跟进，对环保设施运行情况进行检查，确保环保设备正常运行以及公司污染物排放符合要求。

各类污染物的治理情况如下：

（1）废水：公司按照“清污分流、雨污分流、分质处理”原则，采取成熟可靠工艺进行针对性处理。各类废水经厂区污水处理站处理满足污水处理厂接管标准后，排入污水处理厂进一步处理。

（2）废气：公司加强对各类废气的收集，并根据污染物性质采用成熟可靠处理工艺，确保大气污染物长期稳定达标排放。同时，公司加强生产管理、车间通风以及厂区绿化。

（3）固体废弃物：公司生产过程中产生的废弃物主要有一般工业固体废物、危险固废、生活垃圾。公司将按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物由有资质的公司处理；危险固废由有资质的环保公司处理；生活垃圾由环卫部门定期回收处理。

（4）噪声：公司噪声主要源自生产线各类风机和泵类、污水站风机、废气洗涤塔风引风机等设备，公司选用先进的低噪音设备，并采取了适当的降噪措施，如采取隔声、吸声、消声及减振等综合措施。

公司按照相关法律法规的要求，制订了环境监测方案，并按要求开展自行监测或委托具备资质的第三方监测机构开展检测工作。自行监测的监测结果满足相关排放标准；委托第三方监测机构的检测取得了受认可的检测报告，报告中各项污染物的检测指标均达标。

报告期内，发行人及其控股子公司在报告期内不存在因违反生态环境保护方面的法律法规而受到行政处罚的情形，不存在环保方面重大违法违规的情形。

3、公司的环保投入

报告期内，公司环保投入金额分别为 303.85 万元、1,381.39 万元、523.78 万元和 255.73 万元，均系公司业务开展过程中进行的环保设施和工程投入及日常环保费用。其中，2024 年度公司环保投入增加主要系公司根据环保需求替换两台 VOC 废气塔投入所致。

（七）现有业务发展安排及未来发展战略

1、公司发展战略

公司的发展战略目标为：发扬“以客户为聚点，以质量为生命，以革新为动力，追求卓越，实现股东权益、员工利益和社会责任”的经营宗旨，秉承“奋斗、革新、坚守、朴实”的价值观，立足于高精密电路板产业广阔的市场空间和历史机遇，以高增长、高效率、智能化为发展基调，加强与全球一流企业（客户和供应商）的深度合作，致力于实现“成为全球电子电路行业具有影响力的标杆企业”的愿景。

公司将继续立足印制电路板行业，坚持以技术研发为驱动，加强产品创新，持续跟踪下游行业的发展趋势和客户应用需求，力争在汽车电子（新能源汽车、自动驾驶、安全控制系统、智能座舱等）、消费电子（智能设备终端、智能家居、智能触控、光电显示等）、通信电子（路由器、交换机、服务器、显卡及笔记本电脑等）等领域继续深耕和突破，依托公司过往累积的各种优势，不断优化产品和服务能力，加大对一流品牌企业的市场开拓，实现国内、国际全球核心客户的全方位覆盖；同时，随着募投项目和泰国投资的逐步推进，公司产能将进一步提升，从而持续提升公司核心竞争力，快速提高公司产品的市场占有率，早日实现公司跨越式发展。

公司将持续贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的可持续发展理念，将其融入企业经营发展的各领域和全过程，通过环境保护、研发创新、公司治理、人才培养等方面的实践，推动公司高质量发展，实现经济效益和社会效益的双赢。

2、现有业务发展安排

（1）智能制造计划

IPO 募投项目是公司倾力打造的一个“数据集成、自动互联、高效严谨、节能降本”的智能化工厂，将利用 MES 平台集成大数据库管理，以及通过实施设备自动化集成 EAP 平台、品质管理系统 QMS、智能排程系统 APS、仓库管理系统 WMS、自动 AGV 物流流转等，打造自动化、数字化、智能化的生产线，并促进数据驱动经营与管理能力的提升。随着 IPO 募投项目进一步投产及量产，公司将进一步完善生产布局，优化现有产品结构，提升产线的数字化、信息化、自动化和智能化水平，提升公司的市场占有率。同时，公司泰国工厂的逐步建设，完善公司海外生产基地的布局，为公司快速增长提供新的动力，有助于更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。

（2）产品研发计划

经过多年在汽车电子领域的沉淀，公司已经取得多个国际知名第一梯队供应商和终端车厂的认证，并已获得主要客户上百个定点项目。未来，公司将稳步提升汽车电子 PCB 产能，并持续加大对新能源车载核心三电（电池、电机、电控）系统、自动驾驶系统、安全系统等 PCB 产品的研发投入。同时，为了满足客户个性化、多样化和高阶化的产品结构需求，公司引进了多位行业高阶 PCB 和 HDI 的专业人才，在巩固刚性板产品优势的基础上，组织开展对高阶 PCB（Notebook、服务器产品）和高阶高密度互联板（二阶 LED 显示产品、三阶 HDI 车载自动驾驶/域控制等产品）的研发拓展工作。其次，进一步深入加强对高频/高速板、超厚铜板、埋铜块等特殊产品的工艺研发，不断丰富完善公司产品结构，提升公司整体竞争力。

（3）市场开发计划

在销售策略方面，公司采用“抓大放小”和“精准聚焦”的策略，重点开拓下游各领域具有知名度、规模效应、信用良好的品牌客户。在市场开发方面，

公司将结合自身产品优势，重点发展汽车电子（新能源汽车、自动驾驶、安全控制系统、智能座舱等）、消费电子（智能设备终端、智能家居、智能触控、光电显示等）、通信电子（路由器、交换机、服务器、显卡及笔记本电脑等）及 HDI 产品（二阶 LED 显示产品、三阶 HDI 车载自动驾驶/域控制产品等）等领域。在客户开拓方面，公司坚决执行品牌客户策略，协调各职能部门积极响应客户需求，不断改进对现有优质大客户的产品技术及销售服务能力；同时重点开发其他符合战略布局的国内外优质客户群体。在深挖国内市场的同时，针对欧美、日韩等市场加大销售市场的推进，持续提升公司市场占有率和美誉度，建立辐射全国、面向世界的销售网络，使公司面向国际市场创立世界品牌，逐步实现公司全球化战略目标。

（4）人才发展计划

公司紧密围绕战略目标及业务发展需求，致力于构建“引才-育才-励才”三位一体人才发展体系，打造高素质专业化团队。在人才梯队建设方面：重点引进集成电路、智能制造等领域高端技术人才，实施“雏鹰计划”，完善校招培养体系，建立管理/技术双通道晋升机制。在激励机制创新方面：逐步推行管理层 OKR+KPI 融合考核体系，实施及时激励。在培养体系升级方面：深度推进产教融合智能制造实训基地，实施“现场工程师”导师制，开展政校企联合培养。在文化生态建设方面：推行“友爱满坤”项目，实施员工健康管理 EAP 计划，增强企业活力。

八、与产品有关的技术情况

（一）公司报告期内研发投入情况

报告期内，公司研发费用占营业收入比例如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用	4,679.03	6,320.79	5,380.08	5,096.63
营业收入	94,238.36	164,715.46	126,773.20	121,699.39
研发费用率	4.97%	3.84%	4.24%	4.19%

（二）报告期内形成的重要专利技术及应用情况

报告期内形成的重要专利技术及应用情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、公司的主要固定资产及无形资产情况”之“（二）主要无形资产”之“4、专利”。

（三）研发人员情况

截至 2026 年 6 月末，公司共拥有员工 2,717 人，其中研发与技术人员共 332 人，占员工总人数的 12.22%。公司研发团队较为稳定，报告期内未发生重大不利变动。

（四）公司核心技术来源及其对发行人的影响

公司在多年的生产经营过程中积累了多项核心技术，可以满足下游不同行业客户对产品的质量品质需求。截至报告期末，公司主要产品的核心技术情况如下：

序号	核心技术名称	技术来源	应用阶段
1	新能源智能汽车印制电路板制造技术	自主研发	量产
2	印制电路板脉冲电镀生产工艺	自主研发	量产
3	PTFE 材料加工工艺	自主研发	量产
4	CCD 成型生产工艺	自主研发	量产
5	高多层板阻抗控制技术	自主研发	量产
6	高多层板层间对准控制技术	自主研发	量产
7	埋铜块技术	自主研发	量产
8	HSP 技术	自主研发	量产
9	COB 技术	自主研发	量产
10	光模块 PCB 技术	自主研发	量产

1、新能源智能汽车印制电路板制造技术

该技术精准匹配新能源汽车网联化、智能化发展趋势，针对车载 PCB 的高规格需求形成专项解决方案。聚焦新能源车载产品对应的 1500V 高压要求，优化 PCB 材料配方与钻孔加工工艺，通过高压 CAF 测试验证保障产品应用可靠性；适配 3-5 阶 HDI 设计的智能驾驶与高阶辅助驾驶场景，严格把控材料选择、层间对准及盲孔电镀信赖性；针对信号传输与匹配需求，对阻抗控制关键因子

实施 SPC 管控，确保阻抗精度与一致性达标，全面满足新能源智能汽车的高端技术要求。

2、印制电路板脉冲电镀生产工艺

该技术可通过周期性正向/反向脉冲电流实现金属沉积，相较传统直流电镀，突破极限电流密度，可通过调整脉冲参数优化镀层微观结构，提升结合力与耐腐蚀性。该技术可使镀层厚度均匀性提升，能耗得以降低，孔金属化填充率达 95%以上，能够节省 20%-40%贵金属，适用于高密度互连板微盲孔填充及高频高速板低粗糙度铜层制作。

3、PTFE 材料加工工艺

该技术聚焦 PTFE 高频板材加工难题，针对其质地软、切削性能差，钻孔易出现披锋、毛刺、板材疏松发白等问题，制定专项解决方案。通过采用厚铝片和高密度垫板等工艺控制手段，满足孔壁粗糙度 $\leq 40\mu\text{m}$ 、孔内无毛刺、孔口发白区域距孔边 $\leq 2.0\text{mm}$ 等严格质量要求，适配高速数字电路、高频通信等应用场景。

4、CCD 成型生产工艺

该技术的研发系为应对 PCB 高精密发展趋势，解决传统 CNC 成型无法满足的尺寸公差需求，覆盖 LED、光模块、车载等产品的严苛精度标准。通过深入研究 CCD 成型原理、对位 Tooling 设计、PCB 涨缩控制、成型程式与刀具补偿等关键环节，形成全流程控制方案，保障产品尺寸精度达标，实现高精密 PCB 顺利量产。

5、高多层板阻抗控制技术

该技术针对光模块与 AI 产品对阻抗控制的严苛需求，从材料 DK 特性、内层与外层曝光及蚀刻均匀性、压合介电层与电镀铜厚一致性、防焊油墨均匀性及阻抗测量系统等多维度开展研究，建立全流程管理方法，将阻抗量产控制精度提升至 5%以内，满足高端电子产品的信号传输稳定性要求。

6、高多层板层间对准控制技术

该技术适配 20-30 层高多层 PCB 在 AIPC、AI 服务器等领域的应用需求，围绕材料特性、产品叠构、铜厚补偿、板边 Tooling 设计、涨缩管控、压合与钻孔补偿等关键因子制定全流程方案。通过多环节精准控制，实现层间对准误差控制在 4mil 以内，保障高多层 PCB 产品的稳定量产与性能可靠性。

7、埋铜块技术

埋铜块技术是响应功率器件大功率化带来的散热需求，以高导热性铜材料为核心，从埋铜块尺寸设计、压合叠构设计及流程设计入手，全面识别流程潜在失效因子并进行实验验证与控制，形成一套完整的设计与制作管控方案，实现具备高效散热功能的埋铜块 PCB 产品顺利量产，适配高发热电子元器件应用场景。

8、HSP 技术

HSP（heat sink paste，高散热膏）技术通过在 PCB 铜面印刷高散热膏实现高效散热，具有流程短、控制简单、成本低等优势。从产品尺寸、铜厚及流程设计出发，识别并控制流程潜在失效风险，经实验验证形成全流程管控方案，满足大功率器件散热需求，实现相关 PCB 产品高效量产。

9、COB 技术

COB 技术（Chip on Board，板上芯片封装）是将裸芯片直接焊接在印刷电路板基板上，然后进行引线键合实现其电气连接，并用胶把芯片和键合引线密封的封装技术，核心是“芯片直接集成于基板”，跳过传统封装的芯片载体环节。COB 技术与传统 SMT 相比，具有高密度集成、小尺寸等特点。

10、光模块 PCB 技术

光模块由多种光器件封装而成，其中光模块 PCB 涉及高频高速材料运用、HDI 和软硬结构复合工艺能力、断接金手指及电厚金工艺，并有严格的外观与

尺寸要求，属于技术壁垒较高的 PCB 产品。公司已具备光模块 PCB 产品的量产能力。

九、公司的主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

1、最近一期末固定资产情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司固定资产账面原值 149,508.84 万元，累计折旧 47,932.63 万元，账面价值 101,576.21 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	折旧年限	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	20 年	54,562.70	10,216.04	44,346.66	81.28%
机器设备	5-10 年	92,094.65	35,744.26	56,350.39	61.19%
运输设备	5 年	158.07	120.18	37.90	23.97%
其他设备	3-5 年	2,693.41	1,852.15	841.26	31.23%
合计		149,508.84	47,932.63	101,576.21	67.94%

2、主要生产设备情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司生产设备主要分布在母公司，具体如下：

单位：万元

序号	设备名称	数量	账面原值	账面价值	成新率
1	钻孔机	427	25,114.38	14,346.70	57.13%
2	曝光机	40	8,731.14	5,942.36	68.06%
3	电镀线	15	7,795.72	4,422.54	56.73%
4	锣铣机	145	6,267.18	3,164.65	50.50%
5	检查机	56	3,756.11	2,095.51	55.79%
6	测试机	88	3,226.25	2,218.51	68.76%
7	丝印机	65	2,721.46	1,540.75	56.61%
8	沉铜线	8	2,364.60	1,688.29	71.40%
9	蚀刻线	11	2,263.19	1,553.11	68.62%
10	水平前处理	29	2,142.07	1,338.85	62.50%
11	镭射钻孔机	7	2,098.23	1,902.93	90.69%
12	压合机	4	1,900.22	1,306.15	68.74%
13	隧道炉	17	1,809.51	948.00	52.39%

14	表面处理	12	1,307.20	732.37	56.03%
15	回流线	4	1,205.21	817.26	67.81%
16	喷印机	6	1,192.92	955.55	80.10%
17	研磨机	35	955.33	517.48	54.17%
18	钻靶机	9	880.85	560.79	63.66%
19	裁切机	13	724.02	452.01	62.43%
20	压膜机	9	713.21	472.19	66.21%
21	水平线	19	582.75	416.04	71.39%
22	显影机	13	565.72	260.92	46.12%
23	涂布线	4	491.22	284.52	57.92%
24	裁磨线	4	487.95	268.75	55.08%
25	棕化机	4	387.09	239.12	61.78%
26	验孔机	13	325.63	161.58	49.62%
27	测厚机	9	255.12	180.62	70.80%
28	智能喷涂线	2	251.77	222.86	88.52%

3、房屋建筑物

(1) 不动产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司的不动产情况如下：

序号	权利人	产权证号	坐落地	建筑面积 (m ²)	用途
1	发行人	赣（2020）井开区不动产权第 0001375 号	井开区火炬大道与嘉华大道交叉口西北角	26,501.10	工业用地
2	发行人	赣（2020）井开区不动产权第 0001376 号	井开区火炬大道与嘉华大道交叉口西北角	3,549.10	工业用地
3	发行人	赣（2020）井开区不动产权第 0001377 号	井开区火炬大道与嘉华大道交叉口西北角	3,549.10	工业用地
4	发行人	赣（2020）井开区不动产权第 0001378 号	井开区火炬大道与嘉华大道交叉口西北角	3,047.50	工业用地
5	发行人	赣（2020）井开区不动产权第 0001379 号	井开区火炬大道与嘉华大道交叉口西北角	1,060.00	工业用地
6	发行人	赣（2019）井开区不动产权第 0002671 号	井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号	9,177.20	工业用地
7	发行人	赣（2019）井开区不动产权第 0002672 号	井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号	299.90	工业用地
8	发行人	赣（2019）井开区不动产权第 0002673 号	井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号	52.60	工业用地

序号	权利人	产权证号	坐落地	建筑面积 (m ²)	用途
9	发行人	赣（2019）井开区不动产权第 0002674 号	井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号	26.00	工业用地
10	发行人	赣（2020）井开区不动产权第 0002940 号	京九大道与火炬大道交叉口西南角	8,088.72	工业用地
11	发行人	赣（2019）井开区不动产权第 0002692 号	井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号	32,692.50	工业用地
12	发行人	赣（2025）井开区不动产权第 0002822 号	井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号	94,238.37	工业用地

（2）租赁房产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司租赁的房产情况如下：

序号	承租方	出租方	坐落	面积（平方米）	租赁期间	用途
1	公司	深圳金蝶有礼科技有限公司	深圳市南山区金蝶软件园大厦 11 层 01、03、04、05 号	1,809.25	2026.4.1-2031.3.31	办公

（二）主要无形资产

1、最近一期末无形资产情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司无形资产账面原值 5,452.48 万元，累计摊销 835.39 万元，账面价值 4,617.09 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	摊销年限	账面原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	50 年	4,992.84	401.25	4,591.58
软件	5 年	459.64	434.14	25.50
合计		5,452.48	835.39	4,617.09

上述无形资产中，软件系公司外购的生产所需 PCB 设计、生产控制及办公软件，公司相关资产期末不存在减值情形。

2、土地使用权

截至 2026 年 6 月 30 日，公司土地使用权情况如下：

序号	使用人	产权证书	坐落	取得方式	用途	面积(m ²)	终止日期
1	公司	赣(2021)井开区不动产权第0000159号	火炬大道西侧	出让	工业用地	9,920.00	2067.02.14
2	公司	赣(2021)井开区不动产权第0000160号	火炬大道西侧	出让	工业用地	10,946.00	2067.02.14
3	公司	赣(2025)井开区不动产权第0002822号	井冈山经济技术开发区火炬大道191号	出让	工业用地	63,485.00	2070.09.21
4	公司	赣(2021)井开区不动产权第0000004号	火炬大道与嘉华大道交叉口西北角	出让	工业用地	3,818.95	2059.02.01
5	公司	赣(2019)井开区不动产权第0002692号	井冈山经济技术开发区火炬大道191号	出让	工业用地	17,520.00	2067.02.14

发行人除上述拥有的土地使用权外，根据井冈山经济技术开发区不动产登记中心于2025年11月14日出具的《查询结果证明》，公司另有一块坐落于井冈山经济技术开发区火炬大道与嘉华大道交叉口西北角的用地，该宗地为发行人以出让方式取得的工业用地，面积为58,309平方米，使用期限自2009年2月2日起至2059年2月1日止。

2024年9月23日，泰国泰坤向304工业园区7号项目有限公司购买了位于泰国巴真府西玛哈坡县304工业园区7号项目第506号地块，土地面积为53莱2颜34.7平方哇（折合85,738.8平方米）。2025年9月22日，泰国泰坤与转让方完成了地契转让登记，土地期限为永久。

3、商标

截至2026年6月30日，公司拥有注册商标20件，公司商标之上未设定质押等权利限制，具体情况详见本募集说明书“附表一：商标”。

4、专利

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司拥有 186 项专利，其中发明专利 41 项，实用新型专利 143 项，外观设计专利 2 项，公司专利之上未设定质押等权利限制，具体情况详见本募集说明书“附表二：专利”。

5、著作权登记证书

截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有 47 项计算机软件著作权登记证书，具体情况详见本募集说明书“附表三：软件著作权”。

6、资质认证情况

公司及其控股子公司已取得从事生产经营活动所必需的行政许可、备案、注册或者认证，具体如下：

（1）出口业务登记

公司产品有部分出口，已经合法取得全部报关出口和对外经营相关的许可登记文件：公司持有编号为 02392667 号的《对外贸易经营者备案登记表》，并于吉安海关完成海关备案（备案编码：361026003T）。

（2）体系认证情况

认证对象	认证标准	证书注册号	认证范围	证书有效期至
公司	ISO 9001	50052383 QM15	双面和多层印刷线路板的制造	2027-08-28
	IATF 16949	50052383 IATF16	双面和多层印刷线路板的制造	2027-08-28
	ISO14001	ABZB25E30014R4L	印刷线路板的生产、加工与销售	2028-11-02
	ISO 45001	ABZB25S30012R3L	印刷线路板的生产、加工与销售	2028-05-05
	QC080000	IECQ-H ULTW 21.0004	双面和多层印刷线路板的生产	2027-09-23
	GB/T 29490-2013	00223IPMS0366R1L	线路板的研发、生产和销售所涉及的知识产权管理	2026-10-12
	ISO13485	50052383 MP2016	医疗器械用双面和多层印刷线路板的生产	2029-04-01
	ISO /IEC 27001	50052383 ISMS22	双面和多层印刷线路板的制造相关的信息安全管理	2026-11-20

认证对象	认证标准	证书注册号	认证范围	证书有效期至
	ISO 50001	50052383 EMSt21	双面和多层印刷线路板的制造所涉及的能源管理活动	2026-11-14
	ISO 14067	CN25/00002888	1 平方米二层线路板的温室气体排放量	2028-05-06
	ISO 14067	CN25/00002887	1 平方米四层线路板的温室气体排放量	2028-05-06

(3) 公司取得的排污许可证

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人持有的排污许可证情况如下：

序号	持证单位	发证单位	证书编号	有效期限
1	满坤科技	吉安市生态环境局	91360805672429045F002V	2025 年 1 月 3 日至 2030 年 1 月 2 日

(4) 安全生产相关证书

序号	持证人	证书名称	发证机关	种类和范围	证书编号	有效期至
1	满坤科技	辐射安全许可证	吉安市生态环境局	使用 III 类射线装置	赣环辐证[D2569]	2030.11.08
2	满坤科技	安全生产标准化证书	井冈山经济技术开发区应急管理局	安全生产标准化三级企业（机械）	赣 AQBXXIII202300083	2026.11.1

发行人取得的上述行政许可、备案、注册或者认证等，不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险或者存在到期无法延续的风险。

十、公司特许经营权情况

截至本募集说明书签署日，公司无特许经营权。

十一、公司重大资产重组情况

报告期内，公司未发生过重大资产重组情况。

十二、公司境外经营的情况

截至本募集说明书签署日，公司在中国香港设有全资子公司伟仁达，为公司的境外销售平台；在新加坡设有全资子公司新加坡泰坤，为公司的境外贸易主体；在泰国设有控股子公司泰国泰坤，为公司的境外生产基地。截至本募集说明书签署日，该生产基地仍在建设中，尚未开展实际经营活动。

十三、公司报告期内的分红情况

公司最近三年的现金分红情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	11,947.81	10,649.80	10,978.15
现金分红（含税）	6,219.62	6,204.81	5,987.28
当年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	52.06%	58.26%	54.54%

2024 年 5 月 13 日，公司 2023 年年度股东大会会议审议通过《2023 年度利润分配预案》，以总股本 147,470,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.06 元（含税），共计派发现金 59,872,820 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红金额占 2023 年度合并报表归属上市公司普通股股东的净利润的 54.54%，符合《公司章程》的有关规定。

2025 年 5 月 12 日，公司 2024 年年度股东大会会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，以总股本 148,086,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.19 元（含税），共计派发现金 62,048,138.33 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红金额占 2024 年度合并报表归属上市公司普通股股东的净利润的 58.26%，符合《公司章程》的有关规定。

2026 年 5 月 19 日，公司 2025 年度股东会会议审议通过《2025 年度利润分配预案》，以总股本 148,086,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），共计派发现金 62,196,224.58 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红金额占 2025 年度合并报表归属上市公司普通股股东的净利润的 52.06%，符合《公司章程》规定。

公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营和项目建设，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。

十四、公司最近三年发行的债券情况

（一）最近三年债券发行和偿还情况

报告期内，公司不存在对外发行债券的情形。

（二）最近三年平均可分配利润足以支付各类债券一年的利息

2023 年度、2024 年度、2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润分别为 10,978.15 万元、10,649.80 万元和 11,947.81 万元，平均可分配利润为 11,191.92 万元；同期公司经营活动产生的现金流量净额分别为 11,585.92 万元、10,962.40 万元、4,977.69 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额平均值为 9,175.34 万元。

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 76,000.00 万元，参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。

第五节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自公司 2023 年、2024 年、2025 年已经审计的财务报告以及未经审计的 2026 年 1-6 月财务报告。财务指标根据上述财务报表为基础编制。投资者欲对公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，请仔细阅读公司的财务报告和审计报告全文。

一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平

（一）审计意见类型

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年度、2024 年度和 2025 年度财务报告进行了审计并分别出具了天健审[2024]3-159 号、天健审[2025]3-236 号、天健审[2026]3-370 号标准无保留意见的审计报告。公司 2026 年 1-6 月数据未经审计。

（二）重要性水平

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在此基础上，公司进一步判断项目金额的重要性。发行人在本节披露的财务会计信息相关重大事项标准为当年利润总额的 5%，或金额虽未达到当年利润总额的 5%但公司认为重要的相关事项。

二、最近三年合并财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
流动资产：				
货币资金	41,139.25	50,226.51	84,032.97	84,426.43

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
交易性金融资产	24,090.38	20,614.98	-	-
应收票据	3,015.95	3,331.17	2,020.18	3,041.10
应收账款	59,759.65	55,967.99	47,492.09	39,441.39
应收款项融资	10,223.21	6,376.16	9,761.96	7,240.16
预付款项	137.28	111.19	80.83	183.24
其他应收款	141.19	119.56	262.64	72.00
存货	28,239.95	24,766.47	15,338.27	10,534.23
合同资产	87.30	87.30	116.40	96.03
持有待售资产	-	37.17	-	-
其他流动资产	7,754.32	6,740.93	4,383.53	1,748.16
流动资产合计	174,588.48	168,379.43	163,488.86	146,782.72
非流动资产：				
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	2,000.00	-	-	-
固定资产	101,576.21	104,482.95	94,120.93	41,983.04
在建工程	20,452.62	12,732.65	13,595.10	30,823.19
使用权资产	817.89	51.00	232.16	1,122.04
无形资产	4,617.09	4,622.71	1,428.86	1,523.51
长期待摊费用	328.18	430.58	682.67	611.73
递延所得税资产	2,143.71	2,060.78	1,251.17	1,092.04
其他非流动资产	2,601.34	3,137.62	3,453.26	3,689.35
非流动资产合计	134,537.04	127,518.29	114,764.16	80,844.89
资产总计	309,125.52	295,897.72	278,253.02	227,627.61
流动负债：				
短期借款	8,009.55	8,504.86	5,514.12	5,004.11
应付票据	33,449.95	33,037.26	25,768.69	15,166.66
应付账款	65,062.58	61,043.35	63,136.21	29,677.26
合同负债	3,199.70	36.18	-	47.87
应付职工薪酬	2,016.20	2,080.63	1,899.01	1,948.01
应交税费	868.83	963.35	458.97	564.78
其他应付款	6,620.20	348.13	180.58	500.89
一年内到期的非流动负债	148.46	51.82	192.42	330.80
其他流动负债	414.02	-	-	6.11
流动负债合计	119,789.47	106,065.58	97,149.98	53,246.49
非流动负债：				
租赁负债	718.74	-	82.72	858.20
长期应付款	-	-	-	-

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
递延收益	8,295.90	7,742.94	3,947.61	2,726.78
递延所得税负债	203.09	85.85	120.86	264.43
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	9,217.72	7,828.79	4,151.19	3,849.41
负债合计	129,007.19	113,894.37	101,301.17	57,095.90
所有者权益：				
股本	14,808.62	14,808.62	14,808.62	14,747.00
资本公积	102,860.17	102,860.17	103,732.19	102,087.59
其它综合收益	156.46	220.01	46.36	1.68
盈余公积	8,231.96	8,231.96	7,076.75	6,589.76
未分配利润	54,060.71	55,882.22	51,287.58	47,105.69
归属于母公司所有者权益合计	180,117.92	182,002.98	176,951.50	170,531.72
少数股东权益	0.40	0.38	0.35	-
所有者权益合计	180,118.33	182,003.35	176,951.85	170,531.72
负债和所有者权益总计	309,125.52	295,897.72	278,253.02	227,627.61

(二) 合并利润表

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业总收入	94,238.36	164,715.46	126,773.20	121,699.39
减：营业成本	78,534.97	135,031.16	103,146.37	97,789.46
税金及附加	610.30	1,019.50	731.64	621.00
销售费用	1,526.70	3,367.16	2,916.08	2,946.31
管理费用	3,284.35	6,549.74	7,276.50	5,960.84
研发费用	4,679.03	6,320.79	5,380.08	5,096.63
财务费用	858.89	-525.88	-2,293.92	-2,950.63
其中：利息费用	92.20	187.31	206.60	221.46
减：利息收入	274.92	1,441.45	2,156.50	2,751.16
加：其他收益（损失以“-”号填列）	892.44	2,386.30	2,021.17	893.82
投资收益（损失以“-”号填列）	167.13	165.44	434.98	106.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	63.38	15.08	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-124.15	-344.94	-268.05	-172.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-473.08	-2,106.09	-712.54	-341.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48.60	-241.75	-354.32	31.29
二、营业利润	5,221.24	12,827.04	10,737.69	12,753.65
加：营业外收入	15.18	73.05	14.38	8.60

项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
减：营业外支出	82.00	21.87	132.32	127.34
三、利润总额	5,154.43	12,878.22	10,619.76	12,634.91
减：所得税费用	756.31	930.41	-30.05	1,656.76
四、净利润	4,398.12	11,947.81	10,649.80	10,978.15
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,398.12	11,947.81	10,649.80	10,978.15
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,398.12	11,947.81	10,649.80	10,978.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.00	-0.01	-0.00	-
五、其他综合收益的税后净额	-63.52	173.68	44.68	1.90
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63.55	173.65	44.68	1.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-63.55	173.65	44.68	1.90
1.外币财务报表折算差额	-63.55	173.65	44.68	1.90
2.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.03	0.03	-	-
六、综合收益总额	4,334.60	12,121.49	10,694.48	10,980.05
归属于母公司普通股股东综合收益总额	4,334.57	12,121.47	10,694.48	10,980.05
归属于少数股东综合收益总额	0.03	0.02	0.00	-
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.30	0.81	0.72	0.74
（二）稀释每股收益（元/股）	0.30	0.81	0.72	0.74

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	80,058.26	130,996.29	104,027.05	91,527.31
收到的税费返还	0.94	1,179.64	-	5.11

项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
收到其他与经营活动有关的现金	2,067.25	11,277.99	3,159.77	2,172.55
经营活动现金流入小计	82,126.45	143,453.93	107,186.82	93,704.96
购买商品、接受劳务支付的现金	58,960.05	101,254.25	66,277.39	55,424.49
支付给职工以及为职工支付的现金	13,659.58	27,370.30	23,819.73	20,078.58
支付的各项税费	2,286.56	4,550.91	1,382.79	2,190.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,507.28	5,300.78	4,744.51	4,425.00
经营活动现金流出小计	77,413.47	138,476.23	96,224.42	82,119.05
经营活动产生的现金流量净额	4,712.98	4,977.69	10,962.40	11,585.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	57,125.00	236,622.90	26,919.50	33,500.00
取得投资收益收到的现金	230.11	165.44	31.16	106.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39.70	166.54	147.77	188.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	546.61	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	57,394.81	236,954.88	27,645.04	33,795.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,424.90	12,144.44	9,843.88	26,819.42
投资支付的现金	62,600.00	257,222.80	26,919.50	30,500.00
投资活动现金流出小计	72,024.90	269,367.24	36,763.38	57,319.42
投资活动产生的现金流量净额	-14,630.09	-32,412.35	-9,118.34	-23,523.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	889.60	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	0.35	-
取得借款收到的现金	5,000.00	11,500.00	6,500.00	8,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	5,000.00	11,500.00	7,389.60	8,500.00
偿还债务支付的现金	4,000.00	8,510.00	5,990.00	6,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86.88	6,378.51	6,160.71	5,026.30
支付其他与筹资活动有关的现金	74.65	189.34	256.14	400.92
筹资活动现金流出小计	4,161.53	15,077.85	12,406.85	11,927.21
筹资活动产生的现金流量净额	838.47	-3,577.85	-5,017.25	-3,427.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-609.33	-500.59	421.07	439.01
五、现金及现金等价物净增加额	-9,687.97	-31,513.10	-2,752.13	-14,926.23
加：期初现金及现金等价物余额	44,589.89	76,102.99	78,855.11	93,781.34

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
六、期末现金及现金等价物余额	34,901.92	44,589.89	76,102.99	78,855.11

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定编制财务报表。

（二）合并财务报表范围

截至 2026 年 6 月 30 日，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：

序号	子公司名称	主要经营地	持股比例	取得方式
1	深圳满坤科技	深圳	100.00%	投资设立
2	伟仁达（GRAND HOPE TECHNOLOGY CO.,LIMITED）	中国香港	100.00%	投资设立
3	新加坡泰坤（THAI KUN PTE. LTD.）	新加坡	100.00%	投资设立
4	泰 国 泰 坤 （ THAI KUN CIRCUIT CO.,LTD.）	泰国	99.99%	投资设立

（三）合并财务报表范围的变化情况

1、2023 年度合并报表范围变化情况

2023 年度，公司合并报表范围未发生变动。

2、2024 年合并报表范围变化情况

序号	子公司名称	变动方向	变动原因
1	新加坡泰坤（THAI KUN PTE. LTD.）	增加	新设子公司
2	泰 国 泰 坤 （ THAI KUN CIRCUIT CO.,LTD.）	增加	新设子公司
3	深圳满坤电子	减少	出售子公司

3、2025 年合并报表范围变化情况

2025 年，公司合并报表范围未发生变动。

4、2026 年 1-6 月合并报表范围变化情况

2026 年 1-6 月，公司合并报表范围未发生变动。

四、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正

（一）会计政策变更

1、2023 年度变更情况说明

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行，执行解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。

2、2024 年度变更情况说明

（1）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，并对可比期间信息进行调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（3）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（4）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、2025 年变更情况说明

2025 年，公司主要会计政策未发生变更。

4、2026 年 1-6 月变更情况说明

2026 年 1-6 月，公司主要会计政策未发生变更。

（二）会计估计变更情况

报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

（三）会计差错更正

报告期内，公司无会计差错更正事项。

五、最近三年的主要财务指标

（一）主要财务指标

项目	2026-06-30 /2026 年 1-6 月	2025-12-31 /2025 年度	2024-12-31 /2024 年度	2023-12-31 /2023 年度
流动比率（倍）	1.46	1.59	1.68	2.76
速动比率（倍）	1.22	1.35	1.52	2.56
资产负债率（合并）	41.73%	38.49%	36.41%	25.08%
资产负债率（母公司）	41.80%	38.53%	36.37%	24.10%
每股净资产（元/股）	12.16	12.29	11.95	11.56
应收账款周转率（次）	1.63	3.18	2.92	3.30
存货周转率（次）	2.96	6.73	7.97	8.21
总资产周转率（次）	0.31	0.57	0.50	0.55
每股经营性现金净流量（元/	0.32	0.34	0.74	0.79

股)				
每股净现金流量 (元/股)	-0.65	-2.13	-0.19	-1.01
利息保障倍数 (倍)	56.90	69.75	52.40	58.05

注：主要财务指标计算说明：

- (1) 流动比率=期末流动资产/期末流动负债
- (2) 速动比率=(期末流动资产-期末存货)/期末流动负债
- (3) 资产负债率=(期末负债总额/期末资产总额)×100%
- (4) 资产负债率(母公司)=(母公司期末负债总额/母公司期末资产总额)
- (5) 每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- (6) 应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值)*2
- (7) 存货周转率=营业成本/(期初存货账面价值+期末存货账面价值)*2
- (8) 总资产周转率=营业收入/(期初总资产+期末总资产)*2
- (9) 每股经营性现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- (10) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加(或减少)额/期末总股本
- (11) 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

(二) 净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求,公司加权平均净资产收益率及每股收益如下:

项目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2026年1-6月	2.40%	0.30	0.30
	2025年度	6.68%	0.81	0.81
	2024年度	6.16%	0.72	0.72
	2023年度	6.59%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2026年1-6月	2.06%	0.25	0.25
	2025年度	5.91%	0.71	0.71
	2024年度	5.14%	0.60	0.60
	2023年度	6.18%	0.70	0.70

六、财务状况分析

(一) 资产构成及变化分析

报告期各期末，公司资产总体构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2026-06-30		2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	174,588.48	56.48	168,379.43	56.90	163,488.86	58.76	146,782.72	64.48
非流动资产	134,537.04	43.52	127,518.29	43.10	114,764.16	41.24	80,844.89	35.52
合计	309,125.52	100.00	295,897.72	100.00	278,253.02	100.00	227,627.61	100.00

报告期各期末，公司总资产分别为 227,627.61 万元、278,253.02 万元、295,897.72 万元和 309,125.52 万元，总资产规模呈现增长态势。报告期各期末，公司流动资产分别为 146,782.72 万元、163,488.86 万元、168,379.43 万元和 174,588.48 万元，占总资产比例分别为 64.48%、58.76%、56.90%和 56.48%；公司非流动资产分别为 80,844.89 万元、114,764.16 万元、127,518.29 万元和 134,537.04 万元，占总资产比例分别为 35.52%、41.24%、43.10%和 43.52%。

报告期各期末，公司的流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2026-06-30		2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	41,139.25	23.56	50,226.51	29.83	84,032.97	51.40	84,426.43	57.52
交易性金融资产	24,090.38	13.80	20,614.98	12.24	-	-	-	-
应收票据	3,015.95	1.73	3,331.17	1.98	2,020.18	1.24	3,041.10	2.07
应收账款	59,759.65	34.23	55,967.99	33.24	47,492.09	29.05	39,441.39	26.87
应收款项融资	10,223.21	5.86	6,376.16	3.79	9,761.96	5.97	7,240.16	4.93
预付款项	137.28	0.08	111.19	0.07	80.83	0.05	183.24	0.12
其他应收款	141.19	0.08	119.56	0.07	262.64	0.16	72.00	0.05
存货	28,239.95	16.18	24,766.47	14.71	15,338.27	9.38	10,534.23	7.18
合同资产	87.30	0.05	87.30	0.05	116.40	0.07	96.03	0.07
持有待售资产	-	-	37.17	0.02	-	-	-	-
其他流动资产	7,754.32	4.44	6,740.93	4.00	4,383.53	2.68	1,748.16	1.19
流动资产合计	174,588.48	100.00	168,379.43	100.00	163,488.86	100.00	146,782.72	100.00

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2026-06-30		2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他权益工具投资	2,000.00	1.49	-	-	-	-	-	-
固定资产	101,576.21	75.50	104,482.95	81.94	94,120.93	82.01	41,983.04	51.93
在建工程	20,452.62	15.20	12,732.65	9.98	13,595.10	11.85	30,823.19	38.13
使用权资产	817.89	0.61	51.00	0.04	232.16	0.20	1,122.04	1.39
无形资产	4,617.09	3.43	4,622.71	3.63	1,428.86	1.25	1,523.51	1.88
长期待摊费用	328.18	0.24	430.58	0.34	682.67	0.59	611.73	0.76
递延所得税资产	2,143.71	1.59	2,060.78	1.62	1,251.17	1.09	1,092.04	1.35
其他非流动资产	2,601.34	1.93	3,137.62	2.46	3,453.26	3.01	3,689.35	4.56
非流动资产合计	134,537.04	100.00	127,518.29	100.00	114,764.16	100.00	80,844.89	100.00

公司资产主要项目具体情况如下：

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
库存现金	1.38	1.38	1.11	1.45
银行存款	32,432.04	45,465.41	80,171.49	81,464.50
其他货币资金	8,705.83	4,759.72	3,860.37	2,960.48
合计	41,139.25	50,226.51	84,032.97	84,426.43

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 84,426.43 万元、84,032.97 万元、50,226.51 万元和 41,139.25 万元，主要由银行存款和其他货币资金构成，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。2023 年至 2024 年公司货币资金余额总体保持稳定，2025 年末及 2026 年 6 月末，公司货币资金有所减少，主要系随着公司 IPO 募投项目的建设进度，公司支付了相应的项目进度款，另一方面公司利用闲置资金购买理财产品。

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

2、交易性金融资产

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,090.38	20,614.98	-	-
其中：理财产品	24,090.38	20,614.98	-	-
合计	24,090.38	20,614.98	-	-

报告期各期末，公司交易性金融资产分别为 0 万元、0 万元、20,614.98 万元和 24,090.38 万元，占流动资产的比例分别为 0%、0%、12.24%和 13.80%。2025 年末及 2026 年 6 月末的交易性金融资产主要系公司购买的短期保本型理财产品。

3、应收票据

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资构成情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应收票据-银行承兑汇票	3,015.95	3,331.17	2,020.18	3,041.10
合计	3,015.95	3,331.17	2,020.18	3,041.10

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为 3,041.10 万元、2,020.18 万元、3,331.17 万元和 3,015.95 万元。公司对期末应收票据按组合计提坏账准备，对银行承兑汇票参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计提坏账准备，对商业承兑汇票组合按照预期信用损失率计提坏账准备。

4、应收款项融资

报告期各期末，应收款项融资构成情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应收款项融资-银行承兑汇票	10,223.21	6,376.16	9,761.96	7,240.16
合计	10,223.21	6,376.16	9,761.96	7,240.16

报告期各期末，公司应收款项融资账面价值分别为 7,240.16 万元、9,761.96 万元、6,376.16 万元和 10,223.21 万元。公司应收款项融资主要系公司将未到期

应收票据背书给供应商所形成的款项，随着公司 IPO 募投项目工程相关款项的支付，公司应收款项融资金额有所波动。

5、应收账款

（1）应收账款变动分析

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应收账款余额	61,704.64	57,776.15	48,967.80	40,665.10
减：坏账准备	1,944.98	1,808.16	1,475.71	1,223.71
应收账款账面价值	59,759.65	55,967.99	47,492.09	39,441.39
营业收入	94,238.36	164,715.46	126,773.20	121,699.39
应收账款账面价值/营业收入	31.71%	33.98%	37.46%	32.41%

注：2026 年 1-6 月应收账款账面价值/营业收入数据已年化处理。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 39,441.39 万元、47,492.09 万元、55,967.99 万元和 59,759.65 万元，占各期营业收入的比例依次为 32.41%、37.46%、33.98%和 31.71%。报告期内，随着业务规模扩大，公司应收账款余额与营业收入增长趋势基本保持一致。

（2）坏账准备计提情况

报告期内，应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元、%

2026-06-30					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项计提预期信用损失的应收账款	65.79	0.11	65.79	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	61,638.85	99.89	1,879.20	3.05%	59,759.65
其中：账龄组合	61,638.85	99.89	1,879.20	3.05%	59,759.65
合计	61,704.64	100.00	1,944.98	3.15%	59,759.65
2025-12-31					

项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项计提预期信用损失的应收账款	374.93	0.65	65.79	17.55	309.14
按组合计提预期信用损失的应收账款	57,401.22	99.35	1,742.37	3.04	55,658.85
其中：账龄组合	57,401.22	99.35	1,742.37	3.04	55,658.85
合计	57,776.15	100.00	1,808.16	3.13	55,967.99
2024-12-31					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	48,967.80	100.00	1,475.71	3.01	47,492.09
其中：账龄组合	48,967.80	100.00	1,475.71	3.01	47,492.09
合计	48,967.80	100.00	1,475.71	3.01	47,492.09
2023-12-31					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	40,665.10	100.00	1,223.71	3.01	39,441.39
其中：账龄组合	40,665.10	100.00	1,223.71	3.01	39,441.39
合计	40,665.10	100.00	1,223.71	3.01	39,441.39

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 3.01%、3.01%、3.13%和 3.15%，公司坏账准备计提比例稳定。

（3）同行业坏账准备计提情况对比分析

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业公司情况如下：

证券简称	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
胜宏科技	1.04%	1.04%	1.03%	1.38%
中富电路	5.40%	5.59%	5.47%	5.74%
科翔股份	7.36%	7.85%	6.91%	6.35%
中京电子	2.54%	2.37%	2.29%	2.56%
崇达技术	5.00%	5.00%	5.00%	5.01%

奥士康	5.27%	5.26%	5.28%	5.29%
景旺电子	5.10%	5.12%	5.09%	5.07%
依顿电子	3.27%	3.20%	3.00%	3.55%
骏亚科技	7.32%	8.09%	8.07%	7.85%
世运电路	3.11%	3.11%	3.02%	3.62%
博敏电子	1.88%	1.89%	1.56%	2.90%
威尔高	5.06%	5.08%	5.24%	5.21%
行业均值	4.36%	4.47%	4.33%	4.54%
满坤科技	3.15%	3.13%	3.01%	3.01%

公司应收账款坏账准备计提比例低于同行业公司均值，主要系公司应收账款账龄主要集中在一年以内，账龄结构良好。

（4）报告期内主要客户的信用条款是否变化

公司制定了应收账款管理制度，该制度包括各部门职责划分、客户信用管理、应收账款核算、应收账款对账、应收账款催收和应收账款坏账管理等内容。发行人信用期的设定保证公司资金安全，防范经营风险，提高资金使用效率。发行人主要长期合作的客户的信用期一般是 60 天至 120 天，在报告期内，公司上述信用政策得到一贯执行，公司主要客户的信用政策未发生重大变动。

（5）应收账款账龄结构分析

报告期内，公司应收账款账龄情况如下：

单位：万元、%

项目	2026-06-30		2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	61,594.59	99.82	57,702.23	99.87	48,928.51	99.92	40,642.98	99.95
1-2 年	72.30	0.12	48.01	0.08	39.29	0.08	22.12	0.05
2-3 年	37.75	0.06	25.90	0.04	-	-	-	-
3-4 年	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	61,704.64	100.00	57,776.15	100.00	48,967.80	100.00	40,665.10	100.00

报告期各期末，公司应收账款账龄主要集中在一年之内，占比分别为 99.95%、99.92%、99.87%和 99.82%，公司应收账款账龄结构良好。

(6) 应收账款客户前五名情况

报告期各期末，公司应收账款前五大客户余额如下：

单位：万元、%

2026-06-30			
序号	单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例
1	海康威视	7,846.78	12.72
2	德赛西威	5,728.85	9.28
3	台达电子	5,415.77	8.78
4	群创光电	4,186.76	6.79
5	普联技术	3,976.37	6.44
合计		27,154.53	44.01
2025-12-31			
序号	单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例
1	海康威视	6,306.88	10.92
2	台达电子	5,815.74	10.07
3	德赛西威	4,476.47	7.75
4	群创光电	3,582.40	6.20
5	格力集团	2,950.08	5.11
合计		23,131.57	40.04
2024-12-31			
序号	单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例
1	海康威视	4,805.05	9.81
2	德赛西威	4,796.33	9.79
3	普联技术	3,651.95	7.46
4	台达电子	3,078.82	6.29
5	格力集团	2,498.31	5.10
合计		18,830.46	38.45
2023-12-31			
序号	单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例
1	海康威视	4,235.19	10.41
2	德赛西威	3,929.39	9.66
3	强力巨彩	3,553.25	8.74
4	台达电子	2,474.52	6.09
5	群创光电	2,089.48	5.14

合计	16,281.83	40.04
----	-----------	-------

注：上表中同一控制下的关联方已合并计算。

报告期各期末，公司客户应收账款相对集中，公司前五名应收账款金额占当期末应收账款金额的比重分别为 40.04%、38.45%、40.04%和 44.01%，公司应收账款金额较大的客户相对稳定。

（7）各期坏账准备的计提和转回

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
计提金额	136.83	332.44	256.25	160.75
转回金额	-	-	-	-
利润总额	5,154.43	12,878.22	10,619.76	12,634.91
计提占比	1.33%	2.58%	2.41%	1.27%

注：2026 年 1-6 月计提占比数据已年化处理。

报告期各期，应收账款坏账准备计提金额分别为 160.75 万元、256.25 万元、332.44 万元和 136.83 万元，占利润总额的比例分别为 1.27%、2.41%、2.58%和 1.33%，对公司的经营业绩未形成重大影响。

6、预付款项

报告期各期末，公司预付款项余额分别为 183.24 万元、80.83 万元、111.19 万元和 137.28 万元，预付款项中主要为公司预付的货款、能源费用等。

7、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款余额及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
其他应收款账面余额	165.02	156.07	286.65	86.32
坏账准备	23.83	36.51	24.02	14.32
其他应收款账面价值	141.19	119.56	262.64	72.00

报告期各期末，公司其他应收款余额构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2026-06-30		2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
押金、保证金	149.26	90.45	142.85	91.53	94.85	33.09	79.83	92.48
往来款	-	-	-	-	159.00	55.47	-	-
其他	15.76	9.55	13.22	8.47	32.80	11.44	6.49	7.52
合计	165.02	100.00	156.07	100.00	286.65	100.00	86.32	100.00

报告期各期末，公司其他应收款主要由往来款、押金和保证金等项目构成。

8、存货

(1) 存货基本情况及跌价准备计提情况

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2026-06-30			
	账面余额	跌价准备	计提比例	账面价值
原材料	11,500.52	32.18	0.28	11,468.34
在产品	5,455.26	-	-	5,455.26
库存商品	6,638.55	397.02	5.98	6,241.53
发出商品	5,654.94	580.12	10.26	5,074.82
合计	29,249.27	1,009.32	3.45	28,239.95
项目	2025-12-31			
	账面余额	跌价准备	计提比例	账面价值
原材料	7,058.71	23.31	0.33	7,035.40
在产品	4,349.28	-	-	4,349.28
库存商品	7,993.83	1,169.60	14.63	6,824.22
发出商品	7,622.55	1,064.99	13.97	6,557.56
合计	27,024.37	2,257.90	8.36	24,766.47
项目	2024-12-31			
	账面余额	跌价准备	计提比例	账面价值
原材料	3,523.51	0.42	0.01	3,523.09
在产品	4,313.47	-	-	4,313.47
库存商品	4,262.04	392.98	9.22	3,869.06
发出商品	4,041.52	408.86	10.12	3,632.66
合计	16,140.54	802.26	4.97	15,338.27
项目	2023-12-31			
	账面余额	跌价准备	计提比例	账面价值

原材料	2,910.00	15.09	0.52	2,894.91
在产品	2,333.86	-	-	2,333.86
库存商品	3,783.43	241.24	6.38	3,542.19
发出商品	2,005.06	241.79	12.06	1,763.27
合计	11,032.34	498.12	4.52	10,534.23

印制电路板行业的产品均为定制化产品，采取“以销定产”的生产模式，公司根据订单情况制定生产计划。报告期内，随着订单量增长，公司的存货规模不断增加，与公司业务规模变动相匹配。

公司根据自身经营特点制定了相应的存货管理制度，确保存货安全和提高存货运营效率。该制度涵盖了原材料的采购入库及领用、产品的生产及出入库、存货报废、仓库管理、存货盘点等关键环节。同时，发行人将该存货管理制度与存货供应链系统相配合，确保存货确认、计量、记录的准确性。

发行人绝大多数存货集中在一年以内，存货库龄状态良好，不存在大量的残次冷备品，亦不存在大量滞销、销售退回或换货等情况。报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例分别为 4.52%、4.97%、8.36%和 3.45%，跌价准备计提比例充分。2025 年，公司存货跌价准备计提比例增加主要系受公司原材料采购价格上涨叠加固定成本增加影响，导致库存商品单位成本上升幅度较大所致。2026 年上半年，受下游市场供需格局变化、原材料价格大幅波动等因素影响，公司通过与主要客户及时沟通并进行多次调价，公司产品销售价格显著上涨，使得公司存货跌价计提比例有所下降；同时，公司库存商品和发出商品均有所减少。

（2）同行业存货跌价准备计提比例对比分析

报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例与同行业公司对比情况如下：

证券简称	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
胜宏科技	1.85%	3.06%	4.37%	6.33%
中富电路	7.90%	8.27%	5.17%	5.47%
科翔股份	8.73%	10.48%	11.19%	12.72%
中京电子	4.95%	7.08%	6.35%	4.63%

证券简称	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
崇达技术	13.49%	20.11%	23.02%	21.12%
奥士康	7.05%	7.48%	6.54%	7.82%
景旺电子	1.14%	2.01%	3.27%	3.28%
依顿电子	2.77%	3.24%	3.27%	5.84%
骏亚科技	10.60%	10.65%	10.35%	10.11%
世运电路	5.00%	4.98%	3.32%	6.21%
博敏电子	5.47%	5.12%	10.23%	7.94%
威尔高	4.73%	9.02%	10.56%	6.52%
行业均值	6.14%	7.63%	8.14%	8.17%
发行人	3.45%	8.36%	4.97%	4.52%

如上表所示，2023 年至 2024 年，公司存货跌价准备计提比例低于同行业可比公司均值。同行业公司之间存货跌价准备计提比例差异较大，主要与其业务结构、年生产批量批次、超出订单形成尾数库存以及存货管理模式相关，其中如崇达技术存货跌价比例计提较高，拉高了行业均值。2025 年，公司存货跌价准备计提比例大幅提高主要受公司原材料采购价格上涨叠加固定成本增加影响所致。2026 年 6 月末，公司存货跌价计提比例下降，主要系公司产品销售单价上涨所致。公司的存货采用成本与可变现净值孰低的原则进行计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，存货跌价准备主要为少量超出订单生产形成的尾数库存及长库龄存货，存货跌价准备计提充分。

（3）发出商品情况

公司针对部分大客户采取 VMI 存货管理模式，因此公司存货结构中发出商品占比较高，截至 2026 年 6 月末公司发出商品对应主要客户情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	发出商品余额	占发出商品的比例
1	格力电器	1,244.99	22.02%
2	德赛西威	645.50	11.41%
3	台达电子	493.60	8.73%
4	Sagemcom	337.84	5.97%
5	强力巨彩	263.89	4.67%
合计		2,985.82	52.80%

注：上表中同一控制下的关联方已合并计算。

根据协议约定，公司 VMI 模式下一般由客户或客户指定的仓储方负责仓库管理，并承担仓储期间商品发生毁损的责任。后续 VMI 客户根据生产情况领用产品后，发行人一般按月与客户对账，确认客户当月领用数量、金额，将客户月度领用金额确认当月收入，并结转营业成本。公司 VMI 模式下发出商品主要客户仓库所在地包括深圳、厦门、惠州、郑州等地，公司存货管理模式符合 PCB 行业惯例、客户交易习惯。

9、其他流动资产

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
留抵增值税	7,754.32	6,740.93	4,383.53	1,748.16
合计	7,754.32	6,740.93	4,383.53	1,748.16

报告期各期末，公司其他流动资产为留抵增值税。2024 年至 2026 年 6 月末其他流动资产余额增长较多，主要系留抵增值税增加所致。

10、其他权益工具

2026 年 6 月末，公司其他权益工具投资金额为 2,000.00 万元，主要系公司为加强与上游产业链的协同，于 2026 年 5 月投资产业基金杭州福斯特电子材料有限公司所致，具体详见本章节“（五）截至最近一期末公司财务性投资情况”。

11、固定资产

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
一、账面原值	149,508.84	147,208.06	127,772.05	73,068.16
房屋及建筑物	54,562.70	54,562.70	51,656.43	15,769.76
机器设备	92,094.65	89,850.78	73,726.47	54,611.04
运输工具	158.07	158.07	155.87	222.02
其他设备	2,693.41	2,636.51	2,233.29	2,465.35

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
二、累计折旧	47,932.63	42,725.11	33,651.12	31,085.12
房屋及建筑物	10,216.04	8,890.56	6,378.31	5,372.72
机器设备	35,744.26	31,863.26	25,392.07	23,523.18
运输工具	120.18	113.24	123.02	164.62
其他设备	1,852.15	1,858.05	1,757.71	2,024.60
三、减值准备	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
四、账面价值	101,576.21	104,482.95	94,120.93	41,983.04
房屋及建筑物	44,346.66	45,672.13	45,278.12	10,397.04
机器设备	56,350.39	57,987.52	48,334.40	31,087.86
运输工具	37.90	44.83	32.84	57.40
其他设备	841.26	778.46	475.58	440.75

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等。报告期各期末，公司固定资产原值分别为 73,068.16 万元、127,772.05 万元、147,208.06 万元和 149,508.84 万元，呈逐年增加的趋势，主要系报告期内公司新增房屋及建筑物和机器设备所致。报告期内随着公司新建厂房和生产线逐步建成达产，资本性支出金额较大，使得固定资产持续增长。

报告期内，公司固定资产运行状况良好，不存在闲置的固定资产，因此公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

12、在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面余额分别为 30,823.19 万元、13,595.10 万元、12,732.65 万元和 20,452.62 万元，占当年非流动资产的比例分别为 38.13%、11.85%、9.98%和 15.20%。公司在建工程主要包括高精密印制线路板生产基地、扩建吉安高精密印制线路板生产基地建设项目、待安装设备、装修改造工程等。报告期各期末，公司在建工程处于正常建设状态，待达到可使用状态后根据企业会计准则的相关规定转为固定资产，不存在减值迹象。

13、使用权资产

使用权资产是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，公司使用权资产采用年限平均法计提折旧。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对公司租赁的机器设备、办公场地等经营性租赁确认为使用权资产和租赁负债。2023 年末、2024 年末、2025 年末和 2026 年 6 月末公司使用权资产账面价值分别为 1,122.04 万元、232.16 万元、51.00 万元和 817.89 万元，主要系公司租赁房屋及建筑物形成的使用权资产。

14、无形资产

报告期各期末，公司无形资产具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
一、账面原值	5,452.48	5,435.27	2,193.39	2,176.93
土地使用权	4,992.84	4,992.84	1,750.96	1,750.96
软件	459.64	442.43	442.43	425.97
二、累计摊销	835.39	812.56	764.54	653.43
土地使用权	401.25	383.74	348.72	313.71
软件	434.14	428.82	415.81	339.72
三、减值准备	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、账面价值	4,617.09	4,622.71	1,428.86	1,523.51
土地使用权	4,591.58	4,609.09	1,402.23	1,437.25
软件	25.50	13.62	26.62	86.25

报告期内，公司拥有的土地使用权不存在过时、闲置、被终止使用或创造的经济绩效低于或将低于预期等减值迹象；公司拥有的软件目前均有效使用，不存在闲置或无法使用的软件，因此公司无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

15、长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
----	------------	------------	------------	------------

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
装修费用	328.18	430.58	682.67	611.73
合计	328.18	430.58	682.67	611.73

16、递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
资产减值准备及坏账准备	452.32	626.47	339.64	241.81
内部交易未实现利润	-	-	-	0.07
可抵扣亏损	316.93	265.10	168.67	87.94
与资产相关政府补助	1,244.38	1,161.44	592.14	409.02
租赁负债	130.08	7.77	41.27	178.35
股份支付费用	-	-	109.44	174.85
合计	2,143.71	2,060.78	1,251.17	1,092.04

2023 年至 2024 年公司递延所得税资产基本保持稳定，2025 年末，公司递延所得税资产较 2024 年末有所增加，主要系公司与资产相关的政府补助所产生的递延所得税资产增加所致。

17、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产主要为预付设备款和预付工程款，具体如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
预付长期资产款	2,601.34	3,137.62	3,453.26	3,689.35
合计	2,601.34	3,137.62	3,453.26	3,689.35

（二）负债构成及变化分析

报告期各期末，公司负债总体构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2026-06-30		2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	119,789.47	92.85	106,065.58	93.13	97,149.98	95.90	53,246.49	93.26

项目	2026-06-30		2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
非流动负债	9,217.72	7.15	7,828.79	6.87	4,151.19	4.10	3,849.41	6.74
合计	129,007.19	100.00	113,894.37	100.00	101,301.17	100.00	57,095.90	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 57,095.90 万元、101,301.17 万元、113,894.37 万元和 129,007.19 万元，公司负债规模总体呈增长趋势。

报告期各期末，流动负债分别为 53,246.49 万元、97,149.98 万元、106,065.58 万元和 119,789.47 万元，占总负债比例分别为 93.26%、95.90%、93.13%和 92.85%，流动负债为负债的主要组成部分，具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2026-06-30		2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	8,009.55	6.69	8,504.86	8.02	5,514.12	5.68	5,004.11	9.40
应付票据	33,449.95	27.92	33,037.26	31.15	25,768.69	26.52	15,166.66	28.48
应付账款	65,062.58	54.31	61,043.35	57.55	63,136.21	64.99	29,677.26	55.74
合同负债	3,199.70	2.67	36.18	0.03	-	-	47.87	0.09
应付职工薪酬	2,016.20	1.68	2,080.63	1.96	1,899.01	1.95	1,948.01	3.66
应交税费	868.83	0.73	963.35	0.91	458.97	0.47	564.78	1.06
其他应付款	6,620.20	5.53	348.13	0.33	180.58	0.19	500.89	0.94
一年内到期的非流动负债	148.46	0.12	51.82	0.05	192.42	0.20	330.80	0.62
其他流动负债	414.02	0.35	-	-	-	-	6.11	0.01
流动负债合计	119,789.47	100.00	106,065.58	100.00	97,149.98	100.00	53,246.49	100.00

报告期各期末，非流动负债分别为 3,849.41 万元、4,151.19 万元、7,828.79 万元和 9,217.72 万元，占总负债比重分别为 6.74%、4.10%、6.87%和 7.15%，具体如下：

单位：万元、%

项目	2026-06-30		2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
租赁负债	718.74	7.80	-	-	82.72	1.99	858.20	22.29
递延收益	8,295.90	90.00	7,742.94	98.90	3,947.61	95.10	2,726.78	70.84
递延所得税负债	203.09	2.20	85.85	1.10	120.86	2.91	264.43	6.87
非流动负债合计	9,217.72	100.00	7,828.79	100.00	4,151.19	100.00	3,849.41	100.00

公司负债主要项目具体情况如下：

1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款构成情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
信用借款	8,009.55	8,504.86	5,514.12	5,004.11
合计	8,009.55	8,504.86	5,514.12	5,004.11

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 5,004.11 万元、5,514.12 万元、8,504.86 万元和 8,009.55 万元，占流动负债比例分别为 9.40%、5.68%、8.02% 和 6.69%。

2、应付票据

报告期各期末，公司应付票据构成情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
银行承兑汇票	33,449.95	33,037.26	25,768.69	15,166.66
合计	33,449.95	33,037.26	25,768.69	15,166.66

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 15,166.66 万元、25,768.69 万元、33,037.26 万元和 33,449.95 万元，占流动负债的比例分别为 28.48%、26.52%、31.15%和 27.92%，公司应付票据全部为银行承兑汇票。报告期各期末应付票据增加较多的主要原因系，随着公司业务规模扩大，为充分利用银行授信并提高资金运用效率，公司与部分供应商以银行承兑汇票形式进行结算，从而使得报告期内应付票据余额增加。

3、应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应付货款	42,834.88	37,884.88	31,114.65	25,515.32

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应付设备款、工程款	21,176.87	21,864.62	30,462.49	3,150.81
其他成本费用	1,050.82	1,293.85	1,559.06	1,011.13
合计	65,062.58	61,043.35	63,136.21	29,677.26

报告期各期末，公司应付账款的余额分别为 29,677.26 万元、63,136.21 万元、61,043.35 万元和 65,062.58 万元，占同期流动负债的比例分别为 55.74%、64.99%、57.55%和 54.31%。2024 年末，公司应付账款余额同比增长较多的主要原因为随着公司 IPO 募投项目等在建工程的建设，公司应付设备及工程款项增加较多。

4、合同负债

报告期内，公司合同负债主要系预收客户的货款，报告期各期末金额较小及占流动负债的比例较小。报告期各期末，公司合同负债余额分别为 47.87 万元、0 万元、36.18 万元和 3,199.70 万元。2026 年上半年，公司预收货款增加，主要系部分客户提前锁单支付货款所致。

5、应付职工薪酬

公司应付职工薪酬主要内容是短期薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴，具体如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
短期薪酬	2,016.20	2,080.63	1,897.14	1,948.01
离职后福利-设定提存计划	-	-	1.88	-
合计	2,016.20	2,080.63	1,899.01	1,948.01

6、应交税费

报告期各期末，公司应交税费主要是企业所得税、增值税等，具体如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
增值税	-	-	-	15.52
企业所得税	556.34	654.88	133.80	405.75
代扣代缴个人所得税	66.05	99.25	74.48	62.81

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
城市维护建设税	41.76	25.66	59.77	6.53
教育费附加	41.76	25.66	59.76	6.24
房产税	116.70	114.69	78.12	34.35
其他	46.21	43.22	53.03	33.59
合计	868.83	963.35	458.96	564.79

7、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
押金及保证金	230.00	160.00	100.00	235.00
应付未付款	109.44	121.22	46.66	111.05
待报销款	41.20	34.64	29.83	8.07
应付股利	6,219.62	-	-	-
其他	19.93	32.28	4.09	146.77
合计	6,620.20	348.13	180.58	500.89

公司上述应付的 2025 年度股利已于 2026 年 7 月实施完毕。

8、一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
一年内到期的租赁负债	148.46	51.82	192.42	330.80
合计	148.46	51.82	192.42	330.80

9、租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
尚未支付的租赁付款额	932.33	52.38	283.36	1,283.96
减：未确认融资费用	-38.23	0.56	8.22	94.96
一年内到期的租赁负债	-175.36	51.82	192.42	330.80
合计	718.74	-	82.72	858.20

2023 年末、2024 年末、2025 年末、2026 年 6 月末租赁负债余额分别为 858.20 万元、82.72 万元、0 万元和 718.74 万元。2024 年，公司因处置子公司深圳满坤电子导致相应的租赁减少。2026 年 6 月末，公司因更换办公楼导致租赁负债同比增加。

10、递延收益

报告期各期末，公司递延收益占非流动负债的比例较高，主要是与资产相关的政府补助，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
政府补助	8,295.90	7,742.94	3,947.61	2,726.78
合计	8,295.90	7,742.94	3,947.61	2,726.78

11、递延所得税负债

报告期各期末公司递延所得税负债余额分别为 264.43 万元、120.86 万元、85.85 万元和 203.09 万元。公司递延所得税负债主要是由购入的设备器具等一次性加计扣除及使用权资产形成的应纳税暂时性差异。

（三）资产周转能力分析

1、资产周转能力指标分析

报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：

主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
总资产周转率（次）	0.31	0.57	0.50	0.55
应收账款周转率（次）	1.63	3.18	2.92	3.30
存货周转率（次）	2.96	6.73	7.97	8.21

报告期内，公司总资产周转率分别为 0.55 次、0.50 次、0.57 次和 0.31 次，总体保持稳定；报告期内公司应收账款周转率分别为 3.30 次、2.92 次、3.18 次和 1.63 次，应收账款周转率比较平稳；报告期内公司存货周转率分别为 8.21 次、7.97 次、6.73 次和 2.96 次，公司存货周转的效率较高。

2、与同行业公司相关指标对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司的总资产周转率、应收账款周转率以及存货周转率比较情况如下：

单位：次/年

总资产周转率				
公司简称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
胜宏科技	0.24	0.71	0.59	0.50
中富电路	0.36	0.60	0.55	0.60
科翔股份	0.31	0.53	0.48	0.46
中京电子	0.22	0.48	0.46	0.40
崇达技术	0.34	0.60	0.52	0.54
奥士康	0.33	0.64	0.59	0.58
景旺电子	0.34	0.71	0.69	0.66
依顿电子	0.31	0.68	0.66	0.64
骏亚科技	0.36	0.72	0.69	0.69
世运电路	0.31	0.59	0.66	0.74
博敏电子	0.18	0.38	0.38	0.39
威尔高	0.31	0.56	0.46	0.57
行业均值	0.30	0.60	0.56	0.56
满坤科技	0.31	0.57	0.50	0.55
应收账款周转率				
公司简称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
胜宏科技	1.81	3.95	3.03	2.72
中富电路	2.30	4.51	4.27	3.81
科翔股份	1.28	2.25	2.04	2.07
中京电子	1.76	3.80	3.54	2.88
崇达技术	2.29	4.61	4.26	4.44
奥士康	1.85	3.79	3.43	3.37
景旺电子	1.73	3.46	3.26	3.02
依顿电子	1.65	3.27	3.10	3.08
骏亚科技	2.16	4.41	4.07	3.91
世运电路	1.96	3.86	3.80	3.69
博敏电子	1.28	2.65	2.69	2.58
威尔高	1.90	4.19	3.79	3.42
行业均值	1.83	3.73	3.44	3.25
满坤科技	1.63	3.18	2.92	3.30
存货周转率				
公司简称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
胜宏科技	1.72	4.80	4.85	5.03

中富电路	1.54	3.79	3.50	3.24
科翔股份	3.06	6.66	8.18	8.08
中京电子	1.80	4.01	4.16	3.72
崇达技术	2.66	5.80	6.04	5.85
奥士康	2.59	7.57	6.63	6.15
景旺电子	2.27	5.64	6.30	6.03
依顿电子	2.88	7.22	8.14	8.42
骏亚科技	2.54	5.71	6.05	5.63
世运电路	3.22	6.94	7.97	8.05
博敏电子	1.79	4.99	5.73	5.28
威尔高	1.52	3.77	3.98	4.04
行业均值	2.30	5.58	5.96	5.79
满坤科技	2.96	6.73	7.97	8.21

资料来源：Wind 资讯

与同行业可比上市公司相比，报告期内公司总资产周转率、应收账款周转率与行业平均水平较为接近；报告期内发行人存货周转率高于行业平均水平，主要系：①公司客户以内销为主，且内销主要集中在华南、华东地区，产品运输距离短，存货周转快；②公司存货管理内控制度健全，生产排期合理，能够严格按照客户需求组织备货与生产，产品交付效率较高。

综上所述，发行人总资产、应收账款和存货的周转率的变动趋势符合行业特点和公司经营特征，公司整体资产营运情况良好。

（四）偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

报告期内，公司主要偿债能力指标情况如下：

财务指标	2026-06-30/ 2026 年 1-6 月	2025-12-31/ 2025 年度	2024-12-31/ 2024 年度	2023-12-31/ 2023 年度
流动比率（倍）	1.46	1.59	1.68	2.76
速动比率（倍）	1.22	1.35	1.52	2.56
资产负债率（合并）	41.73%	38.49%	36.41%	25.08%
资产负债率（母公司）	41.80%	38.53%	36.37%	24.10%
利息保障倍数（倍）	56.90	69.75	52.40	58.05

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.76、1.68、1.59 和 1.46，速动比率分别为 2.56、1.52、1.35 和 1.22，公司合并报表资产负债率分别为 25.08%、36.41%、38.49%和 41.73%，利息保障倍数分别为 58.05、52.40、69.75 和 56.90。

报告期各期末，公司流动比率和速动比率有所下降，主要系公司当期应付货款、应付长期资产款增加所致。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货及其他流动资产组成，公司短期偿债风险较小。

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 25.08%、36.41%、38.49%和 41.73%，母公司资产负债率分别为 24.10%、36.37%、38.53%和 41.80%。公司资产负债水平处于合理范围内。

报告期各期末，公司利息保障倍数较高，分别是 58.05、52.40、69.75 和 56.90，偿债能力良好。

2、与同行业公司相关指标对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司偿债能力指标对比情况如下：

流动比率（倍）				
公司简称	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
胜宏科技	1.94	0.96	1.07	0.96
中富电路	1.18	1.23	1.49	2.55
科翔股份	0.81	0.73	0.79	0.86
中京电子	0.73	0.74	0.60	0.80
崇达技术	1.89	2.01	2.04	2.38
奥士康	1.02	1.21	1.23	1.27
景旺电子	1.47	1.44	1.58	1.81
依顿电子	1.32	1.73	2.26	1.96
骏亚科技	0.68	0.66	0.71	0.73
世运电路	2.05	2.30	3.07	2.45
博敏电子	0.89	0.95	1.07	1.35
威尔高	1.05	1.24	1.57	2.72
行业均值	1.25	1.27	1.46	1.65
满坤科技	1.46	1.59	1.68	2.76
速动比率（倍）				
公司简称	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
胜宏科技	1.62	0.74	0.80	0.78

中富电路	0.78	0.87	1.15	2.02
科翔股份	0.66	0.61	0.69	0.78
中京电子	0.49	0.53	0.40	0.57
崇达技术	1.47	1.62	1.72	2.08
奥士康	0.78	0.97	1.02	1.08
景旺电子	1.07	1.12	1.29	1.52
依顿电子	1.05	1.47	1.97	1.72
骏亚科技	0.46	0.46	0.50	0.53
世运电路	1.75	2.05	2.81	2.18
博敏电子	0.66	0.77	0.91	1.13
威尔高	0.68	0.95	1.30	2.41
行业均值	0.96	1.01	1.21	1.40
满坤科技	1.22	1.35	1.52	2.56
资产负债率				
公司简称	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
胜宏科技	39.85%	52.85%	53.44%	56.13%
中富电路	50.87%	49.57%	59.97%	48.64%
科翔股份	75.05%	75.76%	74.55%	66.48%
中京电子	64.02%	61.56%	59.15%	58.67%
崇达技术	28.14%	25.53%	37.59%	36.70%
奥士康	50.46%	49.79%	45.57%	44.16%
景旺电子	51.16%	44.07%	40.25%	47.94%
依顿电子	40.99%	31.61%	27.43%	24.59%
骏亚科技	65.63%	63.54%	59.95%	55.89%
世运电路	32.74%	31.20%	25.65%	44.15%
博敏电子	61.03%	57.35%	52.84%	42.74%
威尔高	53.15%	47.23%	39.15%	26.68%
行业均值	51.09%	49.17%	47.96%	46.06%
满坤科技	41.73%	38.49%	36.41%	25.08%

资料来源：Wind 资讯

从偿债能力指标看，报告期内与同行业公司相比，公司流动比率、速动比例均高于同行业平均水平，公司资产负债率低于行业平均水平，公司偿债能力指标处于合理水平，偿债能力较强。

（五）截至最近一期末公司财务性投资情况

1、财务性投资的认定

根据中国证监会 2023 年 2 月发布的《证券期货法律适用意见第 18 号》，对于财务性投资的要求如下：

“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（六）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

（七）发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。”

2、发行人自本次发行董事会决议日前六个月起至今不存在实施或拟实施财务性投资的业务情形

自本次发行董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资业务的情形，具体说明如下：

(1) 投资类金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在投资类金融业务的情形。

(2) 非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在从事非金融企业投资金融业务活动的情形。

(3) 与公司主营业务无关的股权投资

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在与公司主营业务无关的股权投资活动的情形。

(4) 投资产业基金、并购基金

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在投资产业基金、并购基金的情形。

(5) 拆借资金、委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在对外拆借资金、委托贷款的情形。

(6) 购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司存在使用闲置资金购买短期银行理财的情形，主要是为了提高临时闲置资金的使用效率，以现金管理为目的，所购买的理财产品主要为安全性高、流动性好的低风险的理财产品，具有持有期限短、收益稳定、风险低的特点，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资范畴。

(7) 拟实施的财务性投资的具体情况

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在拟实施财务性投资的相关安排。

综上，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资的业务情形。

3、最近一期末财务性投资情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司可能涉及财务性投资的主要会计科目情况如下：

单位：万元

科目	账面价值	是否为财务性投资
交易性金融资产	24,090.38	否
其他应收款	141.19	否
其他流动资产	7,754.32	否
预付款项	137.28	否
其他非流动资产	2,601.34	否
其他权益工具投资	2,000.00	否
合计	36,724.51	/

1) 交易性金融资产

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人交易性金融资产账面价值为 24,090.38 万元。公司交易性金融资产为充分利用闲置资金，提高资金使用效率购入的短期保本型理财产品，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	产品收益类型	产品风险等级	期限	收益率	投资金额
1	平安证券股份有限公司安享 113 号浮动收益凭证	保本浮动收益	R2（中低风险）	95 天	2.01%固定收益率+浮动收益率	5,000.00
2	平安证券股份有限公司安享 111 号浮动收益凭证	保本浮动收益	R2（中低风险）	95 天	2.01%固定收益率+浮动收益率	2,000.00
3	平安证券股份有限公司安享 134 号浮动收益凭证	保本浮动收益	R2（中低风险）	96 天	1.8%固定收益率+浮动收益率	2,000.00
4	平安证券股份有限公司安享 111 号浮动收益凭证	保本浮动收益	R2（中低风险）	95 天	2.01%固定收益率+浮动收益率	1,500.00

序号	项目	产品收益类型	产品风险等级	期限	收益率	投资金额
5	平安证券股份有限公司安享 113 号浮动收益凭证	保本浮动收益	R2（中低风险）	95 天	2.01%固定收益率+浮动收益率	1,000.00
6	平安证券股份有限公司安享 117 号浮动收益凭证	保本浮动收益	R2（中低风险）	95 天	1.9%固定收益率+浮动收益率	1,000.00
7	平安证券股份有限公司安享 96 号浮动收益凭证	保本浮动收益	R2（中低风险）	95 天	2.01%固定收益率+浮动收益率	1,000.00
8	平安证券股份有限公司安享 106 号浮动收益凭证	保本浮动收益	R2（中低风险）	95 天	2.01%固定收益率+浮动收益率	1,000.00
9	平安证券股份有限公司安享 109 号浮动收益凭证	保本浮动收益	R2（中低风险）	95 天	2.01%固定收益率+浮动收益率	1,000.00
10	平安证券股份有限公司安享 96 号浮动收益凭证	保本浮动收益	R2（中低风险）	95 天	2.01%固定收益率+浮动收益率	1,000.00
11	平安证券股份有限公司安享 106 号浮动收益凭证	保本浮动收益	R2（中低风险）	95 天	2.01%固定收益率+浮动收益率	1,000.00
12	平安证券股份有限公司安享 109 号浮动收益凭证	保本浮动收益	R2（中低风险）	95 天	2.01%固定收益率+浮动收益率	1,000.00
13	平安证券股份有限公司安享 117 号浮动收益凭证	保本浮动收益	R2（中低风险）	95 天	1.9%固定收益率+浮动收益率	1,000.00
14	坤睿 26006 号	保本保最低收益	低风险	89 天	浮动收益率	500.00
15	君跃飞龙壹仟(看涨鲨鱼鳍)26014	保本保最低收益	低风险	90 天	1%固定收益率+浮动收益率	500.00
16	坤睿 26006 号	保本保最低收益	低风险	89 天	浮动收益率	500.00
17	君跃飞龙壹仟(看涨鲨鱼鳍)26014	保本保最低收益	低风险	90 天	1%固定收益率+浮动收益率	500.00

序号	项目	产品收益类型	产品风险等级	期限	收益率	投资金额
18	“银河金鑫”收益凭证 923 期-二元自动看涨赎回（上海金）	保本保最低收益	R1（低风险）	357 天	0.1%或 4.0%	500.00
19	“银河金鑫”收益凭证 924 期-二元自动看涨赎回（上海金）	保本保最低收益	R1（低风险）	357 天	0.1%或 4.0%	500.00
20	“银河金鑫”收益凭证 932 期-二元自动看涨赎回（上海金）	保本保最低收益	R1（低风险）	364 天	0.1%或 4.0%	500.00
21	“银河金鑫”收益凭证 934 期-二元自动看涨赎回（上海金）	保本保最低收益	R1（低风险）	364 天	0.1%或 4.0%	500.00
22	“银河金鑫”收益凭证 935 期-二元自动看涨赎回（上海金）	保本保最低收益	R1（低风险）	364 天	0.1%或 4.0%	27.00
23	“银河金鑫”收益凭证 946 期-二元自动看涨赎回（上海金）	保本保最低收益	R1（低风险）	364 天	0.1%或 4.0%	500.00
24	理财产品公允价值变动等	/	/	/	/	63.38
合计						24,090.38

发行人购买的保本型理财产品目的为在充分满足流动性的前提下进行现金管理，所购产品属于安全性高、流动性好、低风险、期限较短的保本型理财产品，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品，因此不属于财务性投资。

2）其他应收款

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人其他应收款账面价值为 141.19 万元，主要包括押金及保证金等，不属于财务性投资。

3）其他流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人其他流动资产金额为 7,754.32 万元，主要为增值税留抵税额，不属于财务性投资。

4）预付款项

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人预付款项为 137.28 万元，主要为预付的货

款、能源费用等，不属于财务性投资。

5) 其他非流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的其他非流动资产主要为预付的设备款及工程款，均与公司目前的工程建设相关，不属于财务性投资。

6) 其他权益工具投资

截至 2026 年 6 月 30 日，发行其他权益工具投资金额为 2,000 万元，为公司基于产业协同的目的，于 2026 年 5 月向杭州福斯特电子材料有限公司增资 2,000 万元。杭州福斯特电子材料有限公司专注于感光干膜、挠性覆铜板（FCCL）及感光覆盖膜等电子化学材料的研发与生产，其产品广泛应用于印制电路板（PCB）和柔性印制电路板（FPC）的关键制程中，是产业链中不可或缺的上游配套环节。通过对该公司的战略性投资，公司能够有效强化关键原材料的稳定供应，同时在工艺对接、质量管控及联合研发等方面深化供应链协同效应，进一步增强上下游联动的抗风险能力与响应效率。该项投资紧密围绕公司既定的战略发展方向，旨在依托产业链纵向延伸，获取核心技术资源、优化原料采购渠道并强化产业生态布局，属于基于产业协同需求的战略投资，非以短期财务回报为目标的财务性投资。

综上所述，截至 2026 年 6 月 30 日，公司持有财务性投资合计金额为 0 元，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

七、经营成果分析

（一）营业收入

报告期内，公司营业收入情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	83,372.44	88.47	147,051.51	89.28	114,932.21	90.66	112,902.89	92.77

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他业务收入	10,865.92	11.53	17,663.95	10.72	11,840.99	9.34	8,796.50	7.23
合计	94,238.36	100.00	164,715.46	100.00	126,773.20	100.00	121,699.39	100.00

公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，报告期内主营业务收入占营业收入比重均值为 90.30%，主营业务突出。公司近年来营业收入整体上呈增长趋势，2025 年公司营业收入同比增长 29.93%，主要系公司下游客户订单不断增加，公司前次募投项目部分产线建成后投入使用，公司产能产量增加所致，具备合理性。其他业务收入主要为废料收入等，占营业收入比重较小。报告期内，公司所处的 PCB 行业快速发展，公司与主要客户均保持长期稳定合作关系，公司营业收入规模快速增长。

报告期内，发行人主营业务收入的的具体情况如下：

1、按产品类别分析

单位：万元、%

产品类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
单双面板	29,296.15	35.14	53,637.17	36.48	44,646.56	38.85	48,324.80	42.80
四层板	33,283.10	39.92	58,299.98	39.65	53,481.52	46.53	48,163.88	42.66
六层及以上	17,757.27	21.30	27,289.57	18.56	16,804.14	14.62	16,414.21	14.54
HDI 板	3,035.93	3.64	7,824.79	5.32	-	-	-	-
合计	83,372.44	100.00	147,051.51	100.00	114,932.21	100.00	112,902.89	100.00

报告期内，公司主营业务收入分别为 112,902.89 万元、114,932.21 万元、147,051.51 万元和 83,372.44 万元，主营业务收入保持增长趋势。整体上，公司单双面板的销售占比有所下降，四层板、六层板及以上以及 HDI 板的 PCB 板销售比例有所提高，2025 年，随着公司 IPO 募投项目的建设，公司产品类型中新增 HDI 产品。公司产品结构变化主要与下游客户的产品需求密切相关。

2、按应用领域分析

单位：万元、%

应用领域	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
------	--------------	---------	---------	---------

	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
通讯设备	7,427.51	8.91	13,553.77	9.22	12,148.95	10.57	9,834.39	8.71
消费电子	28,567.93	34.27	57,038.63	38.79	36,986.23	32.18	45,623.84	40.41
汽车电子	25,627.03	30.74	44,713.69	30.41	43,503.42	37.85	34,602.18	30.65
工业控制	21,724.93	26.06	31,565.88	21.47	21,218.75	18.46	21,591.70	19.12
其他	25.04	0.03	179.53	0.12	1,074.86	0.94	1,250.78	1.11
合计	83,372.44	100.00	147,051.51	100.00	114,932.21	100.00	112,902.89	100.00

3、按区域分布分析

单位：万元、%

区域	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华南地区	37,111.68	44.51	67,742.47	46.07	52,315.39	45.52	45,300.08	40.12
华东地区	16,403.06	19.67	34,788.08	23.66	26,674.17	23.21	31,987.47	28.33
西南地区	7,675.26	9.21	9,592.44	6.52	7,825.37	6.81	7,394.72	6.55
华中地区	2,508.42	3.01	2,211.68	1.50	4,043.93	3.52	3,860.74	3.42
境内其他	1,974.10	2.37	2,926.41	1.99	1,769.49	1.54	1,637.56	1.45
境内小计	65,672.52	78.77	117,261.08	79.74	92,628.35	80.59	90,180.57	79.87
境外地区	17,699.92	21.23	29,790.43	20.26	22,303.86	19.41	22,722.32	20.13
合计	83,372.44	100.00	147,051.51	100.00	114,932.21	100.00	112,902.89	100.00

公司的客户主要分布在电子信息产业较为发达的区域。境内部分，公司以华南、华东地区为主要销售区域。境外部分，公司主要销售区域分布于中国台湾、东南亚等地区。

4、按存货管理模式分析

单位：万元、%

存货管理模式	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
VMI	19,797.78	23.75	36,002.06	24.48	28,812.20	25.07	35,282.44	31.25
非 VMI	63,574.66	76.25	111,049.45	75.52	86,120.01	74.93	77,620.45	68.75
合计	83,372.44	100.00	147,051.51	100.00	114,932.21	100.00	112,902.89	100.00

报告期内，公司 VMI 模式下主营业务收入金额分别为 35,282.44 万元、28,812.20 万元、36,002.06 万元和 19,797.78 万元，VMI 模式销售占比分别为 31.25%、25.07%、24.48%和 23.75%，占比逐年下降主要原因系公司下游 VMI

模式客户的订单需求变动所致。

（二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本的构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	78,534.97	100.00	134,946.97	99.94	102,930.22	99.79	97,654.51	99.86
其他业务成本	-	-	84.19	0.06	216.16	0.21	134.95	0.14
合计	78,534.97	100.00	135,031.16	100.00	103,146.37	100.00	97,789.46	100.00

报告期内，公司的营业成本分别为 97,789.46 万元、103,146.37 万元、135,031.16 万元和 78,534.97 万元，主营业务成本占营业成本的比重分别为 99.86%、99.79%、99.94%和 100.00%。

报告期内，公司主营业务成本的具体情况如下：

1、按产品类别构成分析

单位：万元、%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
单双面板	28,472.57	36.25	53,273.99	39.48	44,110.47	42.85	46,139.89	47.25
四层板	30,072.02	38.29	50,766.25	37.62	45,272.41	43.98	38,895.66	39.83
六层及以上	16,367.85	20.84	23,142.57	17.15	13,547.33	13.16	12,618.96	12.92
HDI 板	3,622.54	4.61	7,764.17	5.75	-	-	-	-
合计	78,534.97	100.00	134,946.97	100.00	102,930.22	100.00	97,654.51	100.00

报告期内，公司的主营业务成本按产品类别构成主要分为单双面板、四层板、六层及以上和 HDI 板，其中单双面板主营业务成本占比逐步下降，四层板、六层板及以上以及 HDI 产品占比逐步上升。

2、按成本性质构成分析

单位：万元、%

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
----	--------------	---------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	56,553.74	72.01	93,395.74	69.21	70,931.41	68.91	65,542.19	67.12
直接人工	8,615.66	10.97	16,298.65	12.08	13,344.30	12.97	12,081.58	12.37
制造费用	13,365.57	17.02	25,252.58	18.71	18,654.50	18.12	20,030.75	20.51
合计	78,534.97	100.00	134,946.97	100.00	102,930.22	100.00	97,654.51	100.00

报告期内，公司的主营业务成本包括直接材料、直接人工和制造费用，以直接材料为主。公司直接材料主要由覆铜板、半固化片、铜球、铜箔、金盐品等产品构成，报告期内直接材料占比分别为 67.12%、68.91%、69.21%和 72.01%。

（三）毛利及毛利率分析

1、毛利情况

报告期内，公司主要产品的毛利实现情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利额	占比	毛利额	占比	毛利额	占比	毛利额	占比
主营业务	4,837.47	30.81	12,104.54	40.78	12,001.99	50.80	15,248.38	63.77
单双面板	823.58	5.24	363.18	1.22	536.09	2.26	2,184.91	9.14
四层板	3,211.08	20.45	7,533.73	25.38	8,209.11	34.74	9,268.22	38.76
六层及以上	1,389.42	8.85	4,147.00	13.97	3,256.81	13.78	3,795.25	15.87
HDI 板	-586.61	-3.74	60.62	0.20	-	-	-	-
其他业务	10,865.92	69.19	17,579.76	59.22	11,624.83	49.20	8,661.55	36.23
合计	15,703.39	100.00	29,684.29	100.00	23,626.83	100.00	23,909.93	100.00

2、综合毛利率情况

报告期内，公司综合毛利率情况如下：

产品类别	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
主营业务	5.80%	8.23%	10.44%	13.51%
单双面板	2.81%	0.68%	1.20%	4.52%
四层板	9.65%	12.92%	15.35%	19.24%
六层及以上	7.82%	15.20%	19.38%	23.12%
HDI 板	-19.32%	0.77%	-	-
其他业务	100.00%	99.52%	98.17%	98.47%

综合毛利率	16.66%	18.02%	18.64%	19.65%
-------	--------	--------	--------	--------

报告期内，公司的综合毛利率为 19.65%、18.64%、18.02%和 16.66%，主营业务毛利率分别为 13.51%、10.44%、8.23%和 5.80%。公司经营模式及业务未发生重大变化。公司主营业务毛利率呈下降趋势，主要系市场竞争充分，产品销售价格下降、单位成本上升所致。2026 年上半年，公司综合毛利率出现一定程度下滑，主要受原材料价格波动、吉安三厂投产带来的固定成本抬升以及新产品产能爬坡等多重因素共同影响：①报告期内铜、金等 PCB 核心原材料市场价格出现大幅波动上行，公司主要原材料采购成本随之增加，在产品销售价格调整存在一定时间滞后的背景下，原材料成本上涨对公司盈利空间形成直接挤压；②公司吉安三厂已于 2025 年 12 月达到预定可使用状态并转入固定资产，2026 年上半年该厂区折旧摊销等固定成本持续发生，但产能尚未完全释放，单位产品分摊的固定成本有所抬升，进一步对整体毛利率形成拖累；③HDI 产品作为公司重点布局的产品方向，现阶段仍处于产能建设及产量爬坡阶段，生产良率、生产效率尚未达到成熟产线水平，规模效应暂未充分显现，该类产品尚处于亏损状态，拉低公司整体毛利率。

3、与同行业上市公司毛利率比较分析

报告期内，公司与同行业上市公司综合毛利率水平具体情况如下：

单位：%

证券简称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
胜宏科技	33.22	35.22	22.72	20.70
中富电路	19.10	15.05	14.18	12.09
科翔股份	8.83	7.04	3.84	8.05
中京电子	11.87	16.94	12.33	11.08
崇达技术	20.13	21.13	22.41	25.94
奥士康	20.05	20.86	23.15	26.51
景旺电子	20.22	21.59	22.73	23.17
依顿电子	18.45	22.18	21.46	21.73
骏亚科技	16.47	15.50	15.04	20.30
世运电路	13.56	21.14	23.09	21.32
博敏电子	15.84	14.47	7.95	9.74

威尔高	18.65	19.12	18.09	22.97
行业均值	18.03	19.19	17.25	18.63
满坤科技	16.66	18.02	18.64	19.65

数据来源：Wind 资讯

2023 年至 2024 年，公司毛利率与同行业公司的平均水平差异较小，变动趋势基本一致。2025 年及 2026 年上半年，公司毛利率低于同行业可比公司平均水平，主要系胜宏科技毛利率同比大幅增加所致。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用及其占营业收入的比例如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	1,526.70	1.62	3,367.16	2.04	2,916.08	2.30	2,946.31	2.42
管理费用	3,284.35	3.49	6,549.74	3.98	7,276.50	5.74	5,960.84	4.90
研发费用	4,679.03	4.97	6,320.79	3.84	5,380.08	4.24	5,096.63	4.19
财务费用	858.89	0.91	-525.88	-0.32	-2,293.92	-1.81	-2,950.63	-2.42
合计	10,348.97	10.98	15,711.81	9.54	13,278.74	10.47	11,053.15	9.08

报告期内，公司期间费用占营业收入的比例分别为 9.08%、10.47%、9.54% 和 10.98%，变动幅度较小。

1、销售费用分析

报告期内，公司销售费用的具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
职工薪酬	970.58	2,124.08	1,653.46	1,793.77
佣金及推广费	178.82	514.09	527.98	400.89
差旅费及业务招待费	213.04	467.18	476.36	422.16
保险费	113.70	290.93	177.75	182.83
股权激励费用	-	-73.45	54.24	106.82
其他	50.56	44.34	26.30	39.83
合计	1,526.70	3,367.16	2,916.08	2,946.31

报告期内销售费用主要为职工薪酬、佣金及推广费和差旅费及业务招待费。报告期内，公司销售费用率分别为 2.42%、2.30%、2.04%和 1.62%，报告期内公司销售费用率总体基本保持稳定，2026 年上半年略有下降主要系收入增长较快所致。

2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用的具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
职工薪酬	2,014.35	4,166.24	4,278.32	3,313.79
股权激励费用	-	-670.55	619.00	675.23
折旧及摊销	462.91	955.85	712.19	703.86
维修费	300.08	432.07	460.25	335.61
差旅费及业务招待费	103.08	216.50	275.50	287.29
办公费	56.56	163.05	274.86	125.37
中介机构及咨询服务费	260.76	1,127.27	449.04	319.81
租赁及物业费	19.65	30.23	40.55	56.55
其他	66.97	129.09	166.79	143.33
合计	3,284.35	6,549.74	7,276.50	5,960.84

报告期内，公司管理费用分别为 5,960.84 万元、7,276.50 万元、6,549.74 万元和 3,284.35 万元，占营业收入的比例分别为 4.90%、5.74%、3.98%和 3.49%，2025 年比例下降主要系公司股权激励费用同比下降所致。

3、研发费用分析

报告期内，公司研发费用的具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
职工薪酬	2,325.27	2,538.54	2,746.22	2,130.36
物料及低值易耗品摊销	1,923.87	2,894.57	1,601.39	1,808.67
折旧及摊销	387.04	469.26	524.94	556.15
股权激励费用	-	-110.04	173.47	64.85
其他	42.86	528.45	334.06	536.60
合计	4,679.03	6,320.79	5,380.08	5,096.63

报告期内，公司研发费用分别为 5,096.63 万元、5,380.08 万元、6,320.79 万元和 4,679.03 万元，占营业收入的比例分别为 4.19%、4.24%、3.84%和 4.97%。2026 年上半年，公司加大了研发投入，导致研发费用率有所上升。

4、财务费用分析

报告期内，公司财务费用的具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	92.20	187.31	206.60	221.46
减：利息收入	274.92	1,441.45	2,156.50	2,751.16
汇兑损益	1,029.42	674.27	-376.39	-437.11
金融机构手续费及其他	-12.18	53.99	32.37	16.18
合计	858.89	-525.88	-2,293.92	-2,950.63

报告期内，公司财务费用分别为-2,950.63 万元、-2,293.92 万元、-525.88 万元和 858.89 万元，主要系利息支出及收入、汇兑损益，公司利息收入主要系公司利用闲置资金理财所得。2025 年，公司财务费用同比增加，主要系公司理财规模下降以及汇兑损益增加所致。2026 年上半年，受人民币升值影响，公司汇兑损失增加，叠加募集资金理财规模减少的影响，导致财务费用同比大幅上涨。

（五）利润表其他科目分析

1、税金及附加

报告期内，公司的税金及附加明细如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
城市维护建设税	141.99	199.11	206.77	173.69
教育费附加	141.98	198.76	205.00	169.70
房产税	232.63	450.09	181.17	137.40
土地使用税	32.80	65.60	65.60	65.60
其他	60.90	105.94	73.09	74.61
合计	610.30	1,019.50	731.64	621.00

2、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失主要由坏账准备构成，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
应收账款坏账损失	-136.83	-332.44	-256.25	-160.75
其他应收款坏账损失	12.68	-12.49	-11.80	-11.57
合计	-124.15	-344.94	-268.05	-172.32

报告期内，公司的信用减值损失主要系坏账损失计提产生。

3、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失分别为 341.71 万元、712.54 万元、2,106.09 万元及 473.08 万元，主要由存货跌价准备构成，2025 年存货跌价准备同比增加 1,340.73 万元，主要系公司原材料上涨叠加固定成本增加所导致公司存货成本上升所致。公司资产减值准备计提政策符合《企业会计准则》的规定，主要资产的减值准备提取充分。

4、投资收益

报告期内，公司的投资收益明细如下：

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
理财收益	167.13	165.44	31.16	106.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	403.82	-
合计	167.13	165.44	434.98	106.78

报告期内，公司投资收益分别为 106.78 万元、434.98 万元、165.44 万元和 167.13 万元。2024 年，公司处置子公司深圳满坤电子产生投资收益 403.82 万元导致当期投资收益金额同比增加较多。

5、其他收益

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
与资产相关的政府补助	366.04	594.11	315.70	289.58

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
与收益相关的政府补助	291.65	1,089.85	601.14	448.20
代扣个人所得税手续费返还	24.93	54.94	16.02	6.64
增值税加计扣除	205.92	647.39	1,069.02	125.45
其他	3.90	-	19.30	23.96
合计	892.44	2,386.30	2,021.17	893.82

6、营业外收支

报告期内，公司营业外收入分别为 8.60 万元、14.38 万元、73.05 万元和 15.18 万元。报告期内，公司营业外支出金额分别为 127.34 万元、132.32 万元、21.87 万元和 82.00 万元，主要系公司发生的非流动资产报废损失、滞纳金等。

（六）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益项目及其金额如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-126.61	-260.84	-55.47	-71.83
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	632.27	1,634.32	894.08	728.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	230.51	180.53	31.16	106.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11.20	60.82	-13.80	-19.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		-	-
小计	747.37	1,614.83	855.97	744.22
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	112.70	242.64	-907.98	62.98
少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	634.67	1,372.19	1,763.95	681.24

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 681.24 万元、1,763.95 万元、1,372.19 万元和 634.67 万元，占当期归属于母公司股东的净利润的比例分别为 6.21%、16.56%、11.48%和 14.43%，2024 年，公司归属于母公

司股东的非经常性损益净额同比增加 1,082.71 万元，主要系公司当期处置子公司深圳满坤电子产生母公司投资损失，导致当年计算非经常性损益的所得税费影响为负。

（七）2026 年 1-6 月业绩下滑情况

公司于 2026 年 8 月 26 日披露《2026 年半季度报告》（未经审计）数据，2026 年 1-6 月，公司实现营业收入 94,238.36 万元，同比增加 24.03%，实现归属于母公司所有者的净利润 4,398.12 万元，同比下降-30.46%。发行人 2026 年 1-6 月经营业绩变化情况如下：

1、发行人 2026 年 1-6 月主要经营数据情况

发行人 2026 年 1-6 月主要经营数据及其变动情况具体如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动情况	
			金额	比例
营业收入	94,238.36	75,979.04	18,259.32	24.03
营业成本	78,534.97	61,373.65	17,161.32	27.96
税金及附加	610.30	379.86	230.44	60.66
销售费用	1,526.70	1,424.03	102.67	7.21
管理费用	3,284.35	3,134.69	149.66	4.77
研发费用	4,679.03	3,112.36	1,566.67	50.34
财务费用	858.89	-715.08	1,573.97	220.11
其他收益	892.44	1,082.23	-189.79	-17.54
投资收益	167.13	80.94	86.19	106.49
公允价值变动损益	63.38	-	63.38	/
信用减值损失	-124.15	-116.90	-7.25	6.20
资产减值损失	-473.08	-774.58	301.50	-38.92
资产处置收益	-48.60	-80.79	32.19	-39.84
营业利润	5,221.24	7,514.33	-2,293.09	-30.52
利润总额	5,154.43	7,514.33	-2,359.90	-31.41
净利润	4,398.12	6,324.38	-1,926.26	-30.46
归属于母公司所有者的净利润	4,398.12	6,324.38	-1,926.26	-30.46
扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润	3,763.45	5,680.87	-1,917.42	-33.75

2、发行人 2026 年 1-6 月经营业绩变动的主要原因分析

2026 年 1-6 月，公司归母净利润较上年同期减少 1,926.26 万元，同比下降 30.46%，扣非后归母净利润减少 1,917.42 万元，同比下降 33.75%，主要原因系：

（1）毛利率同比下降，导致利润总额测算同比减少 2,411.97 万元

2026 年 1-6 月，公司实现营业收入 94,238.36 万元，较上年同期增加 18,259.32 万元，同比上升 24.03%。公司综合销售毛利率为 16.66%，同比减少 2.56 个百分点。按可比期间不变毛利率测算，公司综合毛利率下降导致公司利润总额减少 2,411.97 万元。

2026 年 1-6 月，公司综合毛利率的同比下降，主要受公司主要原材料价格上涨、吉安三厂新建产能前期固定成本较高等不利因素综合影响所致。

①主要原材料价格上涨

公司原材料成本占比较高，报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例约为 69%，直接材料的采购价格对主营业务成本存在显著影响。公司生产所需的主要原材料包括覆铜板、铜箔、铜球、半固化片和金盐等，上述原材料价格受铜、黄金、石油等大宗商品的市场价格影响较大。近年来受全球经济以及国际政治局势的影响，国际铜价、金价和石油价格出现了大幅波动，公司主要原材料采购价格同样出现明显波动。

一方面，2023 年以来，铜、黄金等大宗商品价格波动幅度较大，根据 Wind 资讯统计，2023 年至 2026 年 6 月末中国有色网铜价在 60,000 元/吨至 110,000 元/吨区间范围内波动。2023 年初至 2026 年 6 月末中国有色网铜价波动情况如下：

单位：元/吨



数据来源：Wind 资讯

报告期内，中国有色网铜价自 2023 年初开始，铜价震荡上扬，在 2026 年上半年达到 108,830.00 元/吨的价格高点。2025 年四季度至 2026 年上半年，铜价持续在 9 万元/吨至 10 万元/吨的高位震荡，波动幅度较大，导致公司原材料成本大幅上涨，进而导致公司毛利率下降。

另一方面，公司金盐采购单价逐年上涨，主要系其采购价格与黄金的价格走势相关，报告期内，黄金价格持续上涨，由 400 余元/克上升至 1,200 元/克左右，带动金盐单价上涨，公司采购金盐价格与黄金价格变动趋势一致。2023 年至 2026 年 6 月末上海黄金交易所 Au9999 收盘价波动情况如下：

单位：元/克



数据来源：Wind 资讯

近年来，受国际经济环境、地缘政治格局的影响，金价保持持续上涨的趋势，2026 年上半年，金价平均价格为 1,037.84 元/克，较 2025 年上半年的 722.13 元/克上涨了 43.72%，导致公司原材料采购价格大幅上涨，进而导致公司毛利率下降。

②公司吉安三厂新建产能固定成本较高

公司前次募集资金项目吉安三厂于 2025 年末达到预定可使用状态，剩余产线逐步投入使用，三厂所产生的固定资产折旧、工厂能耗、人工等费用增加较多，其中，吉安三厂 2026 年上半年折旧费用同比增加 590.79 万元，工厂电力消耗同比增加 319.53 万元，工人人工同比增加 638.53 万元，导致单位生产成本增加较多。

公司吉安三厂包含三条通孔线，两条 HDI 生产线，主要用于生产高多层、HDI 产品。自生产线投入使用以来，公司吉安三厂处于产线磨合、参数优化、新订单导入、员工培养等阶段，生产流程未达最优状态，产线产能利用率不足，产品良率偏低，直接推高单位生产成本，最终导致公司毛利率下降。

（2）期间费用同比增加，导致利润总额同比减少 3,392.97 万元

2026 年 1-6 月，在毛利率下滑的情况下，期间费用的同比增加进一步导致公司经营业绩的下滑。2026 年 1-6 月，公司期间费用同比增加 3,392.97 万元，主要为研发费用和财务费用的增加，具体分析如下：

①研发费用同比增加 1,566.67 万元

2026 年上半年，公司研发费用同比增加 1,566.67 万元，主要系公司加大研发投入，研发人员支出及研发领料支出均有所上涨所致。为持续拓展 PCB 产品高端应用市场，近期公司不断加大研发投入，加深了新产品技术储备：在 AI 服务器领域，公司 16 层服务器电源产品、HDI 二阶高端显卡产品、HDI30 层内层 30Z 三压二阶服务器电源产品的研发在有序推进；在汽车电子领域，公司 HDI 三阶域控产品已完成客户验证；在高端消费电子领域，公司 12 层笔记本电脑产品和 HDI 一二阶 COB 显示板已经逐步量产。此外，公司在 AI 领域不断深耕，公司通过积极参与国家 PCB 行业标准制定，如中国国际经济技术合作促进会标准化工作委员会主导的《AI 服务器用印制电路板(PCB)技术规范》的起草等，不断提升公司产品竞争力及品牌知名度。公司的研发投入逐步形成公司的新技术、新产品，并在未来期间逐步转化为批量订单，能够提升公司的行业竞争力及未来盈利能力，同时在短期形成了对公司利润的损耗，给公司业绩带来一定程度上的不利影响。

②财务费用同比增加 1,573.97 万元

2026 年上半年，公司财务费用同比增加 1,573.97 万元，主要有两方面因素所致：一方面，随着人民币不断升值、公司境外收入增长等因素的影响，公司 2026 年 1-6 月产生汇兑损失金额 1,029.42 万元，较上年同期的 80.39 万元相比，增加了 949.03 万元，增长幅度较大；另一方面，随着公司前次募投项目的建设完工，公司相应支付了工程款及增加了原材料储备，导致公司账面理财规模下降，产生的利息收入减少。2026 年 1-6 月，公司利息收入金额为 274.92 万元较上年同期 902.47 万元相比减少 627.55 万元。

综上，2026 年 1-6 月，公司经营业绩的同比下降主要受上游原材料价格上涨、固定成本增加、公司加大研发投入以及理财规模下降、美元汇率波动等因

素综合影响。

3、发行人 2026 年 1-6 月业绩变化趋势与同行业上市公司对比情况

根据同行业可比公司公布的 2026 年半年度报告，公司同行业可比公司业绩变动情况如下：

单位：万元，%

证券名称	归属于上市公司股东的净利润			扣非后归属于上市公司股东的净利润		
	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动率	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动率
胜宏科技	285,677.89	214,311.98	33.30	241,780.05	214,917.15	12.50
中富电路	3,861.86	1,678.48	130.08	3,533.36	1,314.82	168.73
科翔股份	-6,637.92	-6,203.42	-7.00	-7,527.85	-7,240.40	-3.97
中京电子	-8,984.96	1,828.57	-591.37	-9,681.27	1,010.19	-1,058.36
崇达技术	15,221.37	22,155.23	-31.30	14,782.76	21,736.75	-31.99
奥士康	8,266.21	19,584.98	-57.79	7,871.23	18,377.94	-57.17
景旺电子	60,161.69	64,955.10	-7.38	46,573.22	53,739.01	-13.33
依顿电子	10,778.15	26,065.45	-58.65	9,826.49	24,891.04	-60.52
骏亚科技	-844.13	3,813.06	-122.14	-1,218.77	2,515.64	-148.45
世运电路	8,408.30	38,413.48	-78.11	5,231.50	35,654.70	-85.33
博敏电子	-5,129.02	3,789.44	-235.35	-6,935.16	2,384.91	-390.79
威尔高	4,429.34	4,520.25	-2.01	4,259.99	4,436.76	-3.98
行业均值	/	/	-85.64	/	/	-139.39
满坤科技	4,398.12	6,324.38	-30.46	3,763.45	5,680.87	-33.75

如上表所示，2026 年 1-6 月，受外部经济环境、原材料价格变动等因素影响，截至本报告出具日，上述已披露 2026 年半年度数据的 PCB 同行业上市公司中归属于上市公司股东的净利润同比下降的公司 10 家，其中归属于上市公司股东的净利润同比下降 30%以上的公司为 7 家；上述上市公司中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降的公司 10 家。

综上，公司 2026 年 1-6 月经营业绩同比下滑，与同行业主要上市公司经营业绩变动趋势一致。

公司不存在《注册管理办法》第十条、第十四条中不得向不特定对象发行可转换公司债券的情形，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件，公司 2026 年上半

年业绩下滑不构成本次向不特定对象发行可转换公司债券的实质性障碍。

4、导致发行人 2026 年 1-6 月业绩下滑的因素是否将持续

导致公司 2026 年半年度业绩下滑的因素已部分消除或减弱，具体分析如下：

（1）公司毛利率下滑非长期趋势

针对铜、金等金属原材料价格的上涨，公司已积极与下游客户进行协商，传导原材料价格上涨带来的压力。截至目前，公司已陆续与下游大部分主要客户完成了价格上涨的协商，根据公司统计，公司客户结构中 85%以上已实现调价政策的落实，预计未来公司产品毛利率将得到有效改善。

针对现阶段吉安三厂固定成本较高的情况，一方面，随着吉安三厂产能的逐步释放，将有效分摊固定成本，降低产品单位成本；另一方面，公司将通过精益化管理，进一步提升设备自动化率、产品良率，加强成本管控。此外，公司还将通过持续改善客户及产品结构、规模化效应等方式，不断提升公司产品毛利率。

（2）期间费用增加非长期趋势

随着公司不断加大研发支出，虽然短期内造成了公司费用的上涨，但未来，该等支出将有利于打造公司核心技术壁垒、优化公司产品结构，改善公司高端产品的毛利空间，形成公司产品竞争力的护城河。

同时，受汇率波动的影响，公司财务费用同比增加。公司已积极采取多种措施降低汇率波动带来的风险，包括收款时择机结汇或付款时选择外币支付、与银行沟通远期锁汇、期权产品以及与境外客户协商商品价格时考虑汇率影响等。

综上所述，公司 2026 年上半年业绩下滑的因素并非长期趋势，预计未来将得到有效改善。

八、现金流量分析

报告期内，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	4,712.98	4,977.69	10,962.40	11,585.92
投资活动产生的现金流量净额	-14,630.09	-32,412.35	-9,118.34	-23,523.94
筹资活动产生的现金流量净额	838.47	-3,577.85	-5,017.25	-3,427.21
现金及现金等价物净增加额	-9,687.97	-31,513.10	-2,752.13	-14,926.23

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	80,058.26	130,996.29	104,027.05	91,527.31
收到的税款返还	0.94	1,179.64	-	5.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,067.25	11,277.99	3,159.77	2,172.55
经营活动现金流入小计	82,126.45	143,453.93	107,186.82	93,704.96
购买商品、接受劳务支付的现金	58,960.05	101,254.25	66,277.39	55,424.49
支付给职工以及为职工支付的现金	13,659.58	27,370.30	23,819.73	20,078.58
支付的各项税费	2,286.56	4,550.91	1,382.79	2,190.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,507.28	5,300.78	4,744.51	4,425.00
经营活动现金流出小计	77,413.47	138,476.23	96,224.42	82,119.05
经营活动产生的现金流量净额	4,712.98	4,977.69	10,962.40	11,585.92

报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金流量为经营活动现金流入主要来源，经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金报告期内。2023 年-2024 年公司经营活动产生的现金流量净额基本保持稳定且保持在较高的水平，公司经营活动获取现金的能力较强；2025 年，公司经营活动产生的现金流量净额减少，主要系公司因新增三厂产能需要补充存货，相应支付给供应商的承兑汇票到期支付导致支付的现金流出较多。

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润之间的关系如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
----	--------------	---------	---------	---------

项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
净利润	4,398.12	11,947.81	10,649.80	10,978.15
加：资产减值准备	473.08	2,106.09	712.54	341.70
信用减值损失	124.15	344.94	268.05	172.32
固定资产折旧	5,546.57	9,898.42	6,084.35	5,795.21
使用权资产折旧	160.74	132.76	225.66	349.24
无形资产摊销	22.83	48.02	111.11	117.74
长期待摊费用摊销	102.40	277.42	288.39	257.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	48.60	241.75	354.32	-31.29
固定资产报废损失	78.01	19.09	104.97	103.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-63.38	-15.08	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,121.63	861.58	-169.79	-215.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-167.13	-165.44	-434.98	-106.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-82.94	-789.91	-188.87	254.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	117.23	-35.00	-143.57	-62.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,000.91	-11,480.83	-5,515.96	2,402.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,072.42	-27,735.11	-21,434.50	-15,412.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,906.39	20,212.92	19,204.17	5,795.94
其他	-	-891.71	846.71	846.89
经营活动产生的现金流量净额	4,712.98	4,977.69	10,962.40	11,585.92
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额	-314.86	6,970.12	-312.60	-607.77

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要系固定资产、使用权资产等折旧、存货金额变动及经营性应收和应付项目的变动所致。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司各期投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
收回投资收到的现金	57,125.00	236,622.90	26,919.50	33,500.00
取得投资收益收到的现金	230.11	165.44	31.16	106.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39.70	166.54	147.77	188.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	546.61	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	57,394.81	236,954.88	27,645.04	33,795.48

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,424.90	12,144.44	9,843.88	26,819.42
投资支付的现金	62,600.00	257,222.80	26,919.50	30,500.00
投资活动现金流出小计	72,024.90	269,367.24	36,763.38	57,319.42
投资活动产生的现金流量净额	-14,630.09	-32,412.35	-9,118.34	-23,523.94

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负，主要是由于公司持续购建固定资产、购买理财产品支出，相应投资活动产生的现金净流出较大。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	-	-	889.60	-
取得借款收到的现金	5,000.00	11,500.00	6,500.00	8,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	5,000.00	11,500.00	7,389.60	8,500.00
偿还债务支付的现金	4,000.00	8,510.00	5,990.00	6,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86.88	6,378.51	6,160.71	5,026.30
支付其他与筹资活动有关的现金	74.65	189.34	256.14	400.92
筹资活动现金流出小计	4,161.53	15,077.85	12,406.85	11,927.21
筹资活动产生的现金流量净额	838.47	-3,577.85	-5,017.25	-3,427.21

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要由首次公开发行股票收到募集资金、公司股东投入、银行借款以及公司分配现金股利构成。2023 年至 2025 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要系公司分配现金股利所致。

九、资本性支出分析

（一）最近三年资本性支出情况

报告期内，公司的资本性支出主要围绕主营业务展开，主要用于购入固定资产等。公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为

26,819.42 万元、9,843.88 万元、12,144.44 万元和 9,424.90 万元。公司的资本性支出有利于扩大公司产能规模，提高公司的综合竞争力，提升公司的盈利能力。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司已公布或未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目和前次募集资金投资项目的相关支出，具体内容参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”和“第八节 历次募集资金运用”之内容，均系公司围绕主营业务进行的扩建和新建项目，可以扩大公司的产能规模，优化公司的产能布局，提升公司的智能化与数字化建设水平，提高公司服务客户的综合能力。公司拟通过公司自有资金、本次发行可转债及银行授信等多种资金来源进行项目建设。

十、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

公司是国家级高新技术企业，凭借强大的研发团队，经过多年的自主研发和实践积累，在产品制作流程设计、生产流程管理、工艺技术改进、新产品研发等方面积累了丰富的经验。公司能够对客户需求进行快速、优质的响应，提供针对性的配方调整和定制化的解决方案，并为客户提供具有高可靠性、长寿命、高品质等富有竞争力的产品。公司拥有PCB产品制造领域较为完整的技术体系和自主知识产权，符合GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证标准，并于2022年10月经国家知识产权局确定为国家知识产权优势企业。

截至报告期末，公司及其控股子公司共取得了186项专利，其中发明专利41项，实用新型专利143项，外观设计专利2项。公司自主研发的“耐高温高压树脂油墨印制电路板”“320IR环保型影像显示印制光电路板”“C55-33452B高频控制传感器印制电路板”“097EQ智能车载印制电路板”“319XQ汽车变速箱控制系统HSP工艺印制电路板”“047IE平面式UPS变压器印制电路板”等6款产品被江西省工业和信息化厅认定为达到同类产品“国际先进”水平，另有十余款产品被认定达到同类产品“国内领先”水平或“国内先进”水平。报告期内，公司“319XQ汽车变速箱控制系统HSP工艺印制电路板”“097EQ智能车载

印制电路板”等荣获江西省优秀新产品一等奖，“047IE平面式UPS变压器印制电路板”荣获江西省优秀新产品二等奖，“409EQ车载高清摄像头双面夹芯铝基电路板”“610LED光电显示用BGA封装载板”等荣获江西省优秀新产品三等奖。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

截至本募集说明书签署之日，发行人正在进行的重点研发项目情况请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、与产品有关的技术情况”内容。

（三）保持持续技术创新的机制和安排

1、研发体系

公司设有研发处，作为公司统一负责关键技术研发和新产品开发的核心部门。公司研发处致力于成为 PCB 前沿技术及其应用的研究平台，引进了研发人才，购置了先进试验设备，重点围绕“高多层、高密度、刚挠结合、高频高速”等行业发展趋势，提升公司的技术水平、产品规划和生产制造能力，全面提升公司的行业竞争力，推动企业持续发展。

2、合作研发

公司始终注重与行业内外各个单位的合作交流，包括积极与同行业单位沟通，认真听取行业外合作伙伴的反馈建议，同时鼓励公司研发人员开展多样化、深层次的技术交流，维持公司在行业内的技术先进性。

3、研发支出

公司以市场、客户需求和最新产品前沿应用为导向制定产品研究和开发计划，一直保持着高位的研发投入。报告期内，公司的研发费用分别为 5,096.63 万元、5,380.08 万元、6,320.79 万元和 4,679.03 万元，研发投入维持在较高强度。通过持续进行研发创新和工艺创新，公司积累了多项核心技术，在优化生产流程、丰富产品种类、提升产品良率、降低单位产品成本等方面发挥了突出作用，

较好地满足了下游行业客户对 PCB 产品的差异化需求，为公司的长足发展夯实了技术基础。

4、激励机制

人才是发展的第一动力，公司始终注重对人才的培养与激励。对于在技术领域取得突破、获得先进技术成果、促进公司无形资产转化等方面有贡献的技术人员，公司已建立完整的激励机制对其奖励，以提高技术人员的积极性，取得更多成果，形成良性循环。

十一、重大对外担保、诉讼或仲裁、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响

（一）重大担保

截至本募集说明书签署之日，公司及其子公司无对合并范围外的担保。

（二）重大诉讼或仲裁

截至本募集说明书签署之日，发行人及其控股子公司不存在对发行人生产经营产生重大影响的诉讼案件。

（三）其他或有事项和重大期后事项

截至本募集说明书签署之日，发行人及其控股子公司不存在其他或有事项和重大期后事项。

十二、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划情况

本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目为泰国高端印制电路板生产基地项目、智能化与数字化升级改造项目。本次发行完成后，公司业务未发生变化。募集资金到位后，公司总资产规模将显著提升，并且随着募投项目建设的逐渐推进，公司整体资产及业务规模均将随之提升。

（二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化情况

本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目是建立在公司现有业务基础上的产能扩充，有助于进一步提升公司业务规模、优化公司产能结构以及提升公司的人才吸引力等，有利于公司保持并进一步提升公司核心竞争力，不存在新旧产业融合情况的变化。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况

本次发行完成后，上市公司控股股东、实际控制人不会发生变化，公司控制权结构不会发生变化。

第六节 合规经营与独立性

一、合规经营

（一）与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况

发行人及其子公司报告期内存在以下行政处罚情况：

被处罚人	处罚机关	违法行为	处罚文号	处罚内容	处罚时间
深圳满坤电子	深圳市宝安区应急管理局	未对安全设备进行定期检测	（深宝）应急罚[2023] 513 号	罚款 4 万元	2023.08.25

根据《安全生产法》及上述行政处罚决定书，发行人前子公司深圳满坤电子的前述违法行为不具有情节严重情形，未造成安全事故，并已及时改正并缴纳了罚款，该违法行为不会对发行人的生产经营造成重大不利影响，上述行政处罚不会对发行人本次发行构成实质性障碍。

综上，报告期内公司及子公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行为，不存在因生产经营方面重大违法违规行为而受到行政处罚的情形，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

（二）公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证券监管部门和交易所行政处罚、公开批评或公开谴责的情况

报告期内，公司及公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚、公开批评或证券交易所公开谴责的情形。

（三）公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证券监管部门和交易所采取监管措施、涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况

报告期内，公司及公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。公司及公司的董事、

监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情形。

二、关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

三、同业竞争情况

（一）发行人与控股股东、实际控制人控制的或者担任董事、高级管理人员的其他企业同业竞争情况

截至本募集说明书签署之日，公司主营业务为印刷电路板的研发、生产和销售。公司的控股股东、实际控制人为洪氏家族，其基本情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人基本情况”。报告期内，公司控股股东、实际控制人控制或投资的其他企业主营业务情况如下：

序号	公司名称	关联关系	主营业务
1	香港满坤电子有限公司	洪娜珊持股 100%	除持有满坤电子（惠州）有限公司 100% 股权外，报告期没有开展其他业务
2	启明科技有限公司	洪娜珊持股 100%	对外投资，已于报告期内注销
3	恒盈资本有限公司	洪娜珊持股 30% 洪俊城持股 25% 洪耿东持股 45%	对外投资
4	深圳零和投资有限公司	洪丽旋持股 55% 洪丽冰持股 45%	投资兴办实业；创业投资业务，已于报告期内注销
5	满坤电子（惠州）有限公司	香港满坤电子有限公司持股 100%	自有房屋租赁

公司控股股东、实际控制人控制其他公司主要从事对外投资、自有房屋租赁等业务，均未从事与发行人相同或类似业务，与发行人的主营业务不存在同业竞争关系。

（二）避免同业竞争的措施

为避免与发行人及其子公司存在同业竞争，发行人控股股东、实际控制人洪氏家族于发行人首次公开发行股份并上市前出具了避免同业竞争的承诺，具体内容请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、重要承诺及履行情况”。自上市以来，公司控股股东、实际控制人严格遵守作出的相关承诺，未发生新增同业竞争情况，不存在违反避免同业竞争承诺的情况。

（三）本次发行对公司同业竞争的影响

公司控股股东、实际控制人不会因本次发行发生变动，公司控股股东、实际控制人不会因本次发行与公司产生同业竞争。

四、关联方和关联交易情况

（一）关联方情况

根据《公司法》《证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市规则》等文件的有关规定，经查阅发行人提供的关联企业工商登记资料、发行人组织结构、股权控制结构、董事会和股东大会/股东会决议等资料，发行人的关联方如下：

1、控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员

截至本募集说明书出具之日，洪氏家族合计持有公司 67.62%的股份，是公司的控股股东、实际控制人。

发行人控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员均为公司的关联方。

2、控股股东和实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或兼任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业

发行人控股股东、实际控制人控制或兼任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他组织情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人”。

发行人控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员控制或兼任董事、高级管理人员的其他企业如下：

序号	公司名称	控制关系/任职情况
1	香港满坤电子有限公司	洪娜珊持股 100%
2	满坤电子（惠州）有限公司	香港满坤电子有限公司持股 100%
3	恒盈资本有限公司	洪娜珊持股 30%，洪俊城持股 25%，洪氏夫妇之子洪耿东持股 45%
4	恒盈资产管理有限公司	洪氏夫妇之子洪耿东持股 100%
5	香港恒盈控股有限公司	洪氏夫妇之子洪耿东持股 100%
6	深圳市恒盈富达资产管理有限公司	洪氏夫妇之子洪耿东持股 100%
7	社屋（深圳）信息咨询有限公司	洪耿奇配偶持股 100%
8	深圳市南山区有感服饰店	洪耿奇配偶持股 100%
9	东莞市久制电子有限公司	洪耿宇配偶父母控制的公司
10	深圳市宝安区西乡程靖商行	洪耿宇配偶父亲持股 100%
11	深圳市瓴知控股有限公司	洪氏夫妇之子洪耿东持股 100%
12	深圳市瓴知智能科技有限公司	洪氏夫妇之子洪耿东控制的公司
13	深圳市瓴知启明科技有限合伙企业（有限合伙）	洪氏夫妇之子洪耿东持股 99%
14	深圳市瓴知智创科技有限合伙企业（有限合伙）	洪氏夫妇之子洪耿东持股 99%
15	东南鑫曜资产管理有限公司	洪氏夫妇之子洪耿东持股 100%

上述公司属于公司的关联方。

3、其他持有公司 5%以上股份的股东

截至本募集说明书出具之日，除公司控股股东、实际控制人之外，不存在其他直接持有公司 5%以上股份的股东。

4、公司控股子公司、孙公司及联营企业

截至本募集说明书出具之日，发行人拥有四家控股子公司股权，具体情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（三）对其他企业的重要权益投资情况”。

5、发行人董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

发行人的董事、高级管理人员具体情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、董事、高级管理人员及其他核心人员”。上述董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员均为公司的关联方。

6、发行人董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或兼任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业

除公司控股股东、实际控制人以外，公司其他董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或兼任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业均为公司的关联方。

7、其他关联方

其他关联方包括：（1）除公司控股股东、实际控制人以外，公司其他董事、高级管理人员关系密切的家庭成员控制或兼任董事（独立董事除外）、高级管理人员的企业；（2）报告期内因注销或公司关联方终止任职而与公司解除关联关系的企业；（3）公司报告期内注销的子公司。

截至本募集说明书出具日，发行人其他关联方情况如下：

序号	关联方名称	原与发行人关联关系	备注
1	广州恒盈股权投资有限公司	洪氏夫妇之子洪耿东持股 100%	2026 年 1 月注销

8、报告期内曾经的关联方

报告期内，公司曾经的主要关联方如下：

序号	关联方名称	原关联关系
1	VENUS TECHNOLOGY LTD	原为实际控制人洪娜珊控制的企业，已解散
2	深圳市满坤电子有限公司	原为发行人的全资子公司，发行人于 2024 年 4 月 30 日对外转让全部股权
3	深圳零和投资有限公司	实际控制人洪丽旋、洪丽冰控制的企业，已于 2024 年 6 月 20 日注销
4	深圳市盈信发电子有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员洪乐英控制的企业，已于 2023 年 8 月 8 日注销
5	深圳市久只电子有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员程家伟及其配偶控制的企业，已于 2023 年 5 月 24 日注销

（二）关联交易情况

1、重大关联交易的判断标准及依据

公司判断是否构成重大关联交易参照《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，将公司与关联自然人、关联法人发生的交易（提供担保除外）金额累计超过人民币 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，或为关联人提供担保等应当提交股东会审议的关联交易界定为重大关联交易，不符合重大关联交易认定标准的为一般关联交易。

报告期内，公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，并签订相关交易协议。报告期内公司关联交易情况如下：

2、一般经常性关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况

报告期内发行人不存在向关联方采购商品、接受劳务的情况。

（2）出售商品/提供劳务情况

报告期内发行人不存在向关联方出售商品、提供劳务的情况。

（3）关键管理人员薪酬

报告期内，公司关键管理人员包括公司董事、监事、高级管理人员，其薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	231.20	463.26	502.40	636.54

注：2026 年上半年及 2025 年度关键管理人员薪酬为公司董事、高级管理人员薪酬，不含监事薪酬。

（4）关联租赁情况

报告期内，公司不存在关联租赁的情况。

3、一般偶发性关联交易

（1）关联担保

报告期内，公司不存在关联担保。

（2）关联方资金拆借

报告期内，公司不存在关联方资金拆借。

4、关联方往来款项余额

报告期各期末，公司不存在关联方往来款项余额。

（三）报告期内关联交易必要性、公允性以及对公司财务状况、经营成果影响情况

报告期内，公司的经常性关联交易主要为向关键管理人员支付的薪酬，金额较小，占公司营业收入比例较低，对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

（四）履行的程序及独立董事对关联交易的意见

发行人报告期内的关联交易均已按照审批权限报董事会、股东会批准，需关联董事、关联股东回避表决的事项，该等关联董事或关联股东均回避表决；关联交易需经独立董事发表意见的，独立董事均已发表意见。发行人报告期内关联交易按照《公司章程》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》等公司治理文件的要求审批、公允定价、完整披露，不存在损害发行人股东利益的情形。

（五）规范关联交易的措施

公司已就规范关联交易采取了以下措施：

1、公司在《公司章程》中严格规定了关联交易的表决程序和回避制度；公司还制定了《关联交易管理制度》等一系列制度对《公司章程》中有关关联交易的规定进行量化细化，强化了相关制度的可操作性，进一步规范了关联交易行为；

2、公司聘任了 3 名独立董事，超过董事会人数的 1/3，并通过《公司章程》中的有关规定，增强独立董事在关联交易决策中的监督作用；

3、公司控股股东、实际控制人于发行人首次公开发行股份并上市前作出《关于减少和规范关联交易的承诺》，具体情况请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、重要承诺及履行情况”。

在本次发行中，为保障公司及广大投资者的权益，公司部分现任董事及高级管理人员均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，具体承诺请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、重要承诺及履行情况”之内容。截至本募集说明书签署之日，上述承诺主体不存在违反承诺的情况。

第七节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 76,000.00 万元（含 76,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	泰国高端印制电路板生产基地项目	50,175.07	47,000.00
2	智能化与数字化升级改造项目	30,455.00	29,000.00
合计		80,630.07	76,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）泰国高端印制电路板生产基地项目

1、项目概况

为优化公司产能布局，匹配新能源汽车、AI 服务器、机器人、高速通信等领域客户的本地化产能诉求，公司拟于泰国巴真武里府 304 工业园区投资建设年产 110 万平方米高端印制电路板生产基地。本项目将紧密围绕公司主营业务展开，项目的建设系公司顺应行业发展趋势、强化公司国际竞争力、降低国际贸易风险的战略之举，可以进一步拓展境外市场份额、提升公司整体抗风险能力。

2、项目必要性

（1）优化公司产能布局，满足海外客户日益增长的订单需求

根据 Prismark 预测，2025-2030 年全球 PCB 产业产值预计年复合增长率为 7.7%，2030 年全球 PCB 产业产值将达 1,233.48 亿美元。公司现有产能集中于江西吉安三个专业化工厂，形成了聚焦国内市场的产能基础；但从全球化运营视角看，公司海外产能仍处于空白状态，未能有效匹配 PCB 产业需求持续增长的趋势及境外客户的合作诉求。在智能汽车、AI 服务器、机器人、高速通信、新能源等下游领域的需求驱动下全球 PCB 市场稳步扩容，境外客户对本地化生产、缩短交付周期及供应链稳定性等需求日益突出。在此背景下，公司亟需启动海外生产基地建设，快速响应境外客户的订单需求，提升客户合作黏性。

（2）顺应行业发展趋势布局海外产能，强化公司国际竞争力

从行业发展趋势看，国际电子电路产业转移持续深化，泰国等东南亚国家凭借政策引导与成本红利在电子制造、新能源汽车、工业控制等领域快速崛起，已成为国际新兴制造枢纽之一，为 PCB 企业海外布局提供核心区位支撑。从客户需求端看，公司部分核心客户已在东南亚及全球范围内布局生产基地，以匹配自身的全球供应链网络，其对 PCB 供应商的本地化产能配套需求显著提升，亟需公司通过海外产能布局及时响应供货需求，进一步强化客户合作黏性、稳固现有合作份额。从同行业公司看，PCB 行业内胜宏科技、鹏鼎控股、深南电路、沪电股份等企业均已先后落子东南亚，形成“海外产能卡位”态势。公司布局泰国生产基地既能依托泰国的产业发展契机，挖掘海外市场业绩新增量，又能通过全球化产能布局优化自身产能结构，与国内产能形成协同互补，进而提升公司在全球市场的竞争力。

（3）降低国际贸易变动风险，提升公司整体的抗风险能力

随着国际贸易的销售额增长，公司对境外市场的重视程度日益提高。当前宏观经济波动加剧、国际贸易格局不确定性上升，海外客户对供应链地缘风险分散的战略重视度显著提高，普遍通过优化供应链节点、分散产能布局等方式，

对冲物流时效波动与单一产能中断风险，以强化供应链稳定性与安全性。鉴于公司当前产能全部集中于国内，在响应海外客户风险分散需求、抵御外部环境冲击方面存在一定的局限性。公司在泰国投资新建生产基地，既能精准匹配海外客户供应链布局需求、进一步巩固客户合作黏性，又能增强应对宏观经济波动、产业政策调整及国际贸易格局变化的战略灵活性，通过生产基地的全球化分散布局优化供应链韧性，进而显著提升公司整体抗风险能力。

基于泰国项目的上述便利条件和优势，公司管理层经过充分调研与审慎研究，认为本次募集资金投资项目的实施将进一步优化产能布局、提升境外市场份额、增强公司市场竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目的实施具备必要性。

3、项目可行性

（1）友好的产业政策及完善的供应链体系为本项目实施提供良好的外部环境

泰国地处东南亚中南半岛地理中心，既是陆上丝绸之路经济带的关键节点，亦是海上丝绸之路的核心通道。2017年9月中泰签署《关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》，为两国产业协同构建战略框架，对深化中国与东盟经贸关系具有重要支撑作用。近年来，随着泰国成为全球PCB产业转移的核心承接区域之一，中泰双方将进一步强化产业政策协同，2025年2月中泰两国发布联合声明，明确双方将增进供应链互联互通，特别是在半导体、电池、电动汽车、高端电子等产业促进企业交流合作，支持双方参加对方举办的各类贸易展会。同时泰国投资促进委员会（BOI）针对高端制造领域推出专项税收鼓励政策，包括给予符合条件的企业最长8年企业所得税全额豁免，同时对用于出口导向型生产的机械设备、核心原材料实施进口关税阶段性减免。上述政策可直接降低企业初始投资成本与运营成本，优化项目现金流结构，为公司泰国高端PCB生产基地建设与盈利释放提供关键政策支撑。

同时，泰国作为快速发展的新兴市场经济体，其印制电路板相关产业链配套近年来不断得到完善，具备土地、环保、人力、税收等方面的比较优势，为

制造业发展提供了坚实基础，可以较好满足公司建设海外生产基地的需要。以公司项目所在地泰国巴真武里府 304 工业园区为例，该园区位于多个汽配、电子产业集群的中心地带，地理位置优越，公共设施齐备，已成为中国及全球制造业企业布局东南亚市场的重要节点之一。

（2）优质的客户资源为项目产能消化奠定良好的基础

随着全球电子制造、新能源汽车、通信设备、工业控制等产业持续向区域化供应链布局深化，东南亚地区凭借产业转移承接能力、成本优势及政策支持，已成为上述领域全球供应链中的新兴核心活跃市场。公司下游核心客户覆盖汽车电子、工业控制、通信电子等关键赛道，包括台达电子（电源管理与工业控制）、光宝集团（消费电子与汽车电子）、MARELLI（马瑞利，汽车电子核心部件）、立达信（智能照明与物联网）、和硕电子（EMS 厂商）、麦格米特（电源电控）、HANSOL（韩松集团，工控及消费电子）、SOLUM（智能终端显示）、Sagemcom（萨基姆，通信设备）、捷温电子（汽车热管理）在内的众多客户均已在东南亚及全球主要市场完成生产基地与供应链节点布局，对本地化 PCB 供应商的需求显著提升。近年来公司与部分客户在高端 PCB 产品领域的合作逐步深化，优质的客户资源能够为泰国生产基地投产后的产能消化提供稳定的订单支撑，有效降低产能爬坡风险，保障项目未来的投资回报。

（3）丰富的生产管理经验及深厚的技术积淀为项目建设提供重要保障

公司深耕 PCB 产业近二十年，积累了丰富的 PCB 生产管理经验。2023 年至 2025 年，公司营业收入规模不断攀升，由 12.17 亿元稳步增长至 16.47 亿元。公司秉承“品质第一、服务优良、持续改进、追求卓越”的品质方针，通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001、QC080000、UL、CQC、ISO13485、ISO27001、ISO14064 和 ISO14067 等涉及产品质量、安全、环境的体系认证，在销售、采购、生产各环节建立了完善的品质管理体系，严格把控产品品质，保证产品质量的高标准。同时，公司是国家级高新技术企业，凭借强大的研发团队，经过多年的自主研发和实践积累，在产品研发设计、生产流程管控、工艺技术改进、新产品开发导入等方面积累了丰富的经验。截至 2026

年 6 月 30 日，公司及其控股子公司共取得了 186 项专利，其中发明专利 41 项，实用新型专利 143 项，外观设计专利 2 项。从公司经营管理能力及技术积累来看，公司在泰国建设项目具有可行性。

4、建设内容、投资构成及测算依据

本项目预计总投资为 50,175.07 万元，拟使用募集资金投入金额 47,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元、%

序号	项目	项目资金	占比	募集资金投入金额
一	建设投资	47,236.22	94.14	47,000.00
1.1	工程费用	47,236.22	94.14	47,000.00
1.1.1	建筑工程费	10,422.20	20.77	
1.1.2	设备购置费	36,814.02	73.37	
二	土地购置费	2,925.52	5.83	-
三	工程建设其他费用	13.33	0.03	-
四	项目总投资	50,175.07	100.00	47,000.00

本次发行董事会决议前，该项目土地购置费已完成投入，工程建设其它费用中已部分投入。该项目拟使用募集资金投入金额为 47,000.00 万元，募集资金计划用于建设投资中的建筑工程及设备购置费用，本次募集资金均用于董事会决议日后的项目资本性支出，不存在使用募集资金投入非资本性支出项目的情形。

该项目的投资构成、测算依据和测算过程如下：

（1）建筑工程费

本项目建筑内容包括生产厂房、装修和机电工程、消防工程、污水处理站以及配套设施等，工程建筑金额根据预计项目建设工程量及项目地工程造价水平确定。根据公司进行的前期实地调研情况，本次建筑工程单价 1,271.67 元/m²，装修费用 800.00 元/m²；根据公司设计的产能规模及相关建筑和生产设施占地面积估算，预计本次建筑面积约 32,400.00 m²；除此之外，本项目建设内容还包括机电工程、消防工程等配套设施。本次建筑工程费合计约为 10,422.20 万元。

(2) 设备购置费

本项目所需生产设备主要采购自中国国内，本项目设备测算主要参考公司历史设备采购价格、国内外设备市场最新价格动态以及拟购买设备厂商的近期沟通报价测算。本项目所需设备投入估算金额 36,814.02 万元。

(3) 土地购置费

公司已于 2024 年 9 月 23 日与泰国巴真武里府 304 工业园区 7 号项目有限公司签订《土地购买协议》用于该项目的建设，根据该协议土地性质为合法工业用地。目前本项目土地购置相关款项已支付，公司已获得目标土地的地契证书。

(4) 工程建设其他费用

根据项目规划，工程建设其他费用主要包括在本项目实施过程中产生的场地准备费及临时设施费、施工图审查费等费用，主要依据公司历史建设项目的费用情况进行估算，并结合本项目实际情况确定，预计为 13.33 万元。

5、项目实施主体

本项目由公司在泰国设立的控股子公司泰国泰坤负责实施。

6、项目预计实施时间及整体进度安排

本项目预计建设期为 36 个月，项目于计算期第 6 年（含建设期）达到满产状态，项目整体进度安排如下：

序号	项目	T1（年）				T2（年）				T3（年）			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	购买及清理场地												
2	工程及设备招标												
3	基础建设及装修工程												
4	设备采购及安装调试												
5	人员招聘及培训												
6	试生产												
7	验收竣工												

7、项目效益预测的假设条件及主要计算过程

本项目包括建设期在内的效益测算期为 13 年，其中建设期 3 年。本项目运营期可实现年均营业收入 86,480.00 万元，年均净利润 3,868.50 万元，预期经济效益良好。该项目的效益预测的假设条件和计算过程具体如下：

（1）销售收入预测

1) 销售价格

根据项目规划，本项目的主要产品以四层板、六层及以上、HDI 板为主，预计销售价格分别为 600 元/m²、1,000 元/m²、800 元/m²，该价格以本项目《可行性研究报告》出具时点公司产品平均销售价格为主要参考依据。

2) 产品产量预测

根据本项目《可行性研究报告》，本项目在达产后产能将逐步释放，在第二年至第六年项目产能利用率分别为 20%、40%、60%、80%及 100%，满产状态下将形成年产 110 万平方米 PCB 板的新增产能。

3) 产品销售收入

根据本项目《可行性研究报告》，基于以上产品类型和价格，本项目达产后运营期将实现年均销售收入为 86,480.00 万元。

（2）成本预测

本项目主要成本费用估算依据如下：

1) 直接材料

本项目效益测算中，主要产品四层板、六层及以上、HDI 板预计单位材料成本占收入的比例以本项目《可行性研究报告》出具时点公司产品平均单位材料成本占收入的比例作为参考依据进行测算。本项目运营期平均每年材料成本 50,128.32 万元。

2) 直接人工

本项目主要人员包括生产人员、销售人员、技术人员及管理人员，项目合计定员人数 569 人，人员工资水平以公司目前的人员平均薪酬为基础，同时按照 5%年度涨幅（CPI 因素）进行计算。中国外派生产人员公司按照公司生产人员平均工资的 1.5 倍（外派人员工资涨幅）计算，本项目人员薪酬计算依据合理。

3）折旧及摊销

本项目的折旧摊销按公司现行财务制度规定的折旧年限及残值率进行计提：

序号	资产类别	本项目折旧摊销政策		
		估计使用年限	净残值率	年折旧摊销率
1	房屋及建筑物	20	5.00%	4.75%
2	机器设备	10	5.00%	9.50%
3	软件	5	0.00%	20%

根据本项目的可行性研究报告，预计本项目达产期年均折旧摊销额 3,167.82 万元。

4）水电费、燃料费

本项目水电费、燃料的单位价格系根据当地调研的实际情况确定，按 110 万平方米 PCB 板的产能计算，每年水、电、燃料费用合计约 6,256.00 万元。

5）其他制造费用

本项目其他制造费用参考公司历史年份其他制造费用占生产成本的比例均值计算，本项目取值 3.40%。

（3）销售费用、管理费用、研发费用预测

本项目销售费用、管理费用、研发费用主要参考公司历史年份相关费用率平均水平计算。

（4）所得税费用预测

本项目所得税按照泰国当地税率 20%测算。

（5）募投项目效益测算合理性分析

根据上述测算，在产销平衡状态下，本项目运营期将实现年均营业收入 86,480.00 万元，年均净利润 3,868.50 万元，销售毛利率为 18.58%，税后内部收益率为 16.17%，具体指标如下：

序号	指标名称	指标值	备注
1	销售收入（万元）	86,480.00	运营期
2	销售毛利率（%）	18.58	运营期
3	净利润（万元）	3,868.50	运营期
4	税后内部收益率（%）	16.17	/
5	税后投资回收期（年）	7.28	含建设期，静态

（6）公司及同行业效益指标比较情况

本项目与公司 2023 年-2025 年销售毛利率对比情况如下：

毛利率	2025 年度	2024 年度	2023 年度	均值
主营业务毛利率	8.22%	10.44%	13.51%	10.72%
境外销售综合毛利率	23.73%	28.44%	28.79%	26.99%
综合毛利率	18.02%	18.64%	19.65%	18.77%
本次募投项目	18.58%			

如上表所示，本次募投项目一预测毛利率高于公司主营业务毛利率，主要系公司本次募投项目一设计产能为四层、六层及以上以及 HDI 等中高端 PCB 产品，主要聚焦汽车电子、服务器及配套设施、工业控制、高速通信等领域，并主要面向境外客户。根据规划，本次募投项目一达产后六层板及以上板/HDI 的合计产能占比将达到 67.27%，远超 2025 年公司相应产品比例 22.22%，因此预计其主营业务毛利率将高于公司现有产品主营业务毛利率。

本次募投项目一预测毛利率是谨慎、合理的，主要系：①本次募投项目一销售测算时未考虑销售废料所产生的收益，作为境外独立的整体项目，预计未来将会产生一定的废料收益。在未考虑废料收益的情形下，本次募投项目一销售毛利率仍低于公司报告期内综合毛利率均值，具备谨慎性；②本次募投项目一建设于泰国巴真武里府，主要面向境外客户进行销售，与公司 2023-2025 年境外销售综合毛利率均值 26.99%相比，本次募投项目一预测毛利率相对较低。

本项目预测毛利率低于报告期内公司综合毛利率，项目的效益预测较为谨慎合理。根据同行业公司公告数据整理，同行业公司自 2020 年以来 PCB 募投项目的效益指标情况如下：

证券简称	项目名称	毛利率	内部收益率	静态回收期 (含建设期, 年)
胜宏科技	高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目	27.50%	19.49%	6.27
	越南胜宏人工智能 HDI 项目	25.03%	15.18%	7.69
	泰国高多层印制线路板项目	18.24%	14.30%	7.28
世运电路	鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（二期）	23.92%	未披露	未披露
博敏电子	高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目	21.17%	16.18%	6.51
	高端印制电路板生产技术改造项目	19.34%	12.92%	6.45
	博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）	22.81%	14.83%	8.17
骏亚科技	年产 80 万平方米智能互联高精密线路板项目	20.48%	18.13%	7.37
中富电路	年产 100 万平方米印制线路板项目	21.83%	15.55%	7.52
科翔股份	江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）	25.16%	15.28%	6.39
	江西科翔 MiniLED 用 PCB 产线建设项目	31.06%	20.36%	5.37
威尔高	年产 300 万 m ² 高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目——年产 120 万平方米印制电路板项目	未披露	15.06%	6.73
	泰国威尔高年产 60 万 m ² 线路板	未披露	13.92%	7.25
景旺电子	景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产 120 万平方米多层印刷电路板项目	27.91%	12.76%	7.88
	景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产 60 万平方米高密度互连印刷电路板项目	25.85%	13.70%	8.99
崇达技术	珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期）	28.26%	12.41%	7.82
	珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）	27.02%	10.07%	8.07

证券简称	项目名称	毛利率	内部收益率	静态回收期 (含建设期, 年)
奥士康	高端印制电路板项目	24.77%	11.72%	8.36
平均值		24.40%	14.82%	7.30
满坤科技	泰国高端印制电路板生产基地项目	18.58%	16.17%	7.28

与同行业公司近年来的募投项目效益数据相比，本项目效益测算较为谨慎、合理。

8、公司既有业务发展概况及扩大业务规模的必要性、新增产能规模的合理性

(1) 公司既有业务发展概况及扩大业务规模的必要性

报告期内，公司产能利用率分别为 84.05%、90.95%、87.18%和 76.77%，考虑到产线排期及订单准备切换、设备例行检修等因素以及报告期内公司新建三厂的产能爬坡因素，公司整体的产能利用率处于较高水平。报告期内，公司产销率分别为 100.48%、98.57%、96.15%和 104.40%，公司产品销售状况良好。由于受到场地及产能限制，现有产能无法满足市场需求。

目前公司新客户的开发工作顺利，公司在汽车电子、消费电子、工业控制、通信设备等领域储备客户资源丰富。随着未来泰国生产基地的建成投产，公司可以形成向国际市场快速供货的生产基地网络，提升客户服务体验，增强公司的抗风险能力。公司在东南亚投资建设新的生产基地，可以在一定程度上规避由于潜在贸易摩擦带来的额外税费成本，以更加灵活的产能规划和销售网络布局应对世界经济形势变化带来的潜在风险，符合公司长期战略部署和股东利益。公司本次扩大业务规模具备必要性。

(2) 新增产能规模的合理性

1) 下游应用领域需求持续增长，为产能消化奠定良好的市场基础

电子信息产业正处于高速发展阶段，随着科技进步和数字化转型的加速推进，电子信息产业已成为全球经济的核心驱动力之一。得益于市场需求增长，

新能源、物联网、大数据、人工智能等新兴技术的广泛应用为电子信息产业提供了广阔的市场空间和发展机遇。根据 Prismark 预测，2025 年至 2030 年全球 PCB 产业产值预计年复合增长率为 7.7%，2030 年全球 PCB 产业产值将达 1,233.48 亿美元，市场空间广阔。

2) 优质的客户资源为项目建设提供了有力支撑

公司高度重视产品市场需求，谋求与客户建立长期伙伴关系，共同推动产业链良性发展。经过在 PCB 行业多年的积累沉淀，凭借高质量产品和服务，公司与不同细分领域的多家知名企业保持长期稳定的合作关系，包括台达电子、光宝科技、和硕电子、麦格米特、捷温电子、伟世通、MARELLI、HANSOL、SOLUM、Sagemcom 等工业控制、汽车电子、消费电子领域的众多国内外知名企业。目前公司产品已出口到欧洲、亚洲、美洲等国家和地区。公司客户储备数量丰富，客户主要为全球知名企业，且新行业、新客户的开发能力较强，预计能够有效消化新增产能。

3) 项目产能释放具有渐进性，产能闲置的风险较小

公司前次募投项目部分产能已建成达产，目前处于产能爬坡状态。根据前次募投项目的可行性研究报告，项目第二年至第四年分别实现达产率 30%、70%、100%；公司本次募投项目计划建设期为 36 个月，根据本项目可行性研究报告，本项目第二年至第六年分别实现达产率 20%、40%、60%、80%、100%。公司前次募投项目和本次募投项目将稳步实施、分期达产，建设产能将呈渐进式释放，公司产能消化存在一定周期，因产能释放过快导致产能闲置的风险较小。

综上所述，PCB 行业下游应用领域广泛，具有足够的市场空间消化公司本次募投项目新增产能，公司拥有丰富的客户资源储备和在手订单，可以顺利保障募投项目的实施和新增产能的消化，本次新增产能规模具备合理性。

9、本次募集资金投资项目涉及的立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进程、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性

2024 年 9 月 24 日，公司已取得江西省商务厅下发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3600202400069 号）。

2024 年 10 月 9 日，公司已取得江西省发展和改革委员会下发的关于项目一期投资的《境外投资项目备案通知书》（赣发改外资[2024]744 号）。

2024 年 9 月 27 日，公司就 ODI 中方股东对外出资业务完成外汇登记手续，并取得《业务登记凭证》。

本项目选址于泰国巴真武里府 304 工业园区，目前公司已取得上述土地的地契证书。该工业园区已履行工业园区环评和规划手续，该项目无需履行环评手续。

10、泰国泰坤（子公司）的 BOI 税收优惠政策的确 定性及年限

公司泰国子公司泰国泰坤已正式获得泰国投资促进委员会（BOI）核发的投资促进证书，所享核心优惠政策依据泰国《投资促进法》依法授予，具备法律效力与国际公信力，为项目长期稳定运营筑牢政策根基。具体来看，优惠政策覆盖三大核心维度：一是税收优惠层面，可享受长达 8 年的企业所得税豁免，大幅降低项目盈利初期税负压力，同时机器设备进口环节免征关税、出口产品相关原材料进口关税全额减免，有效降低生产要素采购成本与海外市场拓展成本；二是政策稳定性层面，泰国政治及法律体系成熟稳定，针对高科技制造业的外资扶持导向明确且持续，历史上相关优惠政策调整频率低、调整幅度可控，BOI 批准的优惠待遇在有效期内具有刚性执行保障，为公司海外产能规划、成本测算及盈利预测提供了清晰的可预期性；三是营商便利层面，泰国政府为吸引外商投资构建了完善的便利化体系，在企业设立注册、工业用地供给、外汇结算自由、环保审批流程等关键环节均提供简化服务，显著提升项目落地及运营效率，契合 PCB 行业全球化布局中对供应链稳定性、成本可控性的核心诉求。

11、泰国项目的订单拓展与产能覆盖情况

依托发行人现有客户结构、在手订单储备、下游领域转移趋势，公司本次募投项目之泰国生产基地达产后产能消化与订单覆盖方面分析如下：

(1) 依托存量深耕境外头部客户转单需求，实现投产初期基础产能稳妥消化

截至 2026 年 6 月末，发行人现有在手订单为 2.95 亿元，订单结构中绝大多数为长期稳定合作的战略合作伙伴，从客户分布来看，境外客户的订单占比为 14.73%，其中台达电子、光宝、马瑞利、捷温电子、伟世通、HANSOL、SOLUM、SAGEMCOM 等核心境外合作主体合作周期均已超过五年，产品认证、供应链准入、订单试样等前期流程已落地，公司在手订单的主要境外客户情况如下：

单位：万元

序号	境外客户名称	合作年限	客户简介	在手订单金额
1	Interface Microsystems	5 年以上	全球知名汽车电子零部件供应商，专注于汽车照明控制系统及相关电子组件研发与制造，是国际主流汽车品牌的一级供应商，产品覆盖车身控制、安全系统、车载连接、LED 照明、充电器等多种汽车电子部件	554.61
2	捷普电子	5 年以上	全球知名电子制造服务（EMS）企业，纽交所上市公司（JBL.N），专注于综合设计、智能制造与供应链管理全链条服务，构建智能基础设施、汽车/医疗、互联生活三大业务板块	448.50
3	台达电子	5 年以上	全球电源管理解决方案的世界级厂商，在交换式电源供应器及散热解决方案维持领导地位，涵盖电源及零组件产品、自动化产品、基础设施产品等三大业务，中国台湾上市公司（2308.TW）	422.25
4	群创光电	5 年以上	全球领先的显示解决方案提供商，形成“显示+半导体封装”双主业格局，中国台湾上市公司（3481.TW）	299.50
5	康舒科技	5 年以上	总部位于中国台湾的全球领先电源管理解决方案供应商，成立于 1981 年，主营消费电子、云端服务器、通信、工业及医疗用电源供应器，并积极拓展绿能与电动动力系统	279.34

近期公司持续对存量境外合作客户、东南亚区域潜在客户开展专项需求摸排与实地商务接洽，现阶段台达电子、MARELLI（马瑞利）、新金宝、飞旭、

维谛（Vertiv）、萨基姆（SAGEMCOM）、伟世通等一批已建立长期稳定合作的全球知名电子制造厂商，受全球供应链本地化布局、国际贸易关税政策、区域产业配套落地等多重因素驱动，普遍存在 PCB 产品境外本地化生产采购的明确诉求。上述客户相继在泰国、越南等东南亚地区落地生产基地，基于供应链安全管控、缩短物料交期、降低跨境物流及关税成本的经营考量，逐步推动原有中国区域外发 PCB 订单向东南亚配套厂商转移，为本次募投项目投产爬坡期产能利用率保持高位提供确定性订单支撑。报告期内前述客户与公司合作黏性较强、产品认证完备，已就车载板、工控电源板、消费电子板等产品出具本地化供货意向，具备后续订单向公司泰国新建产线批量切换的落地基础，是发行人泰国项目投产初期产能消化的核心订单来源。

2025 年公司境外客户实现的营业务收入占比将近 20%，且公司主要销售区域分布于中国台湾、东南亚等地区。目前公司整体上在手订单较为充足，且大部分客户为长期持续合作的战略客户，其生产基地布局遍布全球，采购与销售环节均推行全球化战略，在采购选择上优先采用与各生产基地就近匹配的模式，未来公司泰国项目的建成达产将进一步提升公司的供应链响应效率、控制物流成本。

另外，国内存量海康威视、德赛西威等头部内资客户在境外布局工厂，发行人依托多年配套合作关系承接其海外子公司 PCB 需求，形成内资龙头出海配套增量订单，夯实泰国工厂投产初期产能基本盘。

（2）海内外产能差异化分工协同调配订单，依托国内富余订单外迁持续释放中期产能

根据产能布局规划，发行人国内江西吉安厂区将聚焦国内核心客户，覆盖消费电子、汽车电子、通信电子、AI 服务器等领域，泰国工厂重点面向境外地区汽车电子、服务器及配套设施、工业控制、高速通信等领域现有客户和储备客户，二者产品规格、目标市场形成合理错位互补。从目前订单结构来看，2026 年公司车载智能座舱、笔记本电脑、显卡、光模块、存储产品等订单类型持续放量，国内厂区产能将根据客户下单情况逐步趋向满产，原有部分低毛利、

长交期的外销常规板订单具备外迁泰国条件；随着国内新接高端高多层板产能安排，预计 2027-2029 年每年可向泰国转移国内富余外销订单对应年产值超过 1.50 亿元，可覆盖泰国项目达产后约 20%产能。

同时，借助泰国关税、地缘区位优势规避贸易壁垒，将原受关税影响流失的欧美中小客户订单重新揽收，依托海内外产能动态调配机制平滑产能爬坡节奏，实现中期产能有序消化，该统筹调配模式与中富电路海内外产能分域运营、订单动态分流的产能消化方案保持一致。

（3）立足东南亚产业链转移红利持续开发潜在客户，形成未来产能消化来源

近年来，在下游电子行业产业转移的带动下，东南亚地区（主要是泰国、越南、马来西亚）基于税收、政策、物流、人工等优势，承接了来自全球的大量 PCB 产业转移，因此东南亚地区 PCB 产值保持较高增速，为发行人泰国工厂远期拓客提供行业基本面支撑。

发行人已针对东南亚市场组建本地化销售与技术服务团队，就近跟进泰国本土汽车零部件、通信工厂新项目定点，与潜在客户进行了富有成效的接触，包括 Cisco、Intel、Sanmina 集团（新美亚）、Fabrinet、SVI（欧洲 EMS 厂商）、GPV（欧洲 EMS 厂商）、Oracle 等。目前部分客户订单进入验证阶段，待泰国工厂建成达产后进行批量化能力确认；依托泰国基地就近交付、降关税、缩短物流周期的本地化优势，持续开发日韩、中东欧新进电子制造厂商，该部分订单预计可覆盖本次募投项目部分产能。叠加 AI 算力、光模块、汽车电子海外供应链扩容带来的高速 PCB 增量需求，公司预计潜在客户的增量订单可有效消化项目剩余产能。

综上所述，发行人本次泰国募投项目产能消化具备充足的客户、订单及行业支撑，整体具备可行性与合理性。短期内，公司境外长期合作核心客户存在明确本地化转单需求，叠加国内头部客户出海配套增量订单，可有效保障项目投产爬坡期产能落地；中期，公司国内外产能错位布局、差异化运营，通过外销富余订单有序外迁、依托区位关税优势拓展海外订单，可稳步消化泰国项目

产能；长期来看，依托东南亚电子产业转移及 PCB 市场增长红利，公司本地化团队持续开拓新增客户与增量订单，可足额实现产能消化。本项目具备良好的市场前景与可持续性。

（二）智能化与数字化升级改造项目

1、项目概况

本项目由母公司满坤科技作为实施主体，总投资额为 30,455.00 万元，实施地点位于江西省吉安市，项目规划建设期 36 个月。公司通过本项目拟引进高自动化、高精度的智能化生产设备及数字化管理系统，以全面提升生产运营效率与产品精度管控水平，搭建数字化信息系统、强化信息安全建设，为公司 PCB 产品规模化量产提供关键智能制造支撑，助力公司扩大市场份额、强化核心竞争力。

2、项目必要性

（1）项目建设利于公司构建精益制造体系，驱动产品提质升级

当前全球科技产业正经历以人工智能为代表的新一轮技术变革，算力基建、智能终端、新能源汽车等战略赛道加速演进，推动电子信息产业结构深度重塑，催生对 PCB 产品更高技术标准、更强可靠性及更高集成度的需求升级。作为电子元器件的核心载体，PCB 行业正处于市场需求与技术复杂度双升级的关键阶段，下游客户对供应商的产能承接能力与交付稳定性提出更高要求。近年来，公司重点拓展汽车电子、AI 服务器、高速通信等领域客户，伴随与客户合作的不断深化及下游应用技术的迭代更新，高端 PCB 产品需求持续攀升，但受限于现有产线设备与工艺瓶颈，公司目前的产能结构已难以匹配市场日益增长的需求，亟需通过产线升级优化产能结构，强化高端产品交付能力，把握产业变革机遇。

本项目拟对公司现有生产基地实施智能化升级改造，通过在关键工序增设智能化设备，提升关键工序精度与设备处理能力，进而升级产品结构、提升产品质量，形成更强的产能匹配力与供应稳定性，以提升客户黏性和市场份额，

为公司后续发展夯实基础。

（2）项目实施可有效提升环保安全运行水平，实现降本增效

PCB 产业链条长、应用覆盖广，同时兼具能耗物耗高、工艺复杂等特点。PCB 生产制造过程会涉及到多种化学药剂、电镀液、酸碱废水及高耗电环节，生产材料中包含铜、镍、金、银等重金属，在电镀、蚀刻等生产环节会产生废水、废气及固废等污染物，若管理不善，可能对环境保护和生产安全造成不良影响。虽然公司现有生产体系运行稳定，但随着环保法规日趋严格和客户对绿色供应链的要求逐步提升，公司需进一步加强环保和安全投入，以保证可持续经营。

本项目通过智能制造技术升级改造、先进控制系统的引入、协同管理软件的布置等手段实现生产过程实时监控，构建“生产-环保-安全”闭环管理体系，有效降低环境风险、职业健康隐患及能源资源消耗，保障生产安全高效的运行：一方面提升废水废气处理效率，满足国内日趋严格的环保要求；另一方面通过实时风险预警，降低生产环节的物料损耗及生产异常波动导致的额外能源消耗。此举将强化公司环保生产、安全生产和节能降耗的能力，通过工艺优化实现环境效益与经济效益的协同提升。

（3）搭建数字化信息系统，提升经营管理效率

随着我国宏观经济进入新常态，“建设数字中国”“发展数字经济”已上升为国家战略，《“十四五”智能制造发展规划》《制造业数字化转型行动方案》等产业政策相继出台，全力支持制造业企业数字化转型。近年来随着产品矩阵扩容、客户数量逐年增长，公司业务复杂度显著提升，对研发、生产、销售及售后服务全流程的信息处理效率及协同管理能力提出更高要求。公司三期工厂数字化建设取得一定进展，而一、二期工厂建设时间较久，尽管公司过往依托现有信息化系统保障了业务正常运转，但受业务规模扩张与人力成本上行影响，现有信息化已难以满足公司降本增效需求；且当前机房环境监控、ERP、HR 等系统虽可满足日常工作需求，但在实时监控、数据集成、智能分析、工程自动化及信息安全领域仍存提升空间，这在一定程度上制约了公司内部管理

效率提升、跨部门协同能力提高及对客户复杂需求的响应速度。

基于以上，本项目拟对公司现有信息系统实施数字化升级，完善功能覆盖并实现数字化管理全覆盖，可有效优化内部管理流程、提升研发生产协同效率与整体运营能力。

（4）强化信息安全建设，支撑业务高效稳定运转

PCB 行业具有产品品类多元、应用场景广泛、定制化占比高的行业属性，也即伴随着数据体量庞大、客户产品信息复杂、信息化系统架构多样的特点。随着公司业务规模持续扩张，业务数据不断增长，导致机房服务器负载攀升、存储需求激增，同时业务流程中产生的海量数据对数据安全防护提出更高要求，亟需专项投入强化信息安全建设与机房数据备份体系。当前公司数据中心机房使用年限较长，且在信息安全领域缺乏系统性的软硬件支撑。本项目拟通过完善数据中心机房建设，可有效承接业务扩容后的基础设施需求，为信息化系统持续迭代提供坚实保障，同时依托灾备机房建设构建安全可靠的信息安全防护体系，进一步夯实公司数字化运营底层能力，支撑业务高效稳定运转。

综上所述，本次募集资金投资项目及其规模具有合理性和必要性。

3、项目可行性

（1）国家相关产业政策为项目实施提供良好的政策环境

公司本次智能化与数字化升级改造项目的建设深度契合国家产业政策导向与行业转型需求。《产业结构调整指导目录（2024 年本）》明确将“新型电子元器件制造”列为“鼓励类”范畴；《“十四五”智能制造发展规划》指出，制造业企业立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革；《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出推进生产过程数字化监控及管理，加速业务系统互联互通和工业数据集成共享，实现生产管控一体化。该规划明确，到 2025 年信息化和工业化在更广范

围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，制造业数字化转型步伐明显加快。

公司作为国内 PCB 行业的骨干企业，连续 11 年跻身中国电子电路行业百强，在高精密 PCB 领域积累了深厚技术储备，产品广泛服务于汽车电子、消费电子、通信电子、工控安防等核心应用场景。当前下游市场对高精密、高可靠性 PCB 产品的需求持续增长，同时数字经济发展也对企业生产效率、产品结构提出更高要求，现有生产线与数字化管理体系已无法完全满足发展需求。在此背景下，启动生产线智能化改造与信息系统数字化升级建设，既是对国家产业政策的主动践行，也是企业突破发展瓶颈、提升行业地位的关键举措，对提升产品品质、强化安全防护、实现可持续发展具有重要意义。

（2）成熟的研发体系为本次项目建设提供充分的技术储备和支持

公司是国家级高新技术企业，拥有市级工程技术研究中心和省级企业技术中心等研发平台。公司始终将技术创新作为驱动发展的核心战略，通过持续的研发投入与前瞻性布局，构建了覆盖 PCB 全流程的核心技术体系。公司形成了“市场需求导向-技术研发-成果转化”的全链条创新机制，在高精密度线路加工、材料复合应用等中高端 PCB 关键流程环节积累了深厚的技术储备。公司研发团队以行业资深专家为核心，聚焦全球电子信息产业升级趋势，紧密围绕新能源汽车、AI 服务器、高端消费、高速通信、机器人等前沿领域开展前瞻性技术布局。公司不断吸收行业前沿理念，确保技术路线与国际先进水平同步。持续的研发投入使公司能够在高多层板、车载产品领域保持技术领先，并开发适配现代生产系统的信息化工具，如 MES、ERP、AI 工程平台等，为本次项目建设提供充分的技术储备和创新能力，确保升级后的生产设备与信息系统能够高效运行。

（3）公司具备智能化与数字化升级改造建设的软硬件基础

随着我国智能装备制造业转型升级提速，叠加 PCB 行业产能快速扩张催生的生产设备需求增长，近年印制电路板专用设备制造业进入高速发展阶段。PCB 生产全流程中开料、压合、钻孔、线路、蚀刻、阻焊、测试、包装等关键

环节设备的自动化、智能化水平持续升级，配套软硬件系统及设备技术同步实现显著突破，为本次生产线技术升级项目提供成熟可行的解决方案。此外，近年公司三期工厂通过持续优化生产工序、布局智能化装备，已初步形成从原材料到成品的全流程自动化控制能力，且建成多条高端产品生产线，为本项目实施提供了丰富的项目建设经验。完善的生产设施与成熟的管理体系，不仅可保障项目投产后的生产效率与产品质量，更能为后续产品结构拓展、良率提升夯实基础。

4、建设内容、投资构成及测算依据

本项目预计总投资为 30,455.00 万元，拟使用募集资金投入金额 29,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比	募集资金投入金额
一	智能化产线升级改造	21,880.10	71.84%	29,000.00
1.1	设备购置费用	19,891.00	65.31%	
1.2	设备安装费	1,989.10	6.53%	
二	数字化信息系统建设	7,248.90	23.81%	
2.1	软硬件购置费用	6,040.75	19.84%	
2.2	设备安装、软件实施费用	1,208.15	3.97%	
三	其他配套费用	1,326.00	4.35%	-
建设投资总计		30,455.00	100.00%	29,000.00

该项目拟使用募集资金投入金额为 29,000.00 万元，募集资金计划用于项目所属的设备购置及其安装实施费用，本次募集资金均用于董事会决议日后的项目资本性支出，不存在使用募集资金投入非资本性支出项目的情形。

该项目的投资构成、测算依据和测算过程如下：

（1）智能化生产设备购置费

本项目智能化产线升级改造部分的设备价格主要参考公司历史设备采购价格、国内外设备市场最新价格动态以及拟购买设备厂商的近期沟通报价测算。本项目所需设备投入估算金额 19,891.00 万元。

(2) 设备安装费

根据《全国统一安装工程预算定额》等国家标准及行业通常惯例，本项目设备安装费按照设备购置费的 10%计取，主要用于钻孔、电镀、压合、检测等多环节智能化设备与工序的精准衔接、安装调试，设备安装费金额为 1,989.10 万元。

(3) 数字化软件系统升级改造费用

数字化软件系统升级改造费用主要包括公司升级现有信息系统所需购置的设备费用，主要依据公司历史设备采购价格，并结合本项目实际情况确定，预计为 6,040.75 万元。

(4) 信息系统设备安装、软件实施费用

本项目数字化信息系统建设部分的设备安装、软件实施费按照数字化软件系统升级改造费用的 20%计取，具体包括业务流程梳理与优化、系统个性化定制开发、历史数据迁移、数据清洗、与现有硬件设备及其他信息系统的接口打通、多层次用户培训以及上线后的持续技术支持与维护等服务内容，实施费用预计为 1,208.15 万元。

5、项目实施主体

本项目由满坤科技（母公司）负责实施。

6、项目预计实施时间及整体进度安排

本项目预计建设期为 36 个月，项目整体进度安排如下：

序号	项目	T1（年）				T2（年）				T3（年）			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备及方案论证												
2	硬件及软件采购、安装												
3	人员招募及培训												
4	设备安装调试												

5	验收竣工												
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7、项目效益预测的假设条件及主要计算过程

本项目为智能化产线升级改造及数字化信息系统建设项目，不涉及产能增加，不单独产生直接经济效益。项目实施后，公司将稳步提升运营管理效率、信息化水平，在保证产品质量的同时实现产能结构升级，有利于公司构建精益制造体系，实现降本增效目标。

8、本次募集资金投资项目涉及的立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性

截至本募集说明书出具日，公司已取得《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》（文号：JG2510-360800-07-02-170195）；

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的规定，本项目不涉及新增产能与基础设施建设，无需履行环评审批手续；

由于本项目在发行人现有厂区进行建设，不涉及新增土地审批程序。

三、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

（一）实施能力

公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，经历多年沉淀积累公司具备一定的核心技术优势、研发能力优势、人才优势、客户优势和行业地位优势等，实施本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面均具有扎实的基础。

1、人员储备

公司始终将人才梯队建设置于战略高度，依托先进的人才管理平台，持续优化员工培养机制，打造了一支具备高素质、高境界和高度凝聚力的经营管理与研发团队。管理团队核心成员长期扎根 PCB 行业，不仅具备深厚的专业知识和丰富的实践经验，还对市场动态具有敏锐的洞察力，为公司的高速发展与高

效运营提供了坚实支撑。技术人员多数拥有扎实的专业背景与多年的行业积累，成为公司核心技术沉淀与产品创新的关键力量，已成功开发多项核心专利技术，并持续推动产品向新的应用领域拓展。本次募投项目所需的人员配置已提前筹备完成。

2、技术储备

公司是国家级高新技术企业，凭借强大的研发团队，经过多年的自主研发和实践积累，在产品制作流程设计、生产流程管理、工艺技术改进、新产品研发等方面积累了丰富的经验。公司能够对客户需求进行快速、优质的响应，提供针对性的配方调整和定制化的解决方案，并为客户提供具有高可靠性、长寿命、高品质等富有竞争力的产品。公司拥有 PCB 产品制造领域较为完整的技术体系和自主知识产权，符合 GB/T 29490-2013 知识产权管理体系认证标准，并于 2022 年 10 月经国家知识产权局确定为国家知识产权优势企业。本次募投项目具备足够的技术储备。

3、市场储备

公司实行多行业布局的市场战略，在通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域具备丰富的行业经验。通过秉持“抓大放小”的客户销售策略，聚焦行业地位领先、市场影响力强、资质信誉和社会形象优秀的知名客户，目前已与诸多国内外知名品牌客户建立良好的合作关系，包括消费电子领域如视源股份、格力电器、洲明科技、京东方等，汽车电子领域客户如德赛西威、江苏天宝、马瑞利等，工控领域包括台达电子、海康威视、爱士惟等。目前公司产品已出口到欧洲、亚洲、美洲等国家和地区，公司亦在积极开拓海外客户市场，并已与光宝科技、和硕电子、麦格米特、捷温电子、伟世通、HANSOL、SOLUM、MARELLI、Sagemcom 等国内外知名客户进一步开展合作，丰富的客户资源为此次募投项目的顺利实施提供了坚实保障。

综上，公司本次募集资金投资项目均围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有较好基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保项目的顺利实施。

（二）资金缺口的解决方式

本次募集资金投资项目总投资额为 80,630.07 万元，拟使用募集资金金额为 76,000.00 万元。本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。资金缺口的来源方面，除公司自有经营利润积累以外，公司属于 PCB 行业知名上市公司，具有良好的信用记录，融资环境相对宽松，银行融资授信额度充裕。公司在募集资金不足及项目建设存在资金缺口时，自筹资金来源可行性较高，可保障募投项目的顺利实施。

四、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系、与前次募投项目的区别和联系

（一）本次募投项目与公司既有业务或发展战略的关系

本次募集资金拟用于泰国高端印制电路板生产基地项目、智能化与数字化升级改造项目。泰国高端印制电路板生产基地项目是在公司现有主营业务的基础上，结合行业发展特点、公司战略规划方向，以现有技术为依托实施的投资计划，是现有业务的扩产项目，旨在优化公司产能布局、扩大业务规模、增强公司市场竞争力，对公司开发新的客户资源、寻求新的利润增长点具有重要意义；智能化与数字化升级改造项目是在公司现有厂区产能的基础上，紧密结合电子信息产业向高多层、高精度 PCB 升级的发展趋势，以突破现有低层数产品瓶颈、提升中高端 PCB 生产能力为核心目标，通过对现有工厂进行设备迭代、工艺优化及智能化改造、数字化能力的提升，实现向中高端 PCB 的产品结构升级。

公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务开展，是公司基于未来发展战略及行业发展状况的考虑，本次募投项目与公司既有业务密切相关。

（二）本次募投项目与前次募投项目的关系

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”；本次可转债募集资金投资项目包括“泰国高端印制电路板生产基地项目”、“智能化与数字化升级改造项目”。其中“智能化与数字化升级改造项目”旨在引进具备高自动化水平、高精度加工能力的智能化生产设备及数字化管理系统，全面提升公司智能化、数字化管理水平，从而优化生产效率、提升产品精度控制能力，不涉及新建产能，与前次募投项目区别较大。

本次募投项目之“泰国高端印制电路板生产基地项目”与前次募投项目之“吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”的联系与区别如下：

项目	联系	区别	
		吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	泰国高端印制电路板生产基地项目
项目性质	/	前次募投项目	本次募投项目
所属行业	均属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C398 电子元件及电子专用材料制造”	-	-
实施地点	/	江西省吉安市	泰国巴真武里府
实施主体	/	发行人母公司	发行人子公司泰国泰坤
目标市场	/	以境内市场为主、境外市场为辅	主要面向东南亚、中国台湾、日韩、欧美等境外市场
应用领域	均覆盖消费电子、汽车电子、工业控制、通信电子等下游	侧重消费电子、汽车电子、工业控制、智能安防等领域	侧重汽车电子、服务器及配套设施、工业控制、高速通信等领域
产品类型	/	以光电显示产品、触控模组、照明系统、汽车动力/安全系统、热管理应用产品、服务器电源、家用监控系统等为主	以新能源三电系统（电机/电池/电控）、智能驾驶系统、车载娱乐系统、智能座舱、AI 服务器二次电源、工业机器人、高频高速板等为主

项目	联系	区别	
		吉安高精密印制线路板 生产基地建设项目	泰国高端印制电路板 生产基地项目
储备客户	存在部分重叠，均包括公司现有消费电子、汽车电子、工业控制等户	重点面向国内外通讯设备、消费电子、汽车电子、工控领域客户，通讯设备如客户普联技术、吉祥腾达、鸿海精密、和硕电子；消费电子领域如联想集团、华勤技术、格力电器、小米集团、浪潮集团；汽车电子客户如德赛西威、富赛电子、航盛电子、江苏天宝等；工控安防领域如台达电子、海康威视、爱士惟等。	重点面向境外地区汽车电子、服务器及配套设施、高速通信等领域现有客户和储备客户，如台达电子、光宝科技、MARELLI（马瑞利）、和硕电子、麦格米特、HANSOL（韩松集团）、SOLUM、捷温电子、伟世通、捷普电子、Sagemcom（萨基姆）等。

上述两个项目均为 PCB 生产制造类项目，均属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C398 电子元件及电子专用材料制造”，内在联系为：一是战略方向上均锚定汽车电子、工业控制核心赛道，前期积累的台达电子、德赛西威、富赛电子、爱士惟等优质客户资源为本次项目实施奠定了良好的品牌与客户资源基础，形成“国内客户深耕+海外客户拓展”的协同效应；二是产能布局上形成互补，吉安生产基地产能扩张有利于巩固国内基本盘，本次泰国高端产能目标在于承接海外增量订单，符合 PCB 行业产能出海的发展趋势；三是两者技术路径上一脉相承，前次项目积累的高多层板生产经验为本次泰国项目的 HDI、高多层板的顺利量产提供技术支撑。

两个项目主要区别为：一是目标市场定位不同：前次项目选址江西吉安，由母公司运营管理，主要依托国内完善产业链聚焦境内市场；本次项目落地泰国巴真武里府，通过子公司泰国泰坤实施，借助泰国税收减免（企业税豁免最长 8 年）及汽车产业、电子电路产业等集群优势，深度开拓东南亚、中国台湾、日韩及欧美高端市场；二是产品结构侧重不同：前次项目覆盖侧重消费电子、汽车电子、工业控制、智能安防等领域，产品定位以光电显示产品、触控模组、照明系统、汽车动力/安全系统、热管理应用产品、服务器电源、家用监控系统等为主；本次项目主要聚焦汽车电子、服务器及配套设施、工业控制、高速通信等领域，以新能源三电系统（电机/电池/电控）、智能驾驶系统、车载娱乐系

统、智能座舱、AI 服务器二次电源、工业机器人等为主；三是客户矩阵存在一定差异：前次以海康威视、普联技术、格力电器、视源股份、联想集团等境内客户为主；本次重点服务台达电子、光宝科技、马瑞利、捷温电子、韩松集团、和硕电子等境外客户。

公司前次与本次募投项目在布局逻辑上既存在战略差异，又形成有机协同，充分顺应了 PCB 行业“国内夯实基础+海外拓展增量”的全球化发展趋势。

五、关于主营业务与募集资金投向的合规性

（一）本次募投项目符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形

公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，本次募集资金拟投向泰国高端印制电路板生产基地项目及智能化与数字化升级改造项目。本次募投项目的产品为印制电路板，主要应用于汽车电子、消费电子、工业控制等领域，发行人主营业务和本次募投项目均不涉及高耗能高排放行业，本次募投项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的淘汰类、限制类产业，不属于产能过剩行业，符合国家产业政策要求。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人主营业务属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”之“C3982 电子电路制造”；根据国家统计局印发的《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人主营业务属于“1.2 电子核心产业”之“1.2.1.3982*电子电路制造”；根据国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版），发行人产品属于“1.3 电子核心产业”之“1.3.3 新型元器件”中“高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板、特种印制电路板”。本次募投项目符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。

（二）本次募集资金投资项目与主业的关系

本次募集资金投向均系密切围绕公司主营业务进行，具体情况如下：

项目	泰国高端印制电路板生产基地项目	智能化与数字化升级改造项目
----	-----------------	---------------

1、是否属于对现有业务（包括产品、服务、技术等，下同）的扩产	是，本项目是基于公司拓展国际市场、提升公司抗风险能力的需要而实施，主要产品类型以四层板、六层及以上、HDI 等产品为主，下游侧重汽车电子、服务器及配套设施、工业控制、高速通信等领域，属于公司对现有业务的扩产。	否
2、是否属于对现有业务的升级	是，本次募投项目通过对生产工艺与生产设备进行升级，拟进一步提高产品六层板及高阶 HDI 板的占比，对工艺控制能力、产品质量、参数标准等要求更高，属于对现有业务的升级。	是，本项目可以提高公司生产运营效率、提升产品精度控制能力，属于对公司现有生产体系的智能化、数字化升级改造
3、是否属于基于现有业务在其他应用领域的拓展	否	否
4、是否属于对产业链上下游的（横向/纵向）延伸	否	否
5、是否属于跨主业投资	否	否
6、其他	无	无

泰国高端印制电路板生产基地项目：1.属于对现有业务的扩产：公司通过在泰国建设本次项目，拟新增年产 110 万 m² 高端 PCB 产能，聚焦新能源汽车、AI 服务器、机器人、高速通信等领域客户的本地化产能诉求，与国内江西基地产能协同，优化全球产能布局；2.属于对现有业务的升级：本项目通过在电镀、钻孔、压合、曝光、蚀刻、检测等核心生产工序采购智能化、自动化高端设备，实现从传统加工工艺向高精密制造工艺、精准参数控制升级，从目前公司江西生产基地常规的单双面板/四层板为主的产品体系向六层及以上板/高阶 HDI 等高附加值产品结构升级，根据规划本项目建设完成后，公司泰国工厂的六层板及以上板/HDI 的合计产能占比将达到 67.27%，远超 2025 年公司相应产品比例 22.22%。本项目建设系聚焦新能源汽车、AI 服务器、机器人、高速通信等领域客户的新需求、新要求，通过新建项目实现制造装备迭代提升工艺稳定性、产

品良率与质量标准，强化高端 PCB 制造能力，是对公司现有产能结构的提质与优化，属于对现有业务的升级。

智能化与数字化升级改造项目，属于对现有业务的升级：本项目针对公司现有生产基地实施改造，在公司一厂、二厂引进高精密度自动化钻孔设备、垂直连续电镀线、高解析度 LDI 激光成像及智能阻焊线、高性能沉金设备、高端外层 AOI 及飞针测试仪等先进生产与检测仪器，实现对钻孔、电镀、阻焊、沉金、检测、成型及包装等全制程的软硬件升级。通过提升关键制程的精度控制与稳定性，项目将显著升级产品产能结构，实现一厂、二厂产品平均层数有效提升。根据规划本项目建设完成后一厂、二厂的六层及以上产品结构占比将提升 30%以上。同时本项目可以增强公司高多层板产品的可靠性、一致性及良品率，实现一厂、二厂产品良率提升 0.5 个百分点以上。因此本项目的建设属于对现有业务的提质升级。

六、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次募集资金对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家产业政策、公司战略规划方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于优化公司产能布局、扩大业务规模、增强市场竞争力，对公司开发新的客户资源、寻求新的利润增长点具有重要意义。

（二）本次募集资金对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产规模将相应提高，资金实力将有所增强。随着未来可转债持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司资本结构、提升公司抗风险能力。本次募集资金投资项目达到预期目标需要一定的时间，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着募投项目的顺利实施，公司的业务规模和盈利能力将进一步提高。

第八节 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金情况

（一）首次公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,687.00万股，发行价格为每股26.80元，募集资金总额98,811.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为87,444.44万元。募集资金已于2022年8月5日分别划至公司指定专户。上述募集资金的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具（天健验〔2022〕3-75号）验资报告。

（二）募集资金的存放情况

截至2026年6月30日，募集资金使用和结余情况如下表：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	项目名称	备注
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行	14371001040023599	74,489.75	3,877.52	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	协定存款
中国农业银行股份有限公司吉安分行	14371001040023599-10013		2,000.00	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	大额存单账户
中国农业银行股份有限公司吉安分行	14371001040023599-10014		2,000.00	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	大额存单账户
江西银行股份有限公司吉安庐陵支行	796900156000077	15,000.00	-	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行	14371001040023599-1	-	-	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行	14371001040023599-2	-	-	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	已销户

银行名称	账号	初始存放 金额	截止日余额	项目名称	备注
中国农业银行股份有限公司 吉安庐陵支行	1437100104002359 9-3	-	-	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	已销户
中国农业银行股份有限公司 吉安庐陵支行	1437100104002359 9-4	-	-	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	已销户
中国农业银行股份有限公司 吉安庐陵支行	1437100104002359 9-5	-	-	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	已销户
中国农业银行股份有限公司 吉安庐陵支行	1437100104002359 9-6	-	-	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	已销户
中国农业银行股份有限公司 吉安庐陵支行	1437100104002359 9-7	-	-	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	已销户
中国农业银行股份有限公司 吉安庐陵支行	1437100104002359 9-8	-	-	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	已销户
中国农业银行股份有限公司 吉安庐陵支行	1437100104002359 9-9	-	-	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	已销户
中国农业银行股份有限公司 吉安庐陵支行	1437100104002359 9-10	-	-	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	已销户
中国农业银行股份有限公司 吉安庐陵支行	1437100104002359 9-11	-	-	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	已销户
中国农业银行股份有限公司 吉安庐陵支行	1437100104002359 9-12	-	-	吉安高精密印制线路板生产基地建设项目	已销户
合计		89,489.75	7,877.52		

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，前次募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：			87,444.44			已累计使用募集资金总额：			73,982.00		
变更用途的募集资金总额：			不适用			各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2022 年：			8,315.05		
						2023 年：			18,104.31		
						2024 年：			10,677.26		
						2025 年：			30,348.49		
						2026 年 1-6 月			6,536.89		
承诺投资项目和超募资金投向			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预	
序	承	实	募	募	实	募	募	实	实	实	定可
号	诺	际	集	集	际	集	集	际	际	际	使用状
	投	投	前	后	投	前	后	投	投	投	态日期（或
	资	资	承	承	资	承	承	资	资	资	截止日项目
	项	项	诺	诺	金	诺	诺	金	金	金	完工程度）
	目	目	投	投	额	投	投	额	额	额	
			资	资		资	资		与		
			金	金		金	金		募		
			额	额		额	额		集		
			额	额		额	额		后		
									承		
									诺		
									投		
									资		
									金		
									额		
									的		
									差		
									额		

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

在项目实际建设过程中，2024 年 12 月，为了提高投资效益，控制产线产能投资进度以与市场订单需求相匹配，避免产能过早投入形成浪费，公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟将该项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 1 月延期至 2025 年 12 月。

2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过，同意公司将“吉安高精印制线路板生产基地建设项目”的达到预定可使用状态的日期调整至 2025 年 12 月，公司前次发行的持续督导机构发表了核查意见。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2022 年 8 月 18 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金实际投资金额 4,818.98 万元及已支付发行费用的自筹资金 245.14 万元，共计 5,064.12 万元。

本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了天健审〔2022〕3-457 号《关于吉安满坤科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

（四）闲置募集资金的使用

1、闲置募集资金用于现金管理

2022 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在充分保障日常经营性资金需求，确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，使用不超过 8.00 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不得超过 12 个月；使用不超过 1.50 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的投资产品。

2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在充分保障日常经营性资金需求，保证不影响募集资金投资项目正常进行，并有效控制风险的前提下，使用不超过 6.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不得超过 12 个月；使用不超过 1.50 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的投资产品。

2024 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在充分保障日常经营性资金需求，保证不影响募集资金投资项目正常进行，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 5.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不

得超过 12 个月；使用不超过人民币 1.50 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的投资产品。

2025 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设计划、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币 3.00 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，同意公司及子公司使用不超过人民币 3.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的投资产品。

2、闲置募集资金用于临时补充流动资金

2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币 1.50 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

2024 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

（五）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年		
1	吉安高精密印制线路板生产基地建设	不适用注	13,311.44	不适用	不适用	-271.57	-1,610.76	-1,882.33	不适用

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年		
	项目								

注：该项目在 2025 年 12 月末已全部建成并投产，不适用截止日投资项目累计产能利用率及是否达到预计效益的评价。

2、未能实现承诺收益的说明

本公司前次募投项目已于 2025 年 12 月末建设完成，产能处于爬坡期，不适用项目承诺收益实现情况的评价。

三、会计师事务所对前次募集资金使用情况出具的鉴证报告

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前次募集资金使用情况出具了《吉安满坤科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》认为，满坤科技管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引-发行类第 7 号》的规定，如实反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

第九节 备查文件

除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- 一、发行人最近三年的财务报告及审计报告；
- 二、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 三、法律意见书、律师工作报告；
- 四、董事会编制、股东会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；
- 五、资信评级报告；
- 六、其他与本次发行有关的重要文件。

自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站查阅本次发行的募集说明书全文及备查文件。

（本页无正文，为《吉安满坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》之签章页）

吉安满坤科技股份有限公司

2016年9月22日



附表一：商标

序号	权利人	商标	注册号	有效期限	注册地	类别
1	满坤科技		34146109	2019.06.14-2029.06.13	境内	42
2	满坤科技		34143637	2019.06.28-2029.06.27	境内	11
3	满坤科技		27339564	2018.10.28-2028.10.27	境内	9
4	满坤科技		34037075	2019.07.14-2029.07.13	境内	40
5	满坤科技		27368843	2018.10.28-2028.10.27	境内	9
6	满坤科技		34027957	2019.08.07-2029.08.06	境内	40
7	满坤科技	Mankun	34045611	2019.07.14-2029.07.13	境内	40
8	满坤科技	MKKJ	27372040	2019.02.28-2029.02.27	境内	9
9	满坤科技	满坤科技	34034653	2019.07.14-2029.07.13	境内	40
10	满坤科技	伟仁达	34144795	2019.06.14-2029.06.13	境内	9
11	满坤科技	伟仁达	34146121	2019.06.14-2029.06.13	境内	42
12	满坤科技	伟仁达	34140819	2019.06.14-2029.06.13	境内	35
13	满坤科技	偉仁達	34140796	2019.06.14-2029.06.13	境内	42
14	满坤科技	偉仁達	34142579	2019.06.21-2029.06.20	境内	9
15	满坤科技	偉仁達	34153187	2019.06.21-2029.06.20	境内	35
16	满坤科技	GRAND HOPE	34153499	2019.06.14-2029.06.13	境内	35
17	满坤科技	GRAND HOPE	34143693	2019.06.14-2029.06.13	境内	42
18	满坤科技	满坤科技	28021475	2019.07.14-2029.07.13	境内	9
19	满坤科技	泰坤电路	86430884	2026.02.07-2036.02.06	境内	9
20	满坤科技	泰坤科技	86421913	2026.02.07-2036.02.06	境内	9

附表二：专利

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	专利类型
1	一种印制电路板的加工方法	深圳满坤科技	2019101988073	2019/3/15	发明专利
2	一种废料灰尘自收集的电路板钻孔打磨机构	深圳满坤科技	2020103130553	2020/4/20	发明专利
3	一种防飞溅的线路板加工用喷涂装置	深圳满坤科技	2022103581152	2022/4/6	发明专利
4	一种新型的灯条板成型加工方法	满坤科技	2017102261921	2017/4/8	发明专利
5	一种无销钉定位贴胶钻孔的方法	满坤科技	2017104577469	2017/6/16	发明专利
6	一种印制电路板智能制造工艺	满坤科技	201711167323X	2017/11/21	发明专利
7	一种沉铜前锣槽的加工方法	满坤科技	2017113029139	2017/12/11	发明专利
8	一种便于检修的集成印制电路板分切装置	满坤科技	2018101224436	2018/2/7	发明专利
9	一种新能源智能汽车印制电路板的制造方法	满坤科技	2020106351187	2020/7/4	发明专利
10	一种汽车印制电路板的制造方法	满坤科技	2020106367645	2020/7/4	发明专利
11	用于 5G 通信的多层电路板制备方法及其多层电路板	满坤科技	2020113867763	2020/12/1	发明专利
12	用于 5G 终端网卡的多层电路板制备方法及其 5G 网卡	满坤科技	2020113867509	2020/12/1	发明专利
13	一种 MiniLED 高动态印制电路板的生产管理系统	满坤科技	2021107732405	2021/7/8	发明专利
14	一种改善金板平整度加工装置	满坤科技	202110777648X	2021/7/9	发明专利
15	一种高频高速 5G 印制电路板制造工艺	满坤科技	2021107877762	2021/7/13	发明专利
16	一种传感控制 Touch 技术印制电路板及其制备方法	满坤科技	2021107981357	2021/7/15	发明专利
17	一种芯片 IC 封装印制电路板制造工艺	满坤科技	202110889318X	2021/8/4	发明专利
18	一种印制电路板压合涨缩自动分堆打凹槽系统	满坤科技	202210468947X	2022/4/30	发明专利
19	一种利用散热材料制备汽车印制电路板的加工工艺	满坤科技	2022104689484	2022/4/30	发明专利
20	一种带有双刃镀膜铣刀的 PCB 板机械钻孔加工装置	满坤科技	2022104689499	2022/4/30	发明专利
21	板厚≤1.0mm 触控印制电路板涂布机的连印带塞工艺	满坤科技	2022106193943	2022/6/2	发明专利
22	一种防弯翘的触控 PCB 板生产工艺	满坤科技	2022106194611	2022/6/2	发明专利
23	一种防孔口凹陷的车载印制电路板加工方法	满坤科技	2022106194062	2022/6/2	发明专利
24	一种新能源汽车逆变器印制电路板的制造方法	满坤科技	2023102202632	2023/3/9	发明专利
25	一种金属化半孔 PCB 板加工设备及加工方法	满坤科技	2024104194480	2024/4/8	发明专利
26	一种 PCB 板防焊印刷装置	满坤科技	2024104665436	2024/4/18	发明专利
30	一种新型叠板台	满坤科技	2017207054482	2017/6/17	实用新型

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	专利类型
31	一种用于贴胶机的测量定位装置	满坤科技	2017207043882	2017/6/16	实用新型
32	一种自带冷却装置的千层架	满坤科技	2017208787090	2017/7/19	实用新型
30	一种压合铜箔放置架	满坤科技	2017208792525	2017/7/19	实用新型
31	一种自动放板机防叠板装置	满坤科技	2017208781183	2017/7/19	实用新型
32	一种中央空调风机盘管清洗装置	满坤科技	2017208787103	2017/7/19	实用新型
33	一种数控钻孔工作台	满坤科技	2017208792510	2017/7/19	实用新型
34	一种新型钻靶加工的清洗装置	满坤科技	2017214906203	2017/11/10	实用新型
35	一种新型沉铜手推车	满坤科技	2017214905770	2017/11/10	实用新型
36	一种印制电路板板翘整平装置	满坤科技	201721893095X	2017/12/29	实用新型
37	一种印制电路板沉铜生产线挂篮转换架	满坤科技	2017218930945	2017/12/29	实用新型
38	一种印制电路板自动定位装置	满坤科技	2017219006352	2017/12/29	实用新型
39	一种电路板贴膜机	满坤科技	2018201206486	2018/1/24	实用新型
40	一种电路板制造过程中废水装置	满坤科技	201820118957X	2018/1/24	实用新型
41	一种新型电路板酸洗装置	满坤科技	2018201205854	2018/1/24	实用新型
42	一种印制电路板磨刷机	满坤科技	2018201199020	2018/1/24	实用新型
43	一种印制电路板制备用曝光机	满坤科技	2018201205835	2018/1/24	实用新型
44	一种印制电路烘干装置	满坤科技	2018201198899	2018/1/24	实用新型
45	一种陶瓷基板电镀装置	满坤科技	2018201262772	2018/1/25	实用新型
46	一种陶瓷基板高压水洗装置	满坤科技	2018201262768	2018/1/25	实用新型
47	一种印制电路板开料分条机	满坤科技	2018201262787	2018/1/25	实用新型
48	一种印制电路板数控钻机	满坤科技	2018201258508	2018/1/25	实用新型
49	一种新型 V 槽分板装置	满坤科技	2020215678263	2020/8/1	实用新型
50	一种平行式周转架	满坤科技	2020215678051	2020/8/1	实用新型
51	一种 PCB 电路板沉头孔加工装置	满坤科技	2020217975762	2020/8/25	实用新型
52	一种 PCB 树脂塞孔工装	满坤科技	2020217957849	2020/8/25	实用新型
53	一种新型 PCB 板热固化装置	满坤科技	2020217975828	2020/8/25	实用新型
54	一种新型功放陶瓷铝基混压板	满坤科技	2020217957711	2020/8/25	实用新型
55	一种印制电路板的表面处理装置	满坤科技	2020217957815	2020/8/25	实用新型
56	一种用于 5G 高速电路板用沉锡装置	满坤科技	2020217957641	2020/8/25	实用新型
57	一种用于印制电路板显影中消泡用装置	满坤科技	2020217957637	2020/8/25	实用新型
58	一种 PCB 板干膜封孔检测装置	满坤科技	2020218222784	2020/8/27	实用新型
59	一种便于测试的高纵横比测试板	满坤科技	2020218222426	2020/8/27	实用新型
60	一种采用 36T 网加工铜板装置	满坤科技	2020218222905	2020/8/27	实用新型
61	一种精细影像显示印制光电路板	满坤科技	2020218223096	2020/8/27	实用新型
62	一种抗电磁干扰 PCB 电路板	满坤科技	2020218222799	2020/8/27	实用新型
63	一种新型沉锡装置	满坤科技	2020218232786	2020/8/27	实用新型
64	一种电路板沉锡处理装置	满坤科技	2020218372071	2020/8/28	实用新型
65	一种多层印制电路板钻夹具	满坤科技	2020218371308	2020/8/28	实用新型

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	专利类型
66	一种防止电路板擦花的暂存架	满坤科技	2020218381102	2020/8/28	实用新型
67	一种厚铜板的印刷阻焊油工装	满坤科技	2020218381117	2020/8/28	实用新型
68	一种印制插头电路板金手指镀金装置	满坤科技	2020218371327	2020/8/28	实用新型
69	一种用于电路板的冲孔装置	满坤科技	2020218371562	2020/8/28	实用新型
70	一种用于高性能显卡电路板的钻孔机构	满坤科技	2020218371187	2020/8/28	实用新型
71	一种高传输效率的铝基板电路板冲压装置	满坤科技	2020218437574	2020/8/29	实用新型
72	一种机械钻高厚铜板孔型弯曲改善装置	满坤科技	2020218437606	2020/8/29	实用新型
73	一种无管位线路板的成型锣板工装	满坤科技	2020218437589	2020/8/29	实用新型
74	一种新型 5G 终端信号网卡结构	满坤科技	2020218437678	2020/8/29	实用新型
75	一种新型无铅耐高温印制电路板的印刷机	满坤科技	2020218437485	2020/8/29	实用新型
76	一种印制电路板的油墨控制工装	满坤科技	2020218437663	2020/8/29	实用新型
77	一种用于 HDI 线路板加工的定位工装	满坤科技	2020218437555	2020/8/29	实用新型
78	一种用于 PCB 板背钻的钻孔装置	满坤科技	2020218437521	2020/8/29	实用新型
79	一种 PCB 制板电镀填平工装	满坤科技	2020218516580	2020/8/31	实用新型
80	一种印制电路板龙门电镀线伸缩支架	满坤科技	2020218516561	2020/8/31	实用新型
81	一种印制电路板龙门线震动监视装置	满坤科技	2020218512062	2020/8/31	实用新型
82	一种 UV 固化装置	满坤科技	2020218721744	2020/9/1	实用新型
83	一种多孔径铝片塞孔装置	满坤科技	2020218721195	2020/9/1	实用新型
84	一种新型 IR 炉温度均衡控制装置	满坤科技	2020218742810	2020/9/1	实用新型
85	一种组合式 5G 通信的多层电路板结构	满坤科技	2021206102095	2021/3/25	实用新型
86	一种 5G 通信电路板的散热结构	满坤科技	2021206102076	2021/3/25	实用新型
87	一种 5G 通信电路板的测试装置	满坤科技	2021206091921	2021/3/25	实用新型
88	一种 PCB 蚀刻均匀性检测装置	满坤科技	2021209584314	2021/5/7	实用新型
89	一种加工 TOZ 铜箔压合装置	满坤科技	2021209602219	2021/5/7	实用新型
90	一种提升光电极尺寸稳定性加工装置	满坤科技	2021209584278	2021/5/7	实用新型
91	一种用于改善 LED 灯板粉尘塞孔钻咀工装	满坤科技	202120960170X	2021/5/7	实用新型
92	一种检验 AOI 设备能力测试板	满坤科技	2021216124885	2021/7/15	实用新型
93	一种防焊油墨万用测试板	满坤科技	2021217635360	2021/7/30	实用新型
94	一种新型超薄多层印制电路板	满坤科技	2021217941135	2021/8/3	实用新型
95	一种防焊显影添加槽改良装置	满坤科技	2021217926525	2021/8/3	实用新型
96	一种 Rogers 塞铜柱印制电路板制作装置	满坤科技	2021218012899	2021/8/4	实用新型
97	一种测量电镀夹子电流装置	满坤科技	2021223896692	2021/9/27	实用新型
98	一种 LCD 印制电路板电测治具	满坤科技	2022205858911	2022/3/17	实用新型
99	一种 LED 灯板防焊墨色稳定性加工装置	满坤科技	2022205858875	2022/3/17	实用新型
100	一种 OSP 表面处理预浸槽	满坤科技	2022205858907	2022/3/17	实用新型

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	专利类型
101	一种 PCB 板 IC 尺寸控制设备	满坤科技	2022205954586	2022/3/18	实用新型
102	一种 PCB 板挡点网印刷定位装置	满坤科技	2022205971882	2022/3/18	实用新型
103	一种 PCB 板压合设备	满坤科技	2022205954571	2022/3/18	实用新型
104	一种 PCB 半孔板成型正反旋锣刀毛刺打磨设备	满坤科技	2022206168449	2022/3/21	实用新型
105	一种多层超薄触控类印制电路板加工设备	满坤科技	2022206160729	2022/3/21	实用新型
106	一种防止 PCB 板掉铜屑流转框架	满坤科技	2022206168561	2022/3/21	实用新型
107	一种厚铜类新能源汽车印制电路板加工设备	满坤科技	2022206276231	2022/3/22	实用新型
108	一种可降低 PCB 板外层线路阻抗偏差值的装置	满坤科技	2022206276250	2022/3/22	实用新型
109	一种印制电路板镀金化金设备	满坤科技	2022206391263	2022/3/23	实用新型
110	一种印制电路板深镀电镀装置	满坤科技	2022206407806	2022/3/23	实用新型
111	一种边角耐磨损的线路板	深圳满坤科技	2022207876153	2022/4/6	实用新型
112	一种侧滑式线路板防水机构	深圳满坤科技	2022208132865	2022/4/6	实用新型
113	一种双面除灰的电路板表面除灰装置	深圳满坤科技	2022208262036	2022/4/11	实用新型
114	一种线路板加工用可表面除尘的转运装置	深圳满坤科技	2022209108276	2022/4/19	实用新型
115	一种线路板加工用定向输送的裁切装置	深圳满坤科技	2022209108079	2022/4/19	实用新型
116	一种易于安装的卡接式多层电路板	深圳满坤科技	2022209688820	2022/4/19	实用新型
117	一种具有防撞效果的线路板	深圳满坤科技	2022230390567	2022/11/14	实用新型
118	具有导向机构的线路板输送装置	深圳满坤科技	2022230390586	2022/11/14	实用新型
119	一种具有除烟功能的 PCB 板锡焊装置	深圳满坤科技	2023204708413	2023/3/2	实用新型
120	一种具有分隔保护组件的 PCB 板	深圳满坤科技	2023204301924	2023/3/9	实用新型
121	一种电测机设备能力测试板	满坤科技	2023206410536	2023/3/28	实用新型
122	一种加厚印制电路板防焊专用钉床	满坤科技	202320641049X	2023/3/28	实用新型
123	一种提升化金效率降低金盐成本新型挂架	满坤科技	2023206928121	2023/4/1	实用新型
124	一种适应于 SMT 红胶工艺 PCB 阻焊加工装置	满坤科技	2023206928136	2023/4/1	实用新型
125	一种线路工序显影机干膜破孔改良装置	满坤科技	2023206928117	2023/4/1	实用新型
126	一种大尺寸 PCB 阻焊挡点网制作装置	满坤科技	202320758623X	2023/4/8	实用新型
127	一种无痕去除 PCB 金手指引线加工装置	满坤科技	2023207586225	2023/4/8	实用新型
128	一种 PCB 板锡面改良加工装置	满坤科技	202320884894X	2023/4/19	实用新型

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	专利类型
129	一种印制电路板 PP 自动称重设备	满坤科技	202320884887X	2023/4/19	实用新型
130	一种印制电路板压合自动防叠错设备	满坤科技	202321011609X	2023/4/28	实用新型
131	一种 PCB 文字加工设备	满坤科技	2023212916795	2023/5/25	实用新型
132	一种改善 Touchpad 印制电路板平整度加工装置	满坤科技	2023214109466	2023/6/5	实用新型
133	一种用于汽车车灯的电路板支撑结构	满坤科技	2023214538495	2023/6/8	实用新型
134	一种多孔径塞孔铝片	满坤科技	2023215935586	2023/6/21	实用新型
135	一种可传感控制影像的电路板	满坤科技	2023216643759	2023/6/28	实用新型
136	一种电路板固定支架	满坤科技	2023218404451	2023/7/13	实用新型
137	一种电路板清洗工装	满坤科技	202321854305X	2023/7/14	实用新型
138	一种 PCB 线路板测试治具	深圳满坤科技	202323039130X	2023/11/9	实用新型
139	一种线路板加工的切片装置	深圳满坤科技	2023231343286	2023/11/20	实用新型
140	一种线路板加工用蚀刻装置	深圳满坤科技	2023233088450	2023/12/5	实用新型
141	一种 PCB 机械手抓板固定安装结构	满坤科技	2023233634962	2023/12/11	实用新型
142	一种电路板检测用夹持翻转设备	深圳满坤科技	2024203336511	2024/2/22	实用新型
143	一种防腐蚀的电路板包装箱	深圳满坤科技	2024205214932	2024/3/15	实用新型
144	一种车载电路板的印制装置	满坤科技	2024206756399	2024/4/3	实用新型
145	一种车载超厚铜电路板印制装置	满坤科技	2024206756420	2024/4/3	实用新型
146	一种 PCB 内部缺陷识别检测装置	满坤科技	202421005370X	2024/5/10	实用新型
147	一种厚铜 PCB 喷锡装置	满坤科技	2024210053729	2024/5/10	实用新型
148	一种车载 PCB 板翘水平反直装置	满坤科技	2024210306296	2024/5/13	实用新型
149	一种具有风干功能的电路板清洗装置	深圳满坤科技	2024211792183	2024/5/27	实用新型
150	一种印制电路板自动化压合装置	满坤科技	2024212460537	2024/6/3	实用新型
151	一种 PCB 钻孔机自动上下料装置	满坤科技	2024212460490	2024/6/3	实用新型
152	一种 PCB 阻焊油墨辊涂装置	满坤科技	2024213579717	2024/6/14	实用新型
153	一种沉金过滤循环系统自动排气装置	满坤科技	2024214640318	2024/6/25	实用新型
154	一种改善 PCB 板白油塞孔过 IR 炉发黄的保护装置	满坤科技	2024214733562	2024/6/26	实用新型
155	一种 PCB 钻孔装置	满坤科技	202421646641X	2024/7/12	实用新型
156	一种汽车电子水泵控制电路板散热机构	满坤科技	2024217735856	2024/7/25	实用新型
157	一种新能源 OBC 电路板干燥装置	满坤科技	2024217848233	2024/7/26	实用新型
158	一种金手指 PCB 板测试台	满坤科技	202421811121X	2024/7/29	实用新型
159	一种电路板生产烧录多合一系统载具	满坤科技	2024217935369	2024/7/29	实用新型
160	印制电路板（MKKJ-301132）	满坤科技	2022305465617	2022/8/20	外观设计
161	电路板	满坤科技	2024302224266	2024/4/19	外观设计

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	专利类型
162	一种应用于汽车安全控制系统电路板的制造方法	满坤科技	2022116828524	2022/12/27	发明专利
163	一种高导热电路板铜块埋嵌装置	满坤科技	2024114987281	2024/10/25	发明专利
164	一种应用于智能家居设备电路板的制造方法	满坤科技	2022116025465	2022/12/13	发明专利
165	一种用于液晶显示器电路板的生产稼动率提升设备	满坤科技	2023103314300	2023/3/30	发明专利
166	一种 PCB 板铜面修复装置及修复工艺	满坤科技	2024111586903	2024/8/22	发明专利
167	一种 PCB 锣板装置及使用方法	满坤科技	2024112909428	2024/9/14	发明专利
168	一种用于笔电摄像头模组的 HDI 板制造工艺	满坤科技	2025105208409	2025/4/24	发明专利
169	一种用于车载摄像头 HDI 板制造工艺	满坤科技	2025105629959	2025/4/30	发明专利
170	一种 HDI 板防焊曝光过程自动化工业控制系统	满坤科技	2025108365971	2025/6/21	发明专利
171	一种 HDI 板电镀填孔过程智能化工业控制系统	满坤科技	2025108392875	2025/6/23	发明专利
172	一种 5G 通信 PCB 控深钻钻孔设备及工艺	满坤科技	2025108791324	2025/6/27	发明专利
173	一种笔记本电脑印制电路板的制造方法	满坤科技	2025109465939	2025/7/9	发明专利
174	一种 PCB 埋孔线路层湿墨工艺	满坤科技	202511078705X	2025/8/1	发明专利
175	一种电路板电感元件用电感测试机及测试方法	满坤科技	2025111680454	2025/8/20	发明专利
176	一种印制电路板嵌铜过程自动化工控系统	满坤科技	2025112170317	2025/8/28	发明专利
177	一种 PCB 冲孔装置	满坤科技	2025210340060	2025/5/24	实用新型
178	一种 PCB 加工用沉金装置	满坤科技	202521061197X	2025/5/27	实用新型
179	一种 PCB 生产用水洗装置	满坤科技	2025211013206	2025/5/30	实用新型
180	一种 PCB 涨缩系数自动测量设备	满坤科技	2025212556055	2025/6/18	实用新型
181	一种电路板加工用尺寸切割装置	满坤科技	2025213177234	2025/6/26	实用新型
182	一种 PCB 板干膜贴膜装置	满坤科技	202521402761X	2025/7/5	实用新型
183	一种 PCB 钻孔断刀自动分析设备	满坤科技	2025214686956	2025/7/14	实用新型
184	一种改善 PCB 槽孔喷锡后铜皮分离不良制作装置	满坤科技	2025215135630	2025/7/19	实用新型
185	一种用于多层电路板加工的压合装置	满坤科技	2025215594275	2025/7/24	实用新型
186	一种线路板盲埋孔对位设备	满坤科技	2025216735938	2025/8/7	实用新型

附表三：软件著作权

序号	软件名称	登记号	披露登记日期	取得方式	著作权人
1	PCB 孔位检测系统 V1.0	2015SR043847	2015.03.12	原始取得	满坤科技
2	基于单片机与可编程逻辑芯片的智能检测系统 V1.0	2014SR212102	2014.12.26	原始取得	满坤科技
3	网络交换机主板控制系统 V1.0	2014SR212099	2014.12.26	原始取得	满坤科技
4	PCB 板厚度量测系统 V1.0	2017SR224384	2017.06.02	原始取得	满坤科技
5	PCB 板压合后层间错位检测系统 V1.0	2017SR225347	2017.06.02	原始取得	满坤科技
6	PCB 板压合后板材涨缩检测系统 V1.0	2017SR225350	2017.06.02	原始取得	满坤科技
7	PCB 板内层芯板线宽线距检测系统 V1.0	2017SR225354	2017.06.02	原始取得	满坤科技
8	PCB 板边标记打码系统 V1.0	2017SR225126	2017.06.02	原始取得	满坤科技
9	PCB 板 V 槽残厚检测系统 V1.0	2017SR327673	2017.06.29	原始取得	满坤科技
10	PCB 板 X-RAY 偏孔检测系统 V1.0	2017SR326956	2017.06.29	原始取得	满坤科技
11	PCB 板钻孔后验孔检测系统 V1.0	2017SR327940	2017.06.29	原始取得	满坤科技
12	PCB 板外形尺寸自动量测系统 V1.0	2017SR324617	2017.06.29	原始取得	满坤科技
13	PCB 板高压测试系统 V1.0	2017SR327661	2017.06.29	原始取得	满坤科技
14	满坤智能考勤系统 V1.0	2017SR378159	2017.07.18	原始取得	满坤科技
15	自动放板机叠板自动检测系统 V1.0	2017SR472211	2017.08.28	原始取得	满坤科技
16	PCB 板自动包装系统 V1.0	2017SR472836	2017.08.28	原始取得	满坤科技
17	PCB 板在线 AOI 检测系统 V1.0	2017SR473018	2017.08.28	原始取得	满坤科技
18	PCB 板自动切片取样系统 V1.0	2017SR471573	2017.08.28	原始取得	满坤科技
19	温湿度自动检测系统 V1.0	2017SR471566	2017.08.28	原始取得	满坤科技
20	汽车导航控制系统 V1.0	2017SR602940	2017.11.03	原始取得	满坤科技
21	汽车仪表控制系统 V1.0	2017SR602753	2017.11.03	原始取得	满坤科技
22	智能安防控制系统 V1.0	2017SR602763	2017.11.03	原始取得	满坤科技

序号	软件名称	登记号	披露登记日期	取得方式	著作权人
23	工业电机控制系统 V1.0	2017SR604993	2017.11.06	原始取得	满坤科技
24	路由器控制系统 V1.0	2017SR602933	2017.11.03	原始取得	满坤科技
25	智能制造信息安全保护系统 V1.0	2018SR201118	2018.03.24	原始取得	满坤科技
26	印制电路板制造执行系统 V1.0	2018SR201120	2018.03.24	原始取得	满坤科技
27	印制电路板数控系统 V1.0	2018SR201119	2018.03.24	原始取得	满坤科技
28	印制电路板数据管理系统 V1.0	2018SR201127	2018.03.24	原始取得	满坤科技
29	印制电路板全自动层压控制系统 V1.0	2018SR201125	2018.03.24	原始取得	满坤科技
30	印制电路板全生命周期信息统一管理系统 V1.0	2018SR201121	2018.03.24	原始取得	满坤科技
31	印制电路板高压水洗控制系统 V1.0	2018SR201124	2018.03.24	原始取得	满坤科技
32	现代化车间防火、防盗监控平台 V1.0	2018SR201123	2018.03.24	原始取得	满坤科技
33	电路板裁切控制系统 V1.0	2018SR201126	2018.03.24	原始取得	满坤科技
34	PCB 板检测系统 V1.0	2018SR201122	2018.03.24	原始取得	满坤科技
35	印制电路板质量追溯管理系统 V1.0	2022SR0530461	2022.4.27	原始取得	满坤科技
36	线路板自动核算报价系统 V1.0	2022SR0530462	2022.04.27	原始取得	满坤科技
37	PCB 防焊工序油墨领用防错软件 V1.0	2022SR0530024	2022.04.27	原始取得	满坤科技
38	印制电路板压合板厚数据自动监控系统 V1.0	2022SR0530023	2022.04.27	原始取得	满坤科技
39	印制电路板复合信号源飞针测试软件 V1.0	2025SR0601502	2025.04.10	原始取得	满坤科技
40	印制电路板 AOI 外观质量检测软件 V1.0	2025SR0601435	2025.04.10	原始取得	满坤科技
41	多维度信息融合的“状态感知-数据分析-预测诊断”一体化软件 V1.0	2025SR0601425	2025.04.10	原始取得	满坤科技
42	中高端印制电路板多源融合检测软件 V1.0	2025SR0601415	2025.04.10	原始取得	满坤科技
43	电路板故障点定位系统 V1.0	2026SR0282908	2026.02.12	原始取得	满坤科技
44	电路板生产流程追溯系统 V1.0	2026SR0282893	2026.02.12	原始取得	满坤科技
45	高密度电路板设计辅助平台	2026SR0282878	2026.02.12	原始取得	满坤科技

序号	软件名称	登记号	披露登记日期	取得方式	著作权人
46	电路板设计数据校验系统	2026SR0282870	2026.02.12	原始取得	满坤科技
47	多层电路板信号分析平台	2026SR0282863	2026.02.12	原始取得	满坤科技